2013

GESCHÄFTSBERICHT

SÜSS MicroTec

KENNZAHLEN

in Mio. €	2013	2012	Veränderung 2013 / 2012
Fortgeführte Aktivitäten			
Auftragseingang	135,0	157,2	-14,1 %
Auftragsbestand zum 31.12.	85,7	86,5	-0,9 %
Umsatz gesamt	134,5	163,8	-17,9 %
Umsatzrendite	-11,9 %	4,6 %	-16,5 %-Punkte
Rohertrag	21,8	57,4	-62,0 %
Rohertragsmarge	16,2 %	35,0 %	-18,8 %-Punkte
Herstellungskosten	112,7	106,4	5,9 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	10,2	9,7	5,2 %
Fortgeführte Aktivitäten			
EBITDA	-13,4	18,6	-
EBITDA-Marge	-10,0 %	11,4 %	-21,4 %-Punkte
EBIT	-19,4	11,7	-
EBIT-Marge	-14,4 %	7,1 %	-21,5 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	-16,0	7,6	-
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	-0,84	0,40	-
Fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten			
Ergebnis nach Steuern	-16,0	9,1	-
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	-0,84	0,48	-
Bilanz und Cashflow			
Eigenkapital [1]	109,4	127,2	-14,0 %
Eigenkapitalquote	60,8 %	70,5 %	-9,7 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	-14,6 %	6,0 %	-20,6 %-Punkte
Bilanzsumme	179,9	180,4	-0,3 %
Net Cash	35,7	32,3	10,5 %
Free Cashflow [2]	4,1	-4,5	-
Weitere Kennzahlen			
Investitionen [3]	12,2	4,2	>100,0 %
Investitionsquote	9,1 %	2,6 %	6,5 %-Punkte
Abschreibungen [4]	6,0	6,8	-11,8 %
Mitarbeiter zum 31.12.	655	704	-7,0 %

[1] Eigenkapital und Bilanzsumme zum 31.12.2012 wurden retrospektiv angepasst aufgrund der erstmaligen Anwendung von IAS 19 (2011).

[2] vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben, Wertpapierverkäufen und Sondereffekten aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften

[3] ohne Berücksichtigung des Erwerbs von Tochtergesellschaften

[4] In den Abschreibungen des 2. Quartals sind Sonderabschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten des Segments Substrat Bonder in Höhe von 1,2 Mio. € enthalten.

SEGMENTINFORMATIONEN

FOTOMASKEN EQUIPMENT

Umsatz 2013
18,4 MIO. €

EBIT 2013
1,6 MIO. €

PRODUKTE
Mask Track

ADRESSIERTE MÄRKTE
Halbleiterindustrie

LITHOGRAFIE

Umsatz 2013
88,3 MIO. €

EBIT 2013
3,2 MIO. €

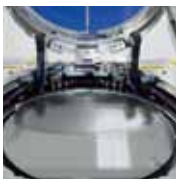
PRODUKTE
Mask Aligner
UV-Projektions-belichtungssysteme
Laser Processing-Systeme
Entwicklungssysteme
Spin- und Spray-Coater

ADRESSIERTE MÄRKTE
Advanced Packaging
Mikrosystemtechnik (MEMS)
Verbindungshalbleiter
3D-Integration

SUBSTRAT BONDER

Umsatz 2013
22,9 MIO. €

EBIT 2013
-21,7 MIO. €



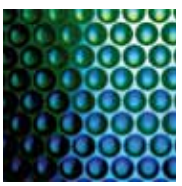
PRODUKTE
Substrat-(Wafer)-Bonder

ADRESSIERTE MÄRKTE
3D-Integration
Mikrosystemtechnik (MEMS)
Verbindungshalbleiter

SONSTIGE

Umsatz 2013
4,9 MIO. €

EBIT 2013
-2,4 MIO. €



PRODUKTE
Mikrooptik und -linsen
C4NP

ADRESSIERTE MÄRKTE
Mikrooptik
Halbleiterindustrie
Advanced Packaging (C4NP)

002 Editorial

006 Bericht des Aufsichtsrats

010
Weltweit steigende Nachfrage nach Elektronikprodukten

015
Hightech aus Sternenfels

019
Lokale Produktion – Globaler Vertrieb

023
Der Mask Aligner wird 50 – eine Erfolgsgeschichte

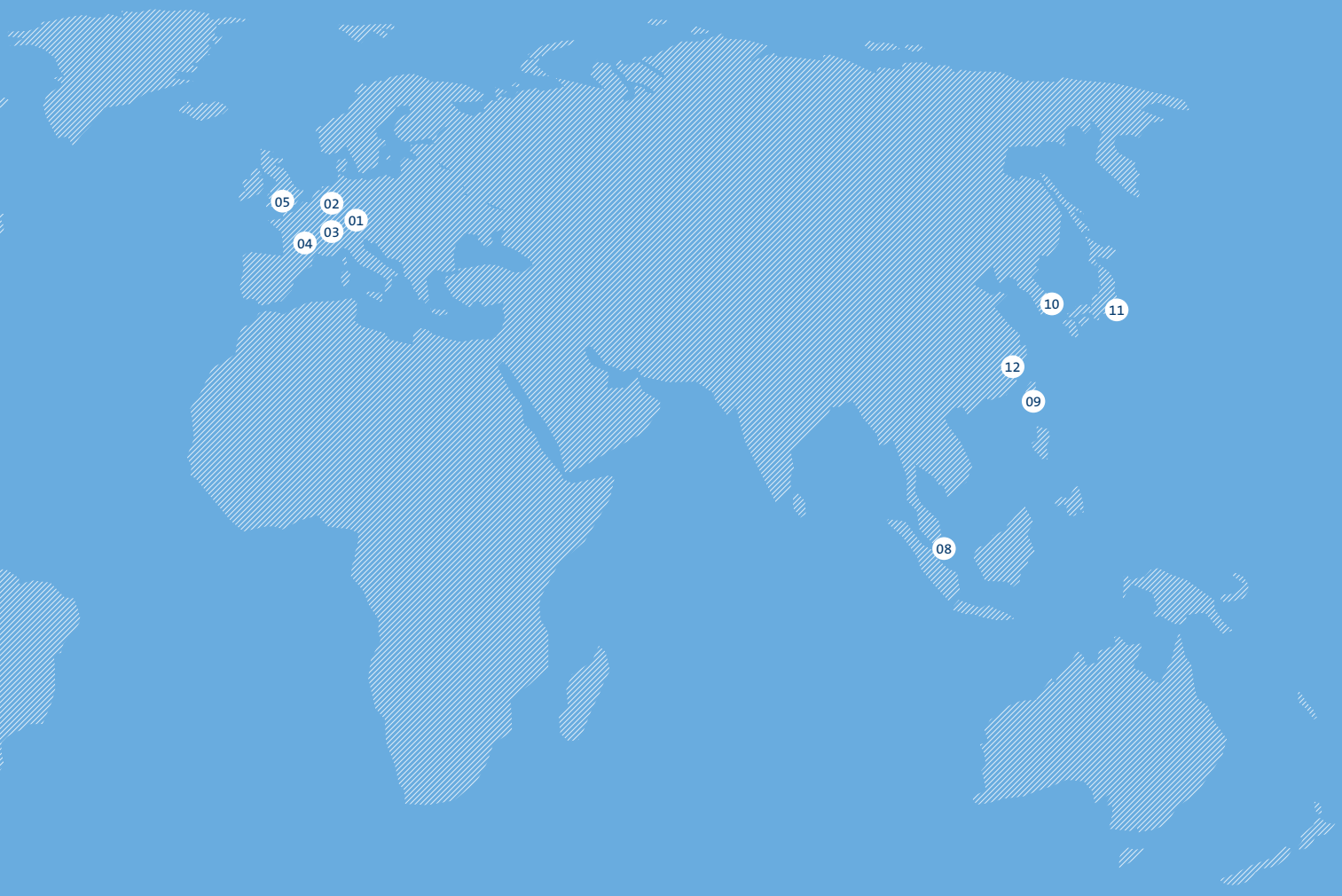
024
Innovative Lösungen für den globalen Markt

026 Investor Relations
030 Corporate Governance
036 Zusammengefasster Lagebericht
075 Konzernabschluss
090 Anhang zum IFRS-Konzernabschluss
148 Glossar

PRODUKTION
01 Garching, DE (Hauptsitz)
02 Sternenfels, DE
03 Hauterive, CH
07 Corona, US

VERTRIEB
04 Lyon, FR
05 Coventry, UK
06 Sunnyvale, US
08 Singapur, SG
09 Hsinchu, TW
10 Hwaseong City, KR
11 Yokohama, JP
12 Shanghai, CN

SÜSS MICROTEC WELTWEIT



NORDAMERIKA

Mitarbeiter	120
Umsatz	30,3 Mio. €

EUROPA

Mitarbeiter	410
Umsatz	40,5 Mio. €

JAPAN

Mitarbeiter	19
Umsatz	16,5 Mio. €

SONSTIGES ASIEN

Mitarbeiter	106
Umsatz	76,5 Mio. €

002

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

lassen Sie uns in diesem Bericht gemeinsam auf ein herausforderndes Geschäftsjahr 2013 zurückblicken. Der gesamte Halbleitermarkt konnte den Schätzungen des Marktforschungsinstituts Gartner zufolge im letzten Jahr ein Wachstum von rund 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Demgegenüber erlebten die Hersteller von Halbleiter-Equipment, zu denen auch SÜSS MicroTec gehört, ein weiteres Jahr mit rückläufigen Umsätzen. Nach einem Rückgang um 16,1 Prozent im Jahr 2012 ist der Equipment-Markt im Jahr 2013 erneut um rund 8,5 % Prozent geschrumpft. Der Spezialbereich Montage und Verpackung schrumpfte sogar um 26 Prozent. Diese schwache Marktentwicklung spiegelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in rückläufigen Auftragseingängen und Umsätzen unseres Unternehmens wider. Die Experten vom Semi-Institut erwarten jedoch für die kommenden Jahre 2014 und 2015 eine Rückkehr auf den Wachstumspfad im Halbleiter-Equipment-Segment. Eine nachhaltig positive Marktentwicklung wird erwartungsgemäß auch für uns zu einer erneuten Belebung des Auftragseingangs führen.

Betrachtet man das abgelaufene Geschäftsjahr von der Kapitalmarktseite, so wird deutlich, dass die Finanzmärkte, nicht zuletzt getrieben von einer expansiven Geldpolitik gepaart mit historisch niedrigen Zinsniveaus, ein sehr positives Jahr 2013 erlebten. In Deutschland durchbrach der Leitindex DAX im Dezember 2013 die 9.500er-Marke und erreichte somit neue Rekordstände. Die Weltkonjunktur stabilisierte sich im gleichen Zeitraum zunehmend, nachdem sie im Jahr 2012 noch unter dem Einfluss der Finanzkrise deutlich an Schwung verloren hatte. Wirtschaftsforscher des International Monetary Funds erwarten für das Gesamtjahr 2013 ein weltweites Wachstum von 3,0 Prozent. Für das Geschäftsjahr 2014 wird derzeit von einem beschleunigten globalen Konjunkturwachstum um 3,7 Prozent ausgegangen. Deutschland steht im kommenden Jahr gleichermaßen eine Aufhellung der konjunkturellen Lage bevor (Sachverständigenrat-Jahresgutachten 2013 / 14).

65 JAHRE HIGHTECH AUS DEM HAUSE SÜSS MICROTEC

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns an dieser Stelle in aller Kürze auf die 65-jährige Erfolgsgeschichte von SÜSS zurückblicken. Das Unternehmen wurde 1949 als Karl Süss KG gegründet und zählt damit nicht nur zu den Urgesteinen der bayerischen Wirtschaft, sondern gilt auch als ein Musterbeispiel für Pionierarbeit und Innovationsfreude im Bereich Hightech-Maschinenbau. Ein wichtiger Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war eine gemeinsame Entwicklung mit Siemens im Jahr 1963, als die ersten Mask Aligner (Justiergeräte) gebaut wurden. Seither ist unser Unternehmen deutlich gewachsen, erschloss neue Märkte und erweiterte die Produktpalette. Neben unseren klassischen Lithografiegeräten Mask Aligner und Coater / Developer gehören Maschinen zur Reinigung von Fotomasken und die Substrat Bonder sowie Laserprozessierungsgeräte und UV-Projektionsscanner zu unserem Produktportfolio. Die Erzeugnisse von SÜSS MicroTec werden weltweit in der Halbleiterproduktion eingesetzt und genießen einen hervorragenden Ruf bei unseren internationalen Kunden. Mit unseren innovativen Lösungen unterstützen wir wichtige Trends in der Elektronikbranche und eröffnen uns damit neue Wachstumsmärkte, wie beispielsweise die 3D-Integration oder die Lasertechnologie.

DAS GESCHÄFTSJAHR IN ZAHLEN

Trotz eines Rekordjahres für die gesamte Halbleiterindustrie ist der Markt für Halbleiter-Equipment ein zweites Jahr infolge geschrumpft. Dieses herausfordernde Umfeld spiegelt sich im Geschäftsverlauf und in den Unternehmenskennzahlen von SÜSS MicroTec wider. Der Auftragseingang im Gesamtjahr 2013 belief sich auf 135,0 Mio. Euro, was ein Minus von 14,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr (157,2 Mio. Euro) bedeutet. Der Umsatz

FRANK AVERDUNG
Vorstandsvorsitzender

MICHAEL KNOPP
Finanzvorstand

war im Jahresvergleich rückläufig und lag mit 134,5 Mio. Euro um 17,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahres (163,8 Mio. Euro). Damit ergibt sich ein Auftragsbestand zum 31. Dezember 2013 in Höhe von 85,7 Mio. Euro (Vorjahr: 86,5 Mio. Euro).

Die Rohertragsmarge verringerte sich im abgelaufenen Gesamtjahr und lag für die SÜSS MicroTec-Gruppe bei 16,2 Prozent (Vorjahr: 35,0 Prozent). Ergebnisbelastend wirkten die schwächeren Margen im Bereich Coater / Developer, insbesondere der ungünstige Mix aus 200 mm und 300 mm-Maschinen in der Coater-Produktlinie. Typischerweise herrscht in dieser Produktlinie ein ausgewogener Mix zwischen den margenstarken 300 mm Systemen und den 200 mm-Systemen, welche aufgrund des höheren Wettbewerbs in diesem Segment eine geringere Rohertragsmarge aufweisen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es einen unterdurchschnittlichen Anteil an 300 mm-Systemen in Auftragseingang und Umsatz, was insgesamt zu einer Verringerung der Rohertragsmarge im Segment Lithografie führte. Zudem belastete der negative Ergebnisbeitrag von SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack Scientific) die Rohertragsmarge im Lithografie-Segment. Ein weiterer belastender Faktor entstammt dem Segment Substrat Bonder, hier initiierte SÜSS MicroTec Anpassungen in der Produktlinie permanentes Bonden, was sich zum Teil negativ auf die Bruttomarge ausgewirkt hat. Einzelheiten zu den durchgeführten Maßnahmen in dem Segment Substrat Bonder finden Sie in einem gesonderten Kapitel des Vorstandsvorworts.

Das Kernsegment des Konzerns, die Lithografie, verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr um 22 Prozent auf 88,3 Mio. Euro (Vorjahr: 113,2 Mio. Euro). Im Segment Substrat Bonder verringerte sich der Umsatzbeitrag leicht auf 22,8 Mio. Euro (Vorjahr: 23,1 Mio. Euro). Dies entspricht einem Minus von 1,3 Prozent. Der Bereich Fotomasken Equipment hat einen Umsatz von 18,4 Mio. Euro nach 22,9 Mio. Euro im Vorjahr erwirtschaftet.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit minus 19,4 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 11,7 Mio. Euro, dies entspricht einer EBIT-Marge von minus 14,4 Prozent. Das EBIT für das Geschäftsjahr 2013 enthält eine Sonderbelastung in Höhe von 13,2 Mio. Euro, welche aus der Restrukturierung des Segments Substrat Bonder resultiert. Das bereinigte Ergebnis liegt somit bei minus 6,2 Mio. Euro. »

Das Ergebnis nach Steuern (EAT) belief sich für das fortgeführte Geschäft auf minus 16,0 Mio. Euro nach 7,6 Mio. Euro im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) belief sich für das fortgeführte und nicht fortgeführte Geschäft auf minus 16,0 Mio. Euro nach 9,1 Mio. Euro im Vorjahr. Im Ergebnis des Vorjahres ist ein steuerfreier Ertrag in Höhe von 1,5 Mio. Euro, welcher aus dem Verkauf der Testsysteme in 2010 resultiert, enthalten. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) aus fortgeführten Aktivitäten beträgt minus 0,84 Euro (Vorjahr: 0,40 Euro).

Der Freie Cashflow belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapieren und Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten zum Ende des Geschäftsjahres auf 4,1 Mio. Euro nach minus 4,5 Mio. Euro im Vorjahr. Damit verfügte die SÜSS MicroTec-Gruppe zum 31. Dezember 2013 über liquide Mittel und verzinsliche Wertpapiere in Höhe von 47,1 Mio. Euro. Die Net Cash-Position erhöhte sich trotz der Kaufpreiszahlung in Höhe von 8,9 Mio. Euro für den Immobilienerwerb am Standort Garching im Vergleich zum 31. Dezember 2012 von 32,3 Mio. Euro auf 35,7 Mio. Euro.

MEILENSTEINE 2013

Bereits im Januar 2013 hatten wir den Kauf der Immobilie am Firmenhauptsitz Garching bekannt gegeben. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages fand am 23. Januar 2013 statt und der rechtliche Übergang der Immobilie erfolgte zum 30. September 2013. Mit dem Erwerb sichern wir uns neben der Mietersparnis ein hohes Maß an operationaler Flexibilität im Hinblick auf unternehmensspezifische Anforderungen an die Immobilie und bekennen uns klar zur Produktion in Garching.

Produktseitig konnten wir im Geschäftsjahr 2013 verschiedene zukunftsträchtige Aufträge verbuchen. Ein führender internationaler IDM (Integrated Device Manufacturer) hat einen Folgeauftrag für die neueste Generation von Produktions-Bond-Clustern bei uns platziert. Der Kunde, der bereits 2012 erste Geräte von SÜSS MicroTec installiert hat, plant mit den neu bestellten Systemen als weltweit erstes Unternehmen in die Vorserienproduktion einzusteigen. Die Systeme wurden für das temporäre Bonden von 300 mm-Wafern für 3D-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen konfiguriert.

Wir haben zudem erste Aufträge für unser ELP300 Excimer Laser-Stepper System erhalten. Zu den Kunden gehören zwei US-amerikanische IDMs, ein asiatischer OSAT und das Fraunhofer IZM, Berlin. Die ELP300-Stepper-Plattform für Wafergrößen von 200 und 300 mm bedient sich eines Excimer Lasers. Mit Hilfe dieser Lasertechnologie können, unter Umgehung der herkömmlichen Lithografie- und Ätzverfahren, Mikrostrukturen direkt auf dem Substrat hergestellt werden. Neben Kostenvorteilen im Produktionsprozess erfüllt das System darüber hinaus die Anforderungen an die neuesten Halbleiter-Packaging Prozesse. Das Verfahren ist besonders umweltfreundlich, da durch direkten Materialabtrag Ätzprozesse mit giftigen Chemikalien vermieden werden können. Wir sehen großes Potenzial für diese neuartige Technologie, insbesondere in unserem angestammten Zielmarkt Advanced Packaging sowie dem attraktiven Wachstumsmarkt 3D-Integration.

Kundenzufriedenheit ist ein wichtiger Erfolgsfaktor in unserer Branche. Aufgrund der außerordentlichen Leistungen unserer Mitarbeiter konnten wir im Geschäftsjahr 2013 von zwei namhaften asiatischen Packaging Häusern, SPIL und Amkor, eine Auszeichnung für unsere herausragenden Leistungen als Zulieferer bekommen. Wir möchten an dieser Stelle dem Engagement und der Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter ganz herzlich danken.

STRATEGISCHE UNTERNEHMENSENTSCHEIDUNG ZUR PRODUKTLINIE PERMANENT BONDING

Am 6. November 2013 haben wir bekannt gegeben, dass aufgrund einer Neubewertung unserer Geschäftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie, die im zweiten Quartal dieses Jahres eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erweitert werden und die Produktion von Permanenten Bond Cluster Systemen eingestellt wird. Die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent Bonding Systeme sowie die temporären Bonding Systeme waren von dieser Maßnahme nicht betroffen.

In diesem Zusammenhang sind im vierten Quartal 2013 Sonderaufwendungen in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. Euro entstanden. Davon resultieren 6,7 Mio. Euro aus der Abwertung von Vorräten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie Demoequipment) und 1,6 Mio. Euro aus vorsorglich gebildeten Rückstellungen für einzelne Kundenprojekte. Für das Gesamtjahr ergibt sich aus den Restrukturierungsmaßnahmen im Segment Substrat Bonder eine Sonderaufwendung von insgesamt 13,2 Mio. Euro. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwarten wir eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder.

AUSBLICK

Für das laufende Jahr sehen die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute durchweg positiv aus. Die Krisenländer in der Eurozone haben Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gemacht und die Sparanstrengungen zeigen langsam ihre Wirkung. Obwohl in einzelnen europäischen Ländern noch deutlich mehr Anstrengungen unternommen werden müssen, sieht eine erste Zwischenbilanz verhalten optimistisch aus. Im Jahr 2014 wird Europa voraussichtlich wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und das Bruttoinlandsprodukt könnte erneut leicht zulegen (Sachverständigenrat – Jahresgutachten 2013/14).

Nach zwei schwierigen Jahren mit rückläufigem Geschäftsvolumen erwartet das Marktforschungsinstitut Gartner für 2014 in der Halbleiter-Equipment-Branche (Frontend und Backend) einen erneuten Anstieg der Nachfrage um 15,8 Prozent.

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2013 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2014 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2014 in der Bandbreite zwischen 135 Mio. Euro und 145 Mio. Euro und ein Ergebnis (EBIT) zwischen minus 5 und 0 Mio. Euro.

Wir schauen gemeinsam auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr zurück und möchten allen Mitarbeitern für ihren Einsatz in diesem herausfordernden Umfeld danken!

Garching, im März 2014

Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp
Finanzvorstand

006

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

DR. STEFAN REINECK
Aufsichtsratsvorsitzender

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2013 informieren.

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben nachgekommen und hat den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit uns ab und unterrichtete uns regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden im Einzelnen erläutert und von uns anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir mit dem Vorstand ausführlich erörtert, und zu zustimmungspflichtigen Geschäften haben wir unsere Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2013 fanden insgesamt sieben ordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. An diesen Sitzungen haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Darüber hinaus stand der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand und den Jahresabschlussprüfern, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Niederlassung München, zu Themen der Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung. Es gab keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offenzulegen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre.

SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Finanzlage, die Investitionsprojekte sowie die Geschäftsentwicklung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unterrichtete umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers befasst. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen eingegangen.

Am 12. Februar 2013 fand die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres 2013 statt. Hierbei befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2012 und zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2012. Die Planung für das Geschäftsjahr 2013 wurde intensiv diskutiert. Zudem wurde über die mittelfristige Planung der Jahre 2013 bis 2015 beraten. Dem Aufsichtsrat wurde ein Update der strategischen Projekte präsentiert. Weiterhin wurden die kurzfristigen Ziele und die langfristigen Dreijahresziele für die Bonusvereinbarungen mit dem Vorstand erörtert. Abschließend wurde die nicht zufriedenstellende Geschäftssituation im Segment Substrat Bonder diskutiert.

Weiterhin führte der Aufsichtsrat in dieser Sitzung seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden. Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsratstätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln im Plenum mit Unterstützung von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

An der zweiten Sitzung am 26. März 2013 haben Vertreter unseres Abschlussprüfers, der BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teilgenommen. Der Aufsichtsrat wurde vom Wirtschaftsprüfer über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 informiert. Der Abschlussprüfer erläuterte uns die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2012 und zur aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2013 haben wir zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2012. Außerdem wurde über den Bericht des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr Beschluss gefasst. Über die Planung für das Geschäftsjahr 2013 sowie für die Mehrjahresplanung 2013 bis 2015 wurde intensiv diskutiert. Der Planung für das Geschäftsjahr 2013 wurde zugestimmt. Der Vorstand gab uns zudem ein Update zu den laufenden strategischen Projekten. Der Aufsichtsrat befasste sich ausführlich mit der Situation des Segments Substrat Bonder. Der Vorstand präsentierte hierzu eine umfangreiche Analyse. Es erfolgte eine Diskussion zu den Themen Marktsituation und Marktanteile, Auftragsentwicklung, Margen, Kostenentwicklung sowie Kostencontrolling. Der Vorstand stellte dem Aufsichtsrat verschiedene Turnaround-Szenarien für das Segment Substrat Bonder vor und diskutierte mögliche strategische Optionen. Der Aufsichtsrat fasste Beschluss über den Vorstandsbonus für das Geschäftsjahr 2012 und erörterte die Ziele des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 sowie die langfristigen Dreijahresziele. Darüber hinaus wurden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 19. Juni 2013 erörtert und darüber Beschuss gefasst.

Am 7. Mai 2013 fand die dritte ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung war ein Aufsichtsratsmitglied per Telefonkonferenz zugeschaltet. Wir haben uns mit den aktuellen Zahlen zum ersten Quartal 2013 und der Prognose für das Gesamtjahr befasst. Im Rahmen dieser Sitzung hat der Vorstand dem Aufsichtsrat ein Update zum Stand der laufenden strategischen Projekte vorgelegt und erläutert. Der Aufsichtsrat fasste darüber hinaus Beschluss über Zielvereinbarungen für den Vorstand für das Geschäftsjahr 2013. Der Aufsichtsrat befasste sich erneut mit dem Bereich Permanentes Bonden. Dabei wurden noch einmal ausführlich die verschiedenen Optionen für einen Turnaround beleuchtet. Nach intensiven Diskussionen fasste der Aufsichtsrat Beschluss und stimmte der Fokussierung auf MEMS- und LED-Anwendungen zu unter der Maßgabe nach Ablauf von sechs Monaten einen gründlichen Review durchzuführen und der zeitnahen Einschaltung einer kompetenten Unternehmensberatung, die einer objektiven Berichterstattungspflicht an den Aufsichtsrat unterliegt. »

In der Sitzung am 19. Juni 2013, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage informiert. Wir haben außerdem vom Vorstand ein Update zu möglichen M&A-Projekten sowie ein kurzes Briefing zur bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung erhalten. Es wurden die Fortschritte im Bereich Permanentes Bonden aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen diskutiert und bewertet.

Am 6. August 2013 fand die fünfte ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung wurde dem Aufsichtsrat ein Update zum laufenden Geschäft und dem Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben. Insbesondere erörterten Vorstand und Aufsichtsrat den Status der strategischen Projekte und die Situation bei SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. Der Vorstand präsentierte dem Aufsichtsrat detaillierte Analysen zur Margen- und Kostenentwicklung sowie zu den Voraussetzungen für eine Rückkehr zu einem positiven operativen Ergebnis für den SÜSS MicroTec-Konzern. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat erneut mit dem Bereich Permanentes Bonden sowie Möglichkeiten einer Umorganisation zur Verbesserung der Strukturen im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Er befasste sich zudem mit dem Thema Sales und Service bei SÜSS MicroTec. Weiterhin fasste der Aufsichtsrat Beschluss zu Vorstandsangelegenheiten sowie zur Liquidation der SUSS MicroTec Precision Photomask, Inc.

Der Aufsichtsrat fasste am 11. Oktober 2013 per Umlaufverfahren Beschluss über die Finanzierung des Kaufs der Immobilie am Standort Garching.

Am 6. November 2013 fand die sechste ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung war ein Aufsichtsratsmitglied per Telefonkonferenz zugeschaltet. Der Vorstand berichtete über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den aktualisierten Ausblick auf das Gesamtjahr. Weiterhin stellte der Vorstand ein Maßnahmenpaket zur firmenweiten Kostensenkung, Eliminierung von Verlusten in einzelnen Produktlinien, strukturellen Vereinfachung in der Organisation und zur Erhöhung der Motivation der Belegschaft vor.

Darüber hinaus berichtete der Vorstand über den Status der laufenden strategischen Projekte und es wurden die wirtschaftliche Entwicklung bei der SUSS MicroTec Photonic Systems, die Entsprechenserklärung sowie die Prüfungsschwerpunkte für das Jahr 2013 erörtert. Auf Basis einer Analyse zur Situation des Bereiches Permanentes Bonden von einer beauftragten Unternehmensberatung sowie aufgrund der aktuellen Markteinschätzung beurteilte der Aufsichtsrat die Situation, fasste Beschluss und stimmte zu, die im zweiten Quartal des Jahres 2013 eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zu erweitern und die Produktion und den Vertrieb von Permanenten Bond Cluster-Systemen einzustellen.

Am 4. Dezember 2013 fasste der Aufsichtsrat per Umlaufverfahren nochmals Beschluss über die Finanzierung des Kaufs der Immobilie am Standort Garching.

Gegenstand der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2013, die am 17. Dezember 2013 stattfand, waren die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Planung für das Geschäftsjahr 2014 und die Dreijahresplanung. Darüber hinaus präsentierte der Vorstand dem Aufsichtsrat ein weiteres Update zum Stand der strategischen Projekte. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Corporate Governance und dabei insbesondere mit den Themen Entsprechenserklärung, Compliance Management sowie dem Fraud-Katalog der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Darüber hinaus beschäftigte er sich mit dem Risikomanagement von SÜSS MicroTec. In der letzten Aufsichtsratssitzung des Jahres wurden die verbliebenen Aktivitäten im Bereich Permanente Bond Cluster sowie das Thema Temporäres Bonden besprochen.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2013 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt

Vergütungsbericht des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 59 ff. wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben am 15. Januar 2013 die jährliche Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

JAHRES- UND KONZERN-ABSCHLUSSPRÜFUNG

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Niederlassung München, hat den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2013, den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 sowie den zusammengefassten Lagebericht geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigstelle München, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 26. März 2014 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Prüfungsschwerpunkte der diesjährigen Abschlussprüfung waren unter anderem Umsatzrealisierung, Abbildung der Einstellung der Produktlinie Permanent-Bond-Cluster-Systeme, Entwicklung der Verpflichtung für variable Kaufpreisbestandteile aus dem Erwerb der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (vormals: Tamarack Scientific Co., Inc.), Werthaltigkeit der Geschäfts- oder Firmenwerte, Ermittlung latenter Steuern, Umsetzung von DRS 20 im Konzernlagebericht, Plausibilität der prognostischen Angaben und die retrospektive erstmalige Anwendung des IAS 19 (2011).

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der SÜSS MicroTec AG wurden von uns geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers haben wir nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem zusammengefassten Lagebericht für die SÜSS MicroTec AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens haben wir zugestimmt.

Im Geschäftsjahr 2013 gab es keine personellen Änderungen im Vorstand.

Für die tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung aus.

Garching, 26. März 2014

Für den Aufsichtsrat

Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender

010

WELTWEIT STEIGENDE NACHFRAGE NACH ELEKTRONIK-PRODUKTEN

DIE RAPIDE VERBREITUNG VON KOMMUNIKATIONSMITTELN FÜHRT NICHT NUR ZU EINER WELTWEITEN VERNETZUNG IM BEREICH DER WIRTSCHAFT, SONDERN AUCH ZUR DEUTLICHEN AUSWEITUNG UND VERDICHTUNG VON SOZIALEN NETZWERKEN SOWIE ZU EINER GLOBALEN VERBREITUNG VON IDEEN

Der Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich in den letzten Jahren in allen Regionen der Welt erhöht. Betrachtet man die Wachstumszahlen über einen längeren Zeitraum, so wird die rasante Entwicklung besonders deutlich. Weltweit stieg die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse von 34 Millionen im Jahr 1993 auf rund 6,8 Milliarden im Jahr 2013. (Quelle: Statista 2014). Mit unseren Produkten und Lösungen zum Advanced Packaging und der MEMS-Fertigung sind wir an der Weiterentwicklung moderner Kommunikationsmedien maßgeblich beteiligt. »

Jederzeit online und mobil erreichbar

ACS200 Gen3 für die Volumenproduktion von MEMS, Advanced Packaging und LED

» WACHSTUMSMOTOR ASIEN

Ein wichtiger Wachstumsfaktor ist die junge Generation, egal ob in Europa, Asien oder Amerika; das Internet, Facebook und Wikipedia sind ständige Begleiter. Über Smartphones und Tablet Computer ist man jederzeit online und kann mit Freunden und Geschäftspartnern weltweit kommunizieren. Die Integration von Hightech in das tägliche Leben schreitet unaufhaltsam voran und dies nicht mehr nur in den Industrienationen, sondern auch bzw. besonders in den sich entwickelnden Ländern. Auch bei der Herstellung von Elektronikgeräten ist die Globalisierung vorangeschritten und hat in den vergangenen Jahren eine spürbare Verschiebung des Schwerpunktes bewirkt.

Die neuesten technologischen Entwicklungen sowie die größten Hersteller von Hightech-Produkten kommen mittlerweile zu einem nicht unerheblichen Anteil aus Asien. Es wird sich schwerlich ein Mobiltelefon, Computer oder ein sonstiges elektronisches Endgerät finden, in welchem nicht eine Vielzahl von Komponenten oder das gesamte Endgerät in Asien entwickelt und hergestellt wurde. Während in Westeuropa und Nordamerika die sinkenden Wachstumsraten für den Verkauf z. B. von Smartphones und Tablet Computern erste Anzeichen einer vorübergehenden Sättigung

Im Vergleich zu den USA und Europa weist Asien weiterhin deutlich höhere Wachstumsraten auf.

des Marktes andeuten, so ist die Nachfrage nach erschwinglichen Endgeräten in Asien ungebrochen hoch. Allein die flächendeckende Versorgung mit Mobiltelefonen in den bevölkerungsreichen Ländern China und Indien könnte zu einem erneuten, deutlichen Wachstumsschub in der Technologiebranche führen.

MA / BA8 Gen3 – unsere spezielle Entwicklung für 3D- und MEMS-Anwendungen

GLOBALER SERVICE FÜR INTERNATIONALE KUNDEN

Betrachtet man die Halbleiterbranche im Detail, so wird schnell deutlich, dass erhebliche Bereiche auf Asien fokussiert sind. Dazu gehört zum Beispiel auch das Halbleiter-Mid- und Backend. Ein bedeutender Teil der großen Packaging-Häuser (OSATs) ist in Asien ansässig. Zudem sind viele der global agierenden Hersteller von Speichermedien und MEMS-Bauteilen in Asien zu Hause.

SÜSS MicroTec zählt eine Vielzahl dieser Unternehmen zu seinen Kunden. Um mit diesen global agierenden Firmen langfristig in Geschäftsbeziehungen zu bleiben, ist eine umfassende Betreuung durch Service- und Vertriebsmitarbeiter notwendig. SÜSS MicroTec ist mit seinen Vertriebs- und Servicestandorten in den Hightech-Zentren kundennah vertreten und bei Bedarf 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar. Hochqualifizierte Ingenieure und Techniker betreuen die Kunden und haben so über die Jahre ein detailliertes Verständnis für die speziellen Anforderungen der einzelnen Kunden aufbauen können. Dies ist ein wichtiger Service, den lokale Wettbewerber häufig nicht anbieten können und somit keinen Zugang zu international agierenden Kunden bekommen.

»

Zu den wichtigsten asiatischen Standorten von SÜSS MicroTec gehören Singapur, Shanghai (China), Hsinchu (Taiwan) sowie Hwaseong City (Korea) und Yokohama (Japan). An diesen Standorten werden kontinuierlich Anpassungen der Standortgrößen an die entsprechende regionale Nachfrage vorgenommen. So wurde in den Jahren 2012 / 2013 der Standort Korea deutlich ausgebaut, um ein Projekt im Bereich 3D-Integration mit einem wichtigen Kunden voranzutreiben. Die Region Japan hat dagegen an Bedeutung verloren und entsprechend wurde die Standortgröße angepasst. Insgesamt erwirtschaftete SÜSS MicroTec im Jahr 2013 mehr als 60 Prozent des gesamten Umsatzes in Asien.

SÜSS MICROTEC MITARBEITER IN ASIEN

INNOVATIONEN DURCH ZUSAMMENARBEIT MIT FORSCHUNGSINSTITUTEN

Ein einzelnes Unternehmen wie SÜSS MicroTec ist aufgrund der hohen Komplexität der Aufgabenstellungen häufig nicht in der Lage, große Entwicklungsthemen allein zu stemmen. Für die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse arbeitet das Unternehmen mit internationalen Forschungsinstituten zusammen. Die Forschungseinrichtungen werden in der Regel von Industrieunternehmen, welche wiederum Kunden von SÜSS MicroTec sind, finanziert und unterstützt. In diesem Rahmen werden neue Basisprozesse auf SÜSS MicroTech-Maschinen entwickelt, welche später ihren Weg zu den Industriekunden und damit in die Volumenproduktion finden. «

DR. CT LIU
Vice President, Industrial Technology Research Institute (ITRI), Taiwan

„Das Industrial Technology Research Institute (ITRI) ist eine gemeinnützige Entwicklungsorganisation in Taiwan mit globaler Ausrichtung, die im Bereich angewandte Forschung und technische Dienstleistungen tätig ist. Das ITRI dient der Industrie als technisches Zentrum und als inoffizieller Zweig für die Industriepolitik der taiwanesischen Regierung. Dr. CT Liu (Vice President des ITRI) ist für die Forschungsaktivitäten der Elektronik- und Optoelektronikindustrie verantwortlich.

Mit der steigenden Nachfrage nach mobiler Elektronik wird die „Systemskalierung“ zu einem entscheidenden Faktor für die Vorteile größerer Bandbreiten und eines minimierten Energieverbrauchs. Den Kern der Systemskalierung bildet die 3D-Integration, die das vertikale Stapeln heterogener Komponenten durch TSV und Microbumps ermöglicht. ITRI und SÜSS sind seit langer Zeit Kooperationspartner bei verschiedenen führenden Technologien. Ein Beispiel dafür ist die Technologie des direkten 3D-Wafer-Bondens / -Debondens. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat ITRI einen Temporary Bonder installiert, der neueste bei den Massenproduktionssystemen, der in einer 300-mm-Pilot-Produktlinie verwendet wird. Diese Pilot-Produktlinie soll den technologischen Fortschritt für die Integration von 3D in der Industrie beschleunigen. Mit projektbasierten Forschungsaktivitäten unterstützt ITRI seine inländischen und internationalen Partner dabei, Massenproduktion von Zukunftstechnologien zu beschleunigen.“

HIGHTECH AUS STERNENFELS

NACH EINER WEITREICHENDEN NEUORGANISATION DER STANDORTE UMFASST DIE WELTWEITE PRÄSENZ NUNMEHR DIE DREI WESENTLICHEN PRODUKTIONSSTANDORTE CORONA, GARCHING UND – ALS GRÖSSTEN STANDORT – STERNENFELS

Das moderne Produktionsgebäude in Sternenfels ermöglicht es SÜSS MicroTec, vielfältige Synergien in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung und Produktion zu nutzen. Die drei Produktlinien Substrat Bonder, Photomask Equipment und Coater / Developer sind hier angesiedelt und erwirtschaften mehr als 50 Prozent der Wertschöpfung im Unternehmen. Die Produktionsstandorte werden ergänzt durch ein weltweites Netz aus Vertriebs- und Serviceniederlassungen. »

» DYNAMISCHE MÄRKTE UND INNOVATIVE PRODUKTE

In allen Produktbereichen des Unternehmens wird konsequent an der Weiterentwicklung und Verbesserung bestehender Produkte gearbeitet. Mit den Geräten zur Reinigung von Fotomasken ist SÜSS MicroTec mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent der weltweit größte Anbieter und unterstützt durch innovative Technologien die sogenannte Shrink Roadmap – auch „Moores Law“ genannt.

Dagegen handelt es sich bei „More than Moore“ um ein Synonym für die 3D-Integration, das Stapeln gedünnter Mikrochips. Dies ist eine alternative Technologie, um die Komplexität und Funktionalität von elektrischen Schaltungen zu erhöhen, ohne dass eine kostenintensive Verkleinerung der Strukturgrößen nötig ist. Mit den Lösungen zum Thin Wafer-Handling und den temporären Bondern unterstützt SÜSS MicroTec diesen vielversprechenden Zukunftstrend. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein Auftrag für ein solches Bonding-System aus Sternenfels, welches in der weltweit ersten Pilotserienproduktion eingesetzt werden soll, gewonnen werden.

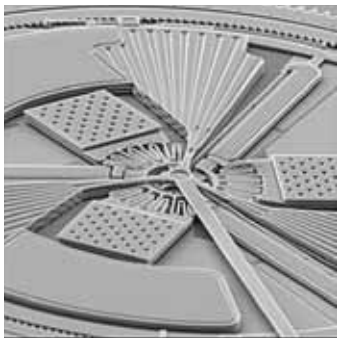
Erneut konnten sich somit die technologisch führenden Produkte von SÜSS MicroTec gegen die globale Konkurrenz – teilweise deutlich größerer Wettbewerber – erfolgreich durchsetzen.

Mit dem Mask Track Pro unterstützt SÜSS MicroTec die Frontend-Lithografieprozesse 193i und EUV

SÜSS MicroTec ist zudem führender Anbieter von Prozessen und Lösungen für den Advanced Packaging-Markt. Hierbei handelt es sich um eine alternative Verpackungstechnologie zum klassischen Wire-Bonding. Mit der rapiden Verbreitung von Smartphones hat sich der Markt für kleine Packages, für deren Herstellung Advanced Packaging-Technologien benötigt werden, vergrößert. Mit seinen anspruchsvollen Lithografielösungen für das Advanced Packaging, z. B. in den Produktlinien Coater und Developer, erwirtschaftet das Unternehmen einen nicht unerheblichen Anteil seines gesamten Umsatzes. Dieser Markt wird sich auch in Zukunft positiv entwickeln, da die Nachfrage nach immer kleineren und dichter gepackten Mikrochips stetig ansteigt. Moderne Packaging-Technologien wie das Wafer Level Packaging und ähnliche Verfahren werden in Zukunft verstärkt nachgefragt werden. Durch die enge Zusammenarbeit der Forschungs- und Entwicklungsabteilung mit der Produktion am Standort Sternenfels ist eine kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung der Geräte möglich.

Ein weiterer Markt, der sich in den vergangenen Jahren besonders dynamisch entwickelt hat, ist der Markt für MEMS-Sensoren. Ein wichtiger Wachstumsbeschleuniger war auch in diesem Marktsegment das rapide Wachstum bei Smartphones und Tablet Computern. In beiden Geräten sind aktuell

Nahaufnahme eines MEMS-Sensors



im Schnitt rund zehn verschiedene MEMS-Bausteine verarbeitet. Daneben kommen mit der Automobilindustrie, der Unterhaltungselektronik und der Medizintechnik weitere wichtige Absatzmärkte hinzu.

Die mikro-elektromechanischen Systeme sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und es kommen ständig neue Anwendungsfelder hinzu. Bei einem MEMS-Sensor handelt es sich um ein in sich geschlossenes System, welches eine physikalische Veränderung beim Druck, der Temperatur oder eine Beschleunigung wahrnimmt und diese Information in einen elektrischen Impuls umwandelt. In Smartphones kommt diese Eigenschaft bei der Navigationsfunktion oder als MEMS-Mikrofon zum Einsatz. Um diese Funktionen zuverlässig auszuführen, muss das MEMS-System hermetisch von der Umwelt abgeschlossen sein. In einem manuellen permanenten Bonder von SÜSS MicroTec wird dieser Arbeitsschritt vorgenommen, bevor die einzelnen MEMS-Bausteine aus dem Wafer herausgetrennt werden.

Bei der LED-Herstellung kommt ein ähnliches Verfahren zum Einsatz. Nachdem die Leuchtdiode durch lithografische Verfahren hergestellt wurde, wird anstatt einer hermetischen Versiegelung, eine Spiegelfläche auf die Rückseite der LED gebondet. Dadurch wird erreicht, dass sich das Licht in eine gewünschte Richtung bewegt, um somit die Lichtausbeute zu erhöhen. Die LED-Industrie befindet sich nach wie vor in einer schwierigen Situation, aber erste Anzeichen einer langsamen Erholung sind bereits spürbar.

FOKUSSIERUNG AUF PROFITABLES WACHSTUM – RESTRUKTURIERUNG PERMANENTE BONDSYSTEME

Im Mai 2013 hat das Unternehmen eine strategische Unternehmensentscheidung im Hinblick auf die Produktlinie permanentes Bonden bekannt gegeben. Vor dem Hintergrund der unbefriedigenden Ertragslage der Produktlinie Permanent Bonding hat der Vorstand von SÜSS MicroTec eine Refokussierung der Produktlinie mit dem Schwerpunkt auf MEMS- und LED-Anwendungen beschlossen. Damit sollte dem technologischen Fortschritt des Produktportfolios und der Marktentwicklung der letzten Jahre Rechnung getragen werden. Daraufhin wurden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnissituation eingeleitet. Eine Kontrolle der selbstgesetzten Ziele wurde zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr festgelegt. Im November 2013 hat der Vorstand aufgrund der Neubewertung der Geschäftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie beschlossen, die im zweiten Quartal eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen zu erweitern und die Produktion von Permanenten Bond Cluster-Systemen einzustellen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das Management von SÜSS MicroTec eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder. Im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen sind im Geschäftsjahr 2013 einmalige Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. Euro angefallen.

Die am Markt erfolgreichen manuellen permanenten Bonding-Systeme sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass das Wachstum des Bereichs Substrat Bonder in Zukunft wesentlich durch die Produktlinie Temporary Bonding bestimmt wird, welche bereits erste Erfolge am Markt erzielen konnte. Mehr dazu erfahren Sie im folgenden Abschnitt. »

» HEUTE VORSERIENFERTIGUNG – MORGEN VOLUMENPRODUKTION

Während bei permanenten Bondprozessen eine nicht mehr zu lösende Verbindung zwischen zwei Wafern angestrebt wird, ist es beim temporären Bonden das Ziel, zwei Wafer nur zeitweise miteinander zu verbinden, um sie später wieder voneinander zu lösen. Das temporäre Bonden dient dabei als wichtiger Zwischenschritt beim sogenannten Thin Wafer-Handling für die 3D-Integration.

Ein Ziel der 3D-Integration ist es, möglichst kurze Versorgungs- und Signalleitungen zwischen den einzelnen Bauelementen zu erzeugen, um die Verlustleistung und die daraus entstehende Abwärme zu reduzieren sowie auf kleinstem Raum möglichst viele Bauelemente zu platzieren. Kurze Signalleitungen durch andere Bauelemente hindurch lassen sich aber nur mit einem vertretbaren Aufwand und einem angestrebten Nutzen herstellen, wenn die Mikrochips dünn genug gefertigt werden, damit die Leitungen möglichst kurz ausgeführt werden können. Das bedeutet wiederum, dass die Wafer im Laufe der Fertigung auf eine Dicke von etwa 50 µm bis 100 µm gedünnt werden müssen. Um die Wafer nach dem Dünnschleifen noch mit normalen Fertigungsmaschinen prozessieren zu können, werden diese vorab temporär auf einen anderen Trägerwafer aus Silizium oder Glas gebondet. Dies geschieht beispielsweise in Bond-Clustern von SÜSS MicroTec.

Im Geschäftsjahr 2013 hat SÜSS MicroTec von einem international führenden IDM (Integrated Device Manufacturer) einen Folgeauftrag für die neueste Generation von Produktions-Bond-Clustern erhalten. Der Kunde, der bereits 2012 erste Geräte des Unternehmens installiert hatte, plant mit den neu bestellten Systemen in die Vorserienproduktion einzusteigen. Die Systeme wurden für das temporäre Bonden von 300-mm-Wafern für 3D-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen konfiguriert. Die Endabnahme der Bond-Cluster durch den Kunden erfolgte zum Jahreswechsel 2013 / 2014.

Dieser internationale Referenzkunde ist weltweit der erste und bisher einzige Halbleiteranbieter, der in die Vorserienproduktion gestapelter Mikrochips (3D-Integration) eingestiegen ist. Im Wettbewerb um diesen Kunden konnten sich die Maschinen und Lösungen von SÜSS MicroTec und deren Prozesspartner gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen und haben damit einen ersten Standard für zukünftige Anwendungen gesetzt. Nach erfolgreicher Installation und Testphase der Pilotserie, erwarten wir den Einstieg des Kunden in die Volumenfertigung. «

XBS300 – Temporärer Bond-Cluster
für die 3D-Serienproduktion

LOKALE PRODUKTION – GLOBALER VERTRIEB

CORONA, EINE MITTELGROSSE STADT IM RIVERSIDE COUNTY IM US-BUNDESSTAAT KALIFORNIEN, HAT RUND 160.000 EINWOHNER UND ERSTRECKT SICH ÜBER EINE STADTFLÄCHE VON ETWA 270 KM²

Im westlichen Stadtgebiet befindet sich die SUSS MicroTec Photonic Systems (ehemals Tamarack Scientific), welche seit April 2012 zur SÜSS MicoTec-Gruppe gehört. Das Unternehmen besetzt mit seinen innovativen Produkten und Lösungen rund um die Laserprozessierung und die UV-Projektionslithografie im Halbleiter-Mid- und Backend spannende Bereiche, die zukünftig deutlich an Bedeutung gewinnen werden. Zu den Kunden gehören US-amerikanische und mittlerweile auch internationale IDM und OSATs sowie Forschungsinstitute.

Dr. Markus Arendt, ehemaliger Leiter der globalen Operations (COO) ist seit Ende 2013 als General Manager für die SUSS MicroTec Photonic Systems in Corona tätig. In einem kurzen Interview (nächste Seite) beantwortet Dr. Arendt uns einige Fragen rund um die SUSS MicroTec Photonic Systems. »

DR. MARKUS ARENDT
General Manager für die SUSS MicroTec Photonic Systems in Corona

» ***Welches Potenzial sehen Sie für die Lasertechnologie?***

Dr. Arendt: Mit Erwerb der ehemaligen Tamarack Scientific, jetzt SUSS MicroTec Photonic Systems, hat sich SÜSS MicroTec erstmalig in den Bereich Lasertechnologie bewegt. Bisher findet die Lasertechnologie nur wenig Einsatz im Halbleiter-Mid- und Backend, aber wir erwarten mittelfristig, dass die Bedeutung von Lasern erheblich ansteigen wird. Wie an anderer Stelle in diesem Bericht beschrieben, haben wir bereits erste Aufträge verbuchen können. Man muss jedoch berücksichtigen, dass eine Technologie nicht „über Nacht" zum Einsatz kommt. Bevor eine neue Maschinengeneration bzw. neue Technologie in der Volumenproduktion eingesetzt wird, müssen häufig mehrstufige und zeitintensive Qualifikationsprozesse beim jeweiligen Kunden durchlaufen werden.

Welche Lasertechnologien kommen bei Ihnen zum Einsatz und was sind die Anwendungsgebiete?

Dr. Arendt: Wir verwenden zwei verschiedene Lasertechnologien, zum einen die Festkörper-Lasertechnologie und zum anderen die Excimer-Lasertechnologie. Beide haben das Potenzial, erheblich zum Umsatzwachstum der SÜSS MicroTec-Gruppe beizutragen. Unsere SLP300-Plattform basiert auf den neuesten Entwicklungen im Bereich der Festkörper-Lasertechnologie und bietet neue Anwendungsmöglichkeiten für die Mikrostrukturierung – die Kernkompetenz der SÜSS MicroTec-Gruppe. Ohne den Einsatz von Masken arbeiten die Systeme in einem direkten Schreibmodus und werden u. a. zur Mikrostrukturierung von Durchkontaktierungen sowie zum Schneiden und Trennen eingesetzt. Dagegen bedient sich unsere ELP300-Plattform der Excimer-Laser-Stepper-Technologie. Über die Funktion der Laserabdampfung bietet dieses System einen hohen Grad an Struktur- und Passgenauigkeit bei gleichzeitig sehr hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten. Es eignet sich für komplexe Mikrostrukturierungsprozesse im Advanced Packaging und lässt sich darüber hinaus in weiteren Wafer Level Packaging-Anwendungen, wie z. B. beim Laser-Debonden für Thin Wafer-Handling, für die Abtragung von Opferschichten bei Umverdrahtungen sowie für Belichtung von Fotolacken und nicht photosensitiven Materialien, einsetzen.

Wie sieht es mit Ihren Erwartungen für die UV-Projektionslithografie aus?

Dr. Arendt: SÜSS MicroTec Photonic Systems bietet derzeit zwei Maschinen zur Projektionslithografie an, die DSC300 für Wafer bis zu einem Durchmesser von 300 mm und die DSC500, welche Substratgrößen (Panels) bis zu 450 mm x 500 mm unterstützt. Diese UV-Scanner bieten eine kostengünstige Alternative zu Steppern für die Strukturierung im Advanced Packaging. Auch hier konnten wir erste Aufträge von internationalen Kunden verbuchen. In der Vergangenheit war es Tamarack Scientific viel schwieriger möglich, Aufträge außerhalb der USA zu generieren, da die Vertriebs- und Servicestruktur des inhabergeführten Unternehmens auf den US-amerikanischen Markt beschränkt war. Mit der Übernahme durch SÜSS MicroTec haben sich dem Unternehmen völlig neue Märkte und Absatzkanäle eröffnet, welche wir seither intensiv für die Vermarktung der Produkte nutzen. Insbesondere IDM und OSAT im asiatischen Raum stehen hier im Fokus.

Wie läuft die Integration in die SÜSS MicroTec-Gruppe?

Dr. Arendt: Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren sehr viel bewegt. Die global agierenden Vertriebs- und Servicemitarbeiter wurden umfassend auf die neuen Produkte geschult und vermarkten seither auch die UV-Projektionsgeräte und die Laser-Tools unter dem Logo der SÜSS MicroTec-Gruppe. Das interne

Berichtswesen wurde an die Bedürfnisse des Konzerns angepasst und unsere Mitarbeiter fühlen sich unter der Schirmherrschaft von SÜSS MicroTec gut aufgehoben. «

» LASERPROZESSIERUNG NIMMT FAHRT AUF

Die Laserstrukturierung ist im Mid- und Backend der Halbleiterfertigung eine noch wenig genutzte, aber zukunftsträchtige Technologie. Mit diesem Satz haben wir im Geschäftsbericht 2012 unseren Einstieg in das neue Technologiefeld der Laserprozessierung begründet. Ein Jahr später können wir auf vielversprechende Projekte zurückblicken und sind sehr zuversichtlich, dass die Laserstrukturierung in Zukunft ein wichtiger Teil unseres Lithografiesegments sein wird. Im Geschäftsjahr 2013 ist es uns gelungen, erste internationale Referenzkunden aus den USA und Asien für unsere Geräte zur Laser-Ablation zu gewinnen. Zudem hat das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM, Berlin, im Jahr 2013 ein Excimer-Laser-Stepper System (ELP300) erworben. Mit dem neuen Excimer-Laser-System wird das IZM seine Expertise im Bereich Dünnschicht-Polymere ausweiten. Diese Polymere sind wichtige Bausteine jedes Wafer Level Packages. Diese Projekte zeigen die wachsende Bedeutung neuer und innovativer Strukturierungstechnologien im Halbleiter-Mid- und Backend.

Die ELP300-Plattform trifft bei Kunden auf großes Interesse

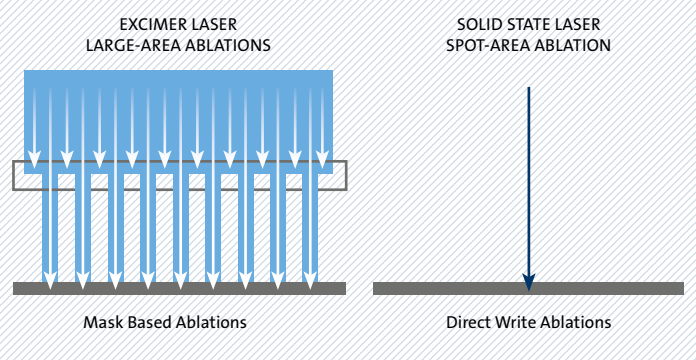
Bei der ELP300- Stepper-Plattform handelt es sich um ein Erfolg versprechendes Laser-Tool, welches auch bei unseren internationalen Kunden auf großes Interesse stößt. Es bedient sich eines Excimer-Lasers und ist für die Volumenproduktion konzipiert. Mit Hilfe dieser Lasertechnologie können, unter Umgehung der herkömmlichen Lithografie- und Ätzverfahren, Mikrostrukturen direkt auf dem Substrat hergestellt werden. Damit können gleichzeitig die technologischen Beschränkungen photo-dielektrischer Materialien sowie herkömmlicher Lithografieprozesse umgangen werden. Das System erfüllt darüber hinaus die Anforderungen an die neuesten Halbleiter-Packaging-Prozesse. Das Verfahren ist besonders umweltfreundlich, da durch direkten Materialabtrag Ätzprozesse mit giftigen Chemikalien reduziert werden können, und eröffnet damit unseren Kunden eine interessante Alternative für die Entwicklung und Herstellung leistungsfähigerer Mikrochips, bei gleichzeitiger Verringerung der Belastungen für unsere Umwelt. »

» DER UV-PROJEKTIONSSCANNER – WELTWEIT EINMALIGE TECHNOLOGIE

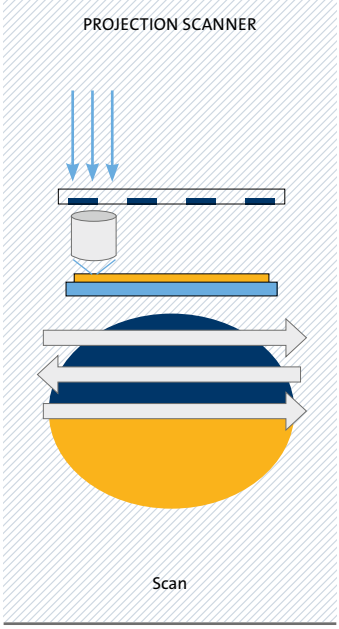
Die UV-Projektionsscantechnologie von SUSS MicroTec Photonic Systems kombiniert die Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie. Ausgestattet mit einer Vollfeldmaske und einer Breitbandprojektionsoptik belichtet der Scanner den Wafer in einem Belichtungsschritt. In das Design des Maskenlayouts lassen sich bereits zusätzliche Funktionen wie die Belichtung vom Wafer-Rand integrieren, dies ist ein wichtiges Kriterium für effiziente Folgeprozesse in Packaging-Prozessen. Unsere bestehenden Mask Aligner-Kunden haben den Vorteil, dass die Vollfeldmaske vom Mask Aligner auch für den Projektionsscanner eingesetzt werden kann, dies spart Zeit bei der Maskenherstellung und ist sehr kosteneffizient.

SUSS MicroTec Photonic Systems ist das weltweit einzige Unternehmen, welches die herkömmliche UV-Projektionslithografie mit der Scanner-Technologie kombiniert hat und somit die Vorteile beider Verfahren für sich nutzen kann. Das Interesse von Kunden an dieser neuartigen Technologie ist hoch und wir arbeiten bereits in verschiedenen Projekten mit internationalen Kunden zusammen. «

LASER-ABLATION



UV-PROJEKTIONSSCANNER



DER MASK ALIGNER WIRD 50 – EINE ERFOLGSGESCHICHTE

VON DER EINZELFERTIGUNG ZUR VOLUMENPRODUKTION

Ein Mask Aligner ist ein sogenanntes Vollfeldbelichtungsgerät, welches in der Halbleiterindustrie für die Mikrostrukturierung von Wafern eingesetzt wird. Für den Belichtungsvorgang wird eine Glasmaske sehr nah an den Wafer herangeführt und submikrometergenau dazu ausgerichtet. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den, mit einem fotoempfindlichem Material beschichteten, Wafer übertragen. Die Belichtung des gesamten Wafers findet in nur einem Schritt statt. Aufgrund der verwendeten Schattenwurftechnologie hat der Mask Aligner gewisse Grenzen im Hinblick auf die erreichbare Auflösung und ist deshalb nicht mehr im Frontend der Halbleiterindustrie zu finden. Für das rasch wachsende Mid- und Backend der Halbleiterbranche, ist der Mask Aligner nach wie vor das Belichtungsgerät, mit der günstigsten Cost-of-Ownership und wird auch in Zukunft seinen wichtigen Stellenwert in diesem Segment behalten.

SPEZIELLE LÖSUNGEN FÜR DIE NOCH JUNGE HALBLEITERINDUSTRIE

In den frühen Jahren der Halbleiterindustrie konnten Komponentenhersteller keine standardisierten Produktionsmaschinen kaufen, sondern es wurden entsprechend der jeweiligen Anforderungen Maschinen für die einzelnen Kunden entwickelt. Im Jahr 1963 hat Karl Süss auf Nachfrage von Siemens ein Gerät zum Belichten, bestehend aus einer Lampe, einem Mikroskop und einem Tisch, entwickelt – der erste Mask Aligner war erschaffen. Für SÜSS war dies der Einstieg in die schnell wachsende Halbleiter-Equipment-Branche. Seither bedient sich der Mask Aligner noch immer der Belichtung mittels Schattenwurf, wurde aber technologisch vielfach weiterentwickelt. Wurden ursprünglich 1- bis 2-Zoll-Substrate belichtet, so findet man heute in der Volumenfertigung Wafergrößen von 8 bis 12 Zoll (200 bis 300 mm).

Die Mask Aligner von SÜSS MicroTec zeichnen sich durch eine hohe Qualität, höchste Justagegenauigkeit sowie eine ausgereifte Belichtungsoptik aus. Die Systeme werden vor allem für Lithografie-Anwendungen in den Bereichen MEMS, Advanced Packaging, 3D-Packaging, Verbindungshalbleiter, Power Devices, Fotovoltaik, Nanotechnologie und Wafer Level-Optik eingesetzt. Mit dem flexibel einsetzbaren Mask Aligner können dabei Wafer bis zu einem Durchmesser von 300 mm in jeder beliebigen Größe, Form und Dicke prozessiert werden.

In den letzten 50 Jahren haben verschiedene Generationen von Ingenieuren und Technikern an der Weiterentwicklung des Mask Aligners gearbeitet. Sie haben es geschafft, im globalen Wettbewerb und unter teilweise enormem Kostendruck die technologische Führung zu behaupten und auszubauen. Mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent ist SÜSS MicroTec nach wie vor die unumstrittene Nummer eins bei der Herstellung von Mask Alignern. «

1950er Jahre
ANFÄNGE DER HALBLEITER-INDUSTRIE

1963
KARL SÜSS ENTWICKELT DEN ERSTEN MASK ALIGNER

1990er Jahre
ANFÄNGE DES ADVANCED PACKAGING (WAFER LEVEL PACKAGING)

2012
MO EXPOSURE OPTICS VERBESSERT MASK ALIGNER-TECHNOLOGIE

INNOVATIVE LÖSUNGEN FÜR DEN GLOBALEN MARKT

SEIT VIELEN JAHREN IST ASIEN DIE VERLÄNGERTE WERKBANK DER WESTLICHEN WELT

Ob Automobilbranche, Computerindustrie, Unterhaltungselektronik oder die Halbleiterindustrie, in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat eine umfassende Verlagerung der Herstellung von Komponenten und Endprodukten nach Asien stattgefunden. Hauptgrund für diese Entwicklung war die günstige Kostenbasis, die man in Asien vorgefunden hat. Wurden zuerst nur unkritische und arbeitsintensive Prozesse verlagert, so ist Asien mittlerweile die wichtigste Region für die Herstellung von elektronischen Bauelementen, Computern und Unterhaltungselektronik. Auch in der Halbleiterindustrie findet man unzählige Unternehmen, die in Asien ansässig sind bzw. umfangreiche Teile der Produktion vor Ort haben.

WETTBEWERBSFÄHIG MIT HIGHTECH AUS GARCHING

Mit innovativen Produkten und technologisch führenden Lösungen – wie dem Mask Aligner – gelingt es SÜSS MicroTec seit mehr als 50 Jahren, dem Kostendruck und dem internationalen Wettbewerb erfolgreich zu begegnen und die Positionierung in den einzelnen Produktbereichen zu behaupten. Führende Marktpositionen in den wesentlichen Geschäftsbereichen der Mid- und Backend-Lithografie, Fotomasken Equipment, Laserprozessierung und beim temporären Bonden sind ein eindrucksvoller Beleg für den Erfolg der Unternehmensstrategie. Um wettbewerbsfähige Produkte erfolgreich entwickeln und herstellen zu können, braucht das Unternehmen vor allem qualifizierte Mitarbeiter, eine enge Zusammenarbeit der Bereiche Entwicklung, Applikation und Produktion sowie eine verlässliche Zulieferkette.

Hauptsitz der SÜSS MicroTec AG
in Garching bei München

Ein besonders geeignetes Umfeld für die Geschäftsaktivitäten findet SÜSS MicroTec an den Produktionsstandorten Garching, Sternenfels und Corona, USA, sowie an den global vernetzten Vertriebs- und Applikations- und Servicecentern. Ein bedeutender Schritt zur langfristigen Sicherung des Know-hows und ein klares Bekenntnis zum Standort Garching wurden mit dem Erwerb der Immobilie am Firmenhauptsitz im Jahr 2013 realisiert.

RAHMENBEDINGUNGEN DES IMMOBILIENERWERBS AM FIRMENHAUPTSITZ

Die Unterzeichnung des Kaufvertrages für die Immobilie in Garching fand am 23. Januar 2013 statt, der rechtliche Übergang der Immobilie wurde zum 30. September 2013 vollzogen. Verkäufer der Immobilie war die Fabrilis Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Garching KG und die Süss Grundstücksverwaltungsgemeinschaft Zeppelinstraße GbR. Der Kaufpreis inklusive Nebenkosten für die Immobilie und das Grundstück betrug 8,9 Mio. Euro und wurde aus den bestehenden liquiden Mitteln finanziert. Mit dem Kauf der Immobilie wird zukünftig eine jährliche Entlastung des Unternehmensergebnisses EBIT um rund 0,4 Mio. Euro erwartet. Mit dem Erwerb sichert sich SÜSS MicroTec neben der Mietersparnis ein hohes Maß an operationaler Flexibilität im Hinblick auf die unternehmensspezifischen Anforderungen an die Immobilie, z. B. Reinräume und Applikationslabore. Zudem bietet der Standort Garching interessante räumliche Erweiterungsmöglichkeiten und zeichnet sich durch eine exzellente Verkehrsanbindung und die Nähe zu den Forschungszentren im Raum München aus. «

HAUPTSITZ DES UNTERNEHMENS

- **20.000 qm** nutzbare Grundfläche
- rund **170 Mitarbeiter**
- Produktion von Mask Alignern und Bond Alignern

INVESTOR RELATIONS

Die Weltkonjunktur hat sich nach Aussage führender Wirtschaftsforschungsinstitute (Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2013) bereits im ersten Halbjahr 2013 spürbar belebt. Grund hierfür war zum ersten Mal seit langer Zeit eine anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften. Die wirtschaftliche Situation in den Industrieländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanzkrise belastet, aber die Zeichen stehen auf Erholung.

Die USA haben die Einschnitte in den öffentlichen Haushalt gut verkraftet und in der Europäischen Union hat die Industrieproduktion bereits im zweiten Quartal 2013 wieder zugelegt. Für das Gesamtjahr 2013 erwartet der International Monetary Fund ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 Prozent und für 2014 ein beschleunigtes Wachstum um 3,7 Prozent. In Deutschland befinden sich die öffentlichen Haushalte sowie die Sozialversicherungen in einer guten finanziellen Position, so dass der Sachverständigenrat in seinem Jahresgutachten 2013/14 für 2014 eine weitere Aufhellung der konjunkturellen Lage in Deutschland prognostiziert.

DER DEUTSCHE AKTIENMARKT HAT IM JAHRESVERLAUF ZUGELEGT

Noch im Mai des Jahres 2013 hatte die Ankündigung der Federal Reserve Bank, ihr Programm zur quantitativen Lockerung möglicherweise früher als geplant zu beenden, die Nervosität an den Finanzmärkten deutlich steigen lassen. Doch das zuletzt im September 2013 angekündigte weitere Festhalten der amerikanischen Notenbank an der lockeren Geldpolitik, insbesondere die milliardenschweren Ankäufe von Anleihen, hatte weltweit die Aktienkurse beflügelt. Anfang November 2013 folgte eine Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank auf ein Rekordtief von 0,25 Prozent. Die letzte Senkung auf 0,5 Prozent hatte zuvor im Mai 2013 stattgefunden. Die Folge von Zinssenkungen sowie die Bestätigung des niedrigen Zinsniveaus im Dezember 2013 signalisierten den Märkten eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in Europa und haben für weitere positive Impulse am Aktienmarkt gesorgt. Im Sog dieser Nachrichten erreichte der DAX im Dezember 2013 einen neuen Rekordstand von 9589 Punkten.

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE

In den ersten Wochen des Jahres 2013 hat sich der Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie sehr dynamisch entwickelt und ist erneut auf über 10,00 Euro gestiegen. Nach Veröffentlichung eines verhaltenen Gesamtjahresausblicks im Februar 2013 hat der Aktienkurs mit einem deutlichen Abschlag reagiert. Dieser Trend wurde kurzzeitig mit der Veröffentlichung eines wichtigen Kundenauftrags zum Thema 3D-Integration, am 28. März 2013, gebrochen. Im Anschluss an diese Meldung konnte die Aktie deutlich zulegen und hat das erste Quartal insgesamt mit einem Plus von einem Prozent, dies entspricht einem Schlusskurs von 8,91 Euro, beendet. Im Verlauf des zweiten Quartals ist die Aktie, bei niedrigen Handelsumsätzen mit gleichzeitig hoher Volatilität, gefallen und hat das zweite Quartal mit einem Schlusskurs von 7,88 Euro abgeschlossen. Dies entspricht einem Minus gegenüber Jahresbeginn von rund 11 Prozent. Im Juli 2013 wurde die Ergebniserwartung für das Gesamtjahr 2013 nach unten korrigiert und entsprechend der eingetrübten Aussichten für das

Gesamtjahr hat der Druck auf den Aktienkurs weiter angehalten. Im September 2013 hat das Marktforschungsinstitut Gartner seine Erwartungen für die Marktentwicklung im Halbleiter-Equipment-Segment deutlich reduziert und prognostizierte einen Rückgang der Nachfrage im Gesamtjahr 2013 um 8,5 Prozent. Im Jahr 2012 war der Markt nach Schätzungen von Gartner bereits um rund 16 Prozent geschrumpft. Diese Entwicklungen spiegelten sich erwartungsgemäß auch in der Entwicklung des Aktienkurses im dritten Quartal 2013 wider. Die Aktie schloss am 30. September mit einem Xetra-Schlusskurs von 6,68 Euro. Nach Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2013 und als Folge der Ankündigung von Restrukturierungsmaßnahmen im Segment Substrat Bonder, hat der Aktienkurs erneut an Boden verloren und ist am 5. Dezember 2013 auf seinen Jahrestiefstkurs von 6,04 Euro gesunken.

Betrachtet man abschließend die Entwicklung in den Vergleichsindizes im Jahresverlauf, so ergibt sich folgendes Bild: Seit Mai 2013 haben sich der TecDAX und der Semiconductor-Index der Deutschen Börse besser entwickelt als der Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie. Der TecDAX konnte im Gesamtjahr 2013 um 41 Prozent zulegen und der Semiconductor Index legte um 25 Prozent zu, die SÜSS MicroTec-Aktie fiel im gleichen Zeitraum um rund 23 Prozent.

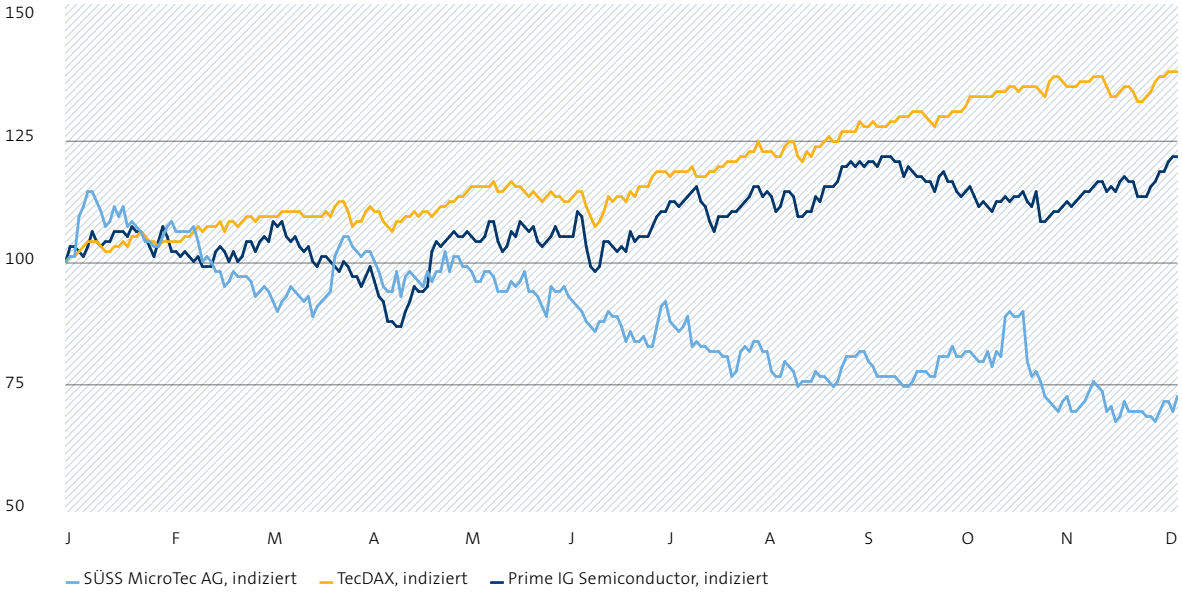
Aufgrund der zu geringen Marktkapitalisierung ist SÜSS MicroTec mit Wirkung zum 23. September 2013 aus dem TecDAX ausgeschieden, notiert aber weiterhin im Prime Standard der Deutschen Börse.

Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt am Börsenplatz Frankfurt und über XETRA gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien lag im Jahr 2013 bei 104.569 Stück (Vorjahr: durchschnittlich 116.790 Aktien pro Tag).

Einen Überblick über den Kursverlauf im Jahr 2013 bietet die folgende grafische Darstellung.

DIE KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTEC-AKTIE 2013

(Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2013: 8,85 €)



VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON SÜSS MicroTec, TECDAX UND PRIME IG SEMICONDUCTOR IM GESCHÄFTSJAHR 2013

	30.12.2012	30.12.2013	Veränderungen
TecDAX	828	1167	+41 %
Prime IG Semiconductor	122	153	+25 %
SÜSS MicroTec	8,44	6,46	-23 %

DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennnummer	A1K023
ISIN-Nummer	DE000A1K0235
Reuters-Kürzel	SMHN
Bloomberg-Kürzel	SMHN:GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2013)	19.115.538
Wertpapiergattung	Namensaktien
Designated Sponsor zum 31 Dezember2013	equinet Bank AG Close Brothers Seydler
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs-/schlusskurs in €	8,85 € / 6,46 €
Jahreshoch-/tief in €*	10,08 € / 6,04 €

*XETRA Schlusskurs

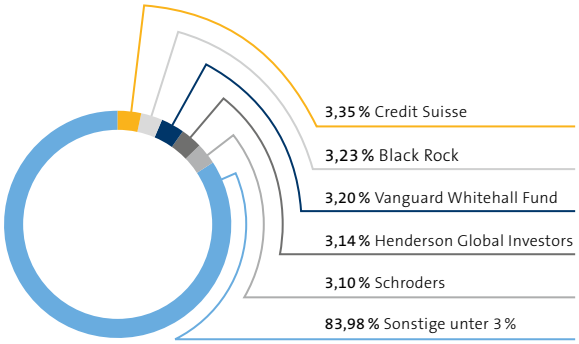
INVESTOR RELATIONS-AKTIVITÄTEN MIT STARKEM INTERNATIONALEN FOKUS

Die Investor Relations-Arbeit hat im Wesentlichen drei Zielgruppen, dazu gehören die privaten und institutionellen Investoren, die Analysten und die Finanzmedien. Jede dieser Gruppen hat unterschiedliche Vorkenntnisse, verschiedene Anlagehorizonte sowie Erwartungen an das Unternehmen. Ziel der Investor Relations-Arbeit ist daher eine zielgruppenorientierte Kommunikation mit den verschiedenen Akteuren am Kapitalmarkt.

Das Management der SÜSS MicroTec AG sieht sich bei dieser Kommunikationsaufgabe gegenüber den Anteilseignern des Unternehmens in der Pflicht. So besuchten Vorstand und Investor Relations im Jahr 2013 insgesamt zwölf Kapitalmarktkonferenzen und absolvierten sieben Roadshows. Die sieben internationalen Kapitalmarktkonferenzen fanden in New York, Boston, Las Vegas, Zürich, Paris und Barcelona statt. Zusätzlich wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

Im dritten Quartal 2013 gab es zudem nennenswerte Veränderungen in der Aktionärsstruktur von SÜSS MicroTec: Die DWS (Frankfurt und Luxemburg) hat ihre Anteile (>10 Prozent) vollständig verkauft und entsprechende Stimmrechtsmeldungen wurden veröffentlicht. Im September hatte die UBS AG, Zürich, kurzzeitig einen Anteilsbesitz von mehr als 10 Prozent gemeldet, ist aber im Verlauf des Monats wieder unter die 3-Prozent-Meldeschwelle gefallen. Der Free Float beträgt zum Jahresende 2013 weiterhin 100 Prozent.

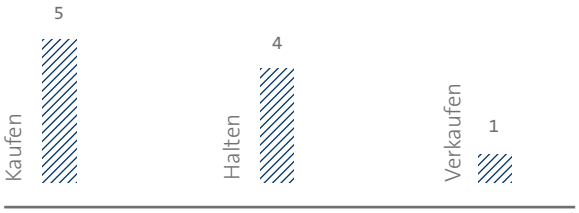
AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2013



ANALYSTEN-RESEARCH ERWEITERT UND INTERNATIONALISIERT

Zum Jahresende 2013 wurde das Unternehmen von insgesamt zehn Banken und Research-Häusern gecovert. Im Verlauf des Jahres 2013 konnten somit zwei neue Analysehäuser für das Unternehmen gewonnen werden, es handelt sich dabei um das Bankhaus Lampe, Düsseldorf, sowie die erste internationale Coverage durch die Berenberg Bank, London. Im Dezember 2013 haben fünf von zehn Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen, daneben gab es vier Empfehlungen zum Halten der Aktie sowie eine Verkaufsempfehlung. Eine Übersicht über aktuelle Research-Studien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter *www.suss.com > Investor Relations.*

ANALYSTENSCHÄTZUNGEN ZUM 31.12.2013



HAUPTVERSAMMLUNG

Am 19. Juni 2013 fand die ordentliche Hauptversammlung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Insgesamt waren über 80 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit waren 26,9 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Neben der Entscheidung über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats, standen eine Ermächtigung zum Rückkauf eigener Aktien und die Schaffung eines genehmigten Kapitals zur Abstimmung. Die Aktionäre des Unternehmens haben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung präsentierten, gegeben.

Der Vorstandsvorsitzende Frank P. Averdung erläuterte in seinem Bericht die wesentlichen Entwicklungen und Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie des ersten Quartals 2013. Im Vordergrund seiner Ausführungen standen dabei die Stärkung und der Ausbau des Kernsegments Lithografie.

030

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Daneben gehören für SÜSS MicroTec Transparenz, eine offene Kommunikation mit Aktionären und Investoren sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand zu den wesentlichen Aspekten einer guten Corporate Governance. SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex, der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden sie in dem nachfolgenden Bericht.

CORPORATE GOVERNANCE IM ÜBERBLICK

Mit der Zielsetzung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen, hat die Corporate Governance einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben sich Geschäftsjahr 2013 erneut intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter *www.suss.com > Corporate Governance.*

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX (DCGK)

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben am 10. Januar 2013 gem. § 161 Abs. 1 AktG folgende Entsprechenserklärung abgegeben:

Die SÜSS MicroTec AG wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit den nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen entsprechen und hat den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Mai 2012 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen.

EINLADUNG ZUR HAUPTVERSAMMLUNG

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.2 allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege zu übermitteln, sofern die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind. SÜSS MicroTec übermittelt die Einberufung nebst Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege nur den Aktionären, Aktionärsvereinigungen und Finanzdienstleistern, die dies verlangen. Eine automatische elektronische Übermittlung an alle in Ziffer 2.3.2 Genannten erfolgt nicht. Nach der Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien hat die Gesellschaft die Möglichkeit der automatischen elektronischen Übermittlung der Einberufung nebst Einberufungsunterlagen zur Hauptversammlung geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dies trotz Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex nicht zu tun. Die derzeitige Aktionärsstruktur von SÜSS MicroTec weist einen sehr hohen Anteil an Privataktionären auf, deren E-Mailadressen der Gesellschaft nicht bekannt sind. Daher kann auf einen Postversand nicht vollständig verzichtet werden. Ein paralleler elektronischer und postalischer Versand ist aus unserer Sicht nicht sinnvoll, da die damit verbundenen Kosten in keinem Verhältnis zu dem Nutzen stehen.

SELBSTBEHALT BEI D&O-VERSICHERUNGEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

ZIELE FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 die Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei der Benennung der konkreten Ziele soll unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potentielle Interessenkonflikte, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigt werden. Insbesondere sollen die konkreten Ziele eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen. Seit der Neufassung des DCGK vom 15. Mai 2012 wird zudem die konkrete Angabe der angestrebten Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder empfohlen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen diese Ziele beachten. SÜSS MicroTec sieht von einer konkreten Zielsetzung und Quoten im vorgenannten Sinn ab. Aus Sicht von SÜSS MicroTec ist die Qualifikation von den Aufsichtsratskandidaten maßgebliches Kriterium für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats und damit die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei den Vorschlägen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unterstützt und berücksichtigt SÜSS MicroTec die in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 DCGK genannten Kriterien, sieht aber konkrete Zielvorgaben oder Quoten nicht als sinnvoll an.

Mit Inkrafttreten der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Kodex vom 13. Mai 2013 durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 10. Juni 2013 sind die Abweichungen zur Einladung zur Hauptversammlung entfallen, da die entsprechende Empfehlung in der neuen Fassung des Kodex nicht mehr enthalten ist.

Vorstand und Aufsichtsrat haben zudem am 10. Januar 2014 eine Entsprechenserklärung auf der Grundlage des Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 abgegeben und über die oben bereits wiedergegebenen, nunmehr noch maßgeblichen drei Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – hinaus folgende Abweichung von dem Kodex in der Fassung vom 10. Juni 2013 erklärt:

VERTIKALER VERGÜTUNGSVERGLEICH

In Ziffer 4.2.2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat, bei der Festlegung der Vorstandsvergütung das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises sowie der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen ist. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist der Auffassung, dass die Festlegung des obersten Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann. Die SÜSS MircroTec AG erklärt daher insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung.

VERSORGUNGSZUSAGEN

Unter 4.2.3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat, bei Versorgungszusagen das jeweils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der Dauer der Vorstandszugehörigkeit – und den daraus abgeleiteten jährlichen sowie langfristigen Aufwand für das Unternehmen zu berücksichtigen. Der Aufsichtsrat von SÜSS MicroTec wird von dieser Empfehlung abweichen, da für die Vorstandsmitglieder kein bestimmtes „Versorgungsniveau" im Ruhestand, sondern eine markt- und unternehmenskonforme Vergütung der aktiven Tätigkeit angestrebt wird. Unmittelbare Versorgungszusagen, bei denen die Gesellschaft selbst die zugesagten Leistungen erbringt, werden den Mitgliedern des Vorstands grundsätzlich nicht gewährt. Soweit die Gesellschaft den Vorständen einen Zuschuss zur Altersvorsorge gewährt und Beiträge in eine Direktversicherung (Kapitallebens- bzw. Rentenversicherung) einzahlt, ist damit keine Zusage eines bestimmten Versorgungsniveaus verbunden.

KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec verfolgt den Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren, und dabei größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten. Dazu nutzt das Unternehmen neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten die Möglichkeit von Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows sowie die Website, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter *www.suss.com > Investor Relations* neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereit gestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei einsehen bzw. abrufen.

Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG können sich unsere Aktionäre mit Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. Wir bereiten die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der Investor Relations-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, ihnen die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SÜSS MicroTec dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – zum Beispiel Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt und es wurden keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Herrn Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2013 nicht. Interessenskonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2013 nicht auf.

ZIELE DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER ZUSAMMENSETZUNG

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstands auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Verbindungen vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von erfolgreichen Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu gehören Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inklusive Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarktkommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation und bewertet die Aufsichtsratsbesetzung in regelmäßigen Abständen.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen, ohne dass Aufsichtsrat und Vorstand die Festschreibung einer Quote derzeit für sinnvoll halten. Auch die Festlegung einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Mindestzahl von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern halten Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der Größe des Aufsichtsrats nicht für sinnvoll, um das künftige Auswahlermessen bei der Besetzung von Aufsichtsratspositionen nicht zu stark einzuschränken.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren. Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativerklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen für Aufsichtsrat und Vorstand zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.

Der Aufsichtsrat bewertet die Besetzung des Aufsichtsrats bezüglich der gesetzten Ziele und der aktuellen Unternehmenssituation als angemessen. Insbesondere verfügt der Aufsichtsrat über eine ausreichende Zahl an unabhängigen Mitgliedern. Die Anforderungen von § 100 Abs. 5 AktG an ein unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats, das über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügt, werden insbesondere von Herrn Teichert erfüllt.

ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und deren Mandate:

FRANK AVERDUNG

- VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
- VDMA (Mitglied im Hauptvorstand)
- Semi European Advisory Board, Frankfurt am Main (Mitglied)
- IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

MICHAEL KNOPP

DR. STEFAN REINECK

- AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of Directors)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- AWS-Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)
- RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchardt (Geschäftsführender Gesellschafter)

JAN TEICHERT

- Einhell Germany AG (Mitglied des Vorstands)
- Kolb Technology GmbH, Hengersberg (ab 1. Januar 2014)

GERHARD PEGAM

- GPA Consulting GmbH, Au bei Bad Aibling (Geschäftsführender Gesellschafter)
- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat es keine Veränderung im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG gegeben.

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

Die im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2013 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2013	Veränderung gegenüber 31.12.2012	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2013	Veränderung gegenüber 31.12.2012
Aufsichtsrat				
Dr. Stefan Reineck	9.600	-	0	-
Jan Teichert	0	-	0	-
Gerhard Pegam	0	-	0	-
Vorstand				
Frank Averdung	90.540	+7.340	0	-
Michael Knopp	28.100	+5.600	0	-

MELDEPFLICHTIGE AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach §15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 € erreicht oder übersteigt.

Sämtliche Geschäfte des Vorstands und des Aufsichtsrats werden auf der Website des Unternehmens unter *www.suss.com > Investor Relations > Die Aktie > Directors Dealings* veröffentlicht.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 19. Juni 2013 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2013 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigstelle München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB ist Bestandteil des Lageberichts und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter *www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/erklaerung-zur-unternehmensfuehrung.html* allgemein zugänglich gemacht.

VERGÜTUNGSBERICHT

Die Grundzüge des Vergütungssystems haben wir im Vergütungsbericht dargestellt, der im zusammengefassten Lagebericht abgedruckt ist.

036

ZUSAMMENGEFASSTER LAGEBERICHT

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2013

» 037 Geschäft und Rahmenbedingungen
037 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
039 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
039 Forschung und Entwicklung
042 Überblick über den Geschäftsverlauf

» 048 Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
048 Ertragslage
050 Finanz- und Vermögenslage
053 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
054 Investitionen
054 Die Holding – SÜSS MicroTec AG

» 057 Übernahmerechtliche Angaben
057 Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

» 059 Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

» 059 Vergütungsbericht
059 Vergütung des Vorstands
061 Vergütung des Aufsichtsrats

» 061 Nachtragsbericht
061 Bericht zu wesentlichen Ereignissen nach Ende des Geschäftsjahres
061 Stimmrechtsmitteilungen nach dem Stichtag

» 062 Berichterstattung über die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
062 Risikomanagementsystem
064 Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken
065 Betriebliche Risiken
066 Betriebliche Chancen
067 Finanzmarktrisiken

» 069 Prognosebericht
070 Halbleiterindustrie
070 Halbleiter-Equipment-Industrie
070 Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten
073 Endogene Indikatoren
074 Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

» 074 Zukunftsgerichtete Angaben

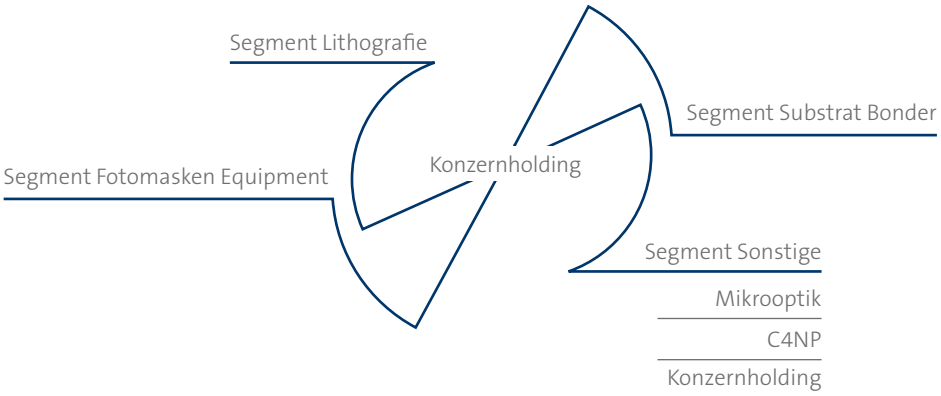
GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND GESCHÄFTSFELDER

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

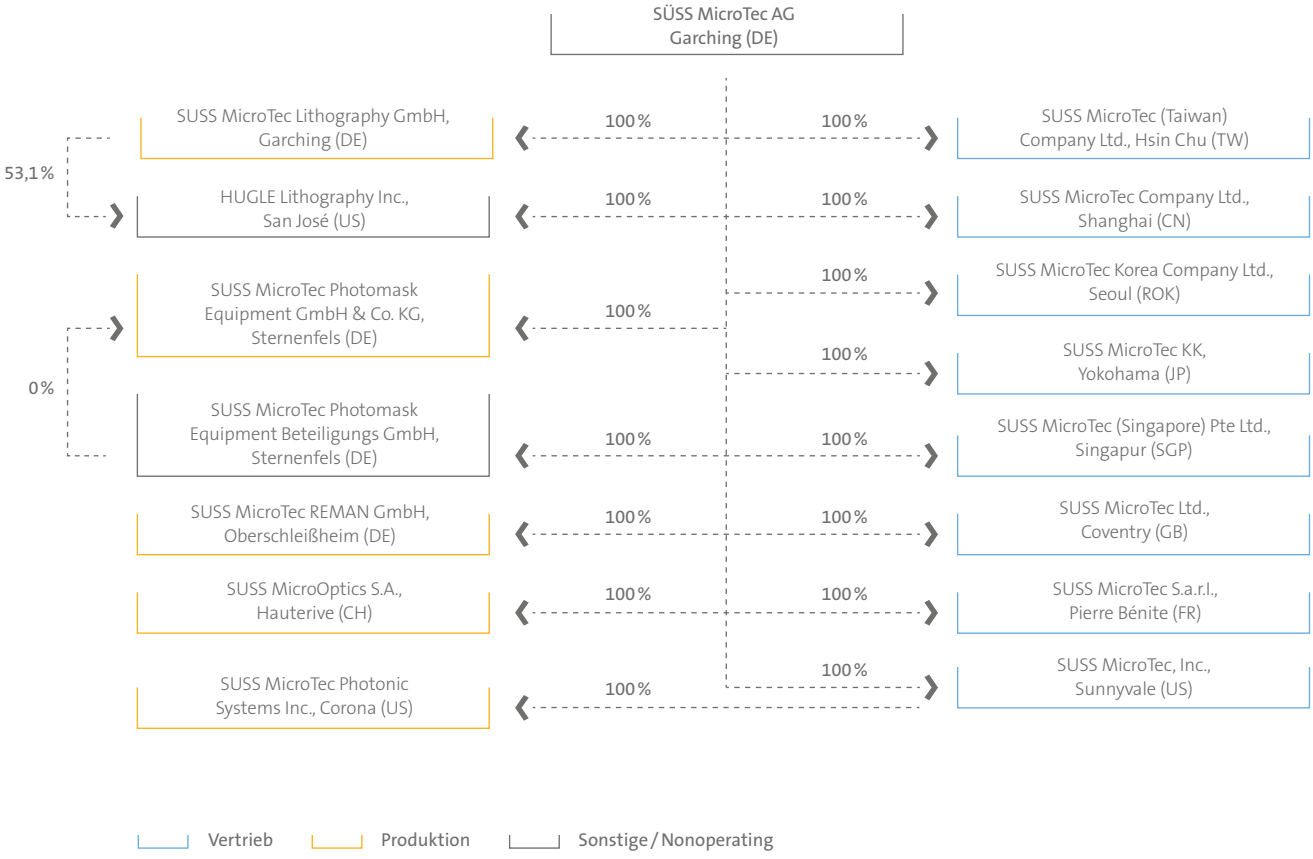
Der Konzern ist zum 31. Dezember 2013 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfirmierung: SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung: SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.



RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfügige Beteiligung von zehn Prozent an der ELECTRON-MEC S.R.L., Mailand (IT). Diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft.



LEITUNG UND KONTROLLE

Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftsträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Forschung und Entwicklung

Im Folgenden haben wir eine Übersicht über die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 2013 nach Segmenten zusammengestellt.

LITHOGRAFIE

Das größte Segment, die Lithografie, vereinigt die Produktlinien Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing und die Coater / Developer.

Im Bereich der Belackungs- und Entwicklungssysteme hat SÜSS MicroTec die neueste Generation der 200-mm-Plattform für die Volumenproduktion um eine wesentliche Komponente erweitert. Das neue Vierfach-Ein-/Ausgabemodul erlaubt das kontinuierliche Prozessieren von zwei parallelen Prozessen ohne Unterbrechung. Die modulare Ausbaufähigkeit mit diesem Modul ermöglicht eine weiterführende Optimierung der Cost-of-Ownership der Coater / Developer Cluster. Der unterbrechungsfreie Betrieb erhöht zudem die Prozesssicherheit und die Ausbeute.

Plattformübergreifend, hinsichtlich der 200-mm- und 300-mm-Coater / Developer Cluster, wurden weitere Themen zur Erhöhung der Prozesssicherheit und Stabilität umgesetzt. Die Entwicklungen eines geschlossenen Regelkreises zur Dispense Arm-Positionierung ermöglicht eine hohe Zuverlässigkeit bei der Entlackung des Randbereiches eines Substrates. Die betroffene Fläche kann auf ein Minimalmaß reduziert werden und somit die aktiv nutzbare Fläche, gleichbedeutend mit Ausbeute, erhöht werden. In einem weiteren Projekt wurde die Ausführung der temperierten Medienversorgung der Entwicklermodule überarbeitet. So ist nun eine geringere Toleranz sowie ein erweiterter einstellbarer Bereich der Temperatur möglich. Dies bietet Verbesserungen sowohl hinsichtlich der Prozesszeiten als auch der Prozesssicherheit. Die neuen Module ermöglichen zudem eine flexible Anordnung der Temperiertechnik, auch weit entfernt zu den Prozessanlagen.

Die Fähigkeit der 300-mm-Maschinen wurde dahingehend erweitert, bei nur geringfügig gestiegenen Kosten Substrate zu prozessieren, die eine über das Standardmaß hinausgehende Fläche bieten. Hierfür wurden alle Module, vom Spincoater über die Hot- und Coolplates bis hin zu dem Entwickler konstruktiv überarbeitet.

In der Produktlinie Mask Aligner wurde die Steuerungsplattform durch eine Soft- und Hardwareüberarbeitung zur Modernisierung der Bedienungskonzepte weiter entwickelt. Im Jahr 2013 wurden bereits die ersten Ergebnisse der Überarbeitung in neuen Maschinen umgesetzt. Die Weiterentwicklung, welche grundsätzlich auf alle Mask Aligner-Typen zielt, wurde im letzten Jahr zuerst bei der MA200Compact eingesetzt.

Die Ingenieure von SÜSS MicroTec arbeiten permanent an einer Verbesserung der Prozessfähigkeit der Maschinen. Ein wichtiger Entwicklungsschritt hierbei ist die Neu- und Weiterentwicklung der Werkzeuge (Toolings), zum Beispiel für die Verarbeitung ungewöhnlicher Substrate vor allem im MEMS-Bereich. Diese Neuerungen verbessern die Vermarktungsmöglichkeiten in einem durch die Vielseitigkeit der Prozesse und Substrate gekennzeichneten Technologiebereich. Bei den Produktionsalignern MA200 Compact, MA300 und MA150e wurde die Automatisierung sowie die Einbettung in Fab-Automatisierungssysteme weiterentwickelt. Damit trägt SÜSS MicroTec den steigenden Anforderungen hinsichtlich Automatisierung und Wafertracking in den Hochvolumenmärkten Rechnung.

SUSS MicroTec Photonic Systems entwickelt und fertigt UV-Projektionsscanner sowie Excimer-Laser-Stepper. Diese Maschinen sind hochkomplex und die Entwicklung neuer Maschinengenerationen erstreckt sich über einen vergleichsweise langen Zeitraum. Im Geschäftsjahr 2013 wurden sowohl die Projektionsscanner als auch die Excimer-Laser-Stepper weiterentwickelt und die jeweils neue Maschinengeneration wird im Verlauf des ersten Halbjahres 2014 in den Markt eingeführt werden. Bei den Neuerungen geht es im Wesentlichen darum, die Anforderungen moderner Packaging-Technologien in der Volumenproduktion zu adressieren.

SUBSTRAT BONDER

Das Segment Substrat Bonder konnte im Geschäftsjahr 2013 einen Folgeauftrag für die neueste Generation von Produktions-Bond-Clustern verbuchen. Der Kunde, der bereits 2012 erste Geräte von SÜSS MicroTec installiert hat, plant mit den neu bestellten Systemen in die Vorserienproduktion einzusteigen. Für diese Maschinen wurden zahlreiche Neu- und Weiterentwicklungen durchgeführt, dazu gehört unter anderem die kontinuierliche und konsequente Verbesserung der Hardware und Software für die Anforderungen in der Massenproduktion. Die Fähigkeit, Anlagen in die Fab-Automation auf Kundenseite einbinden zu können, ist für die Volumenfertigung unablässig. Daneben wurde an der Verbesserung des Durchsatzes und der vollautomatischen Beladung für Wafer und Tapeframe Loadports gearbeitet.

In Zusammenarbeit mit einem externen Partner wurde der Prototyp eines kostengünstigen Excimer-Laser-Debonders entwickelt. Der Excimer-Laser-Debonder wird für die Entwicklung von neuartigen, temporären Bondprozessen für Interposer- und 3D-Anwendungen eingesetzt. Die Prozessentwicklung fand in Kooperation mit verschiedenen Materialherstellern statt. Im Geschäftsjahr 2013 wurde darüber hinaus ein neuartiger Bonder für Fusions- und Hybrid-Bondprozesse auf Basis der XBS300 Gen2-Plattform fertiggestellt und im Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungsprogrammes bei einem führenden europäischen Forschungsinstitut installiert.

FOTOMASKEN EQUIPMENT

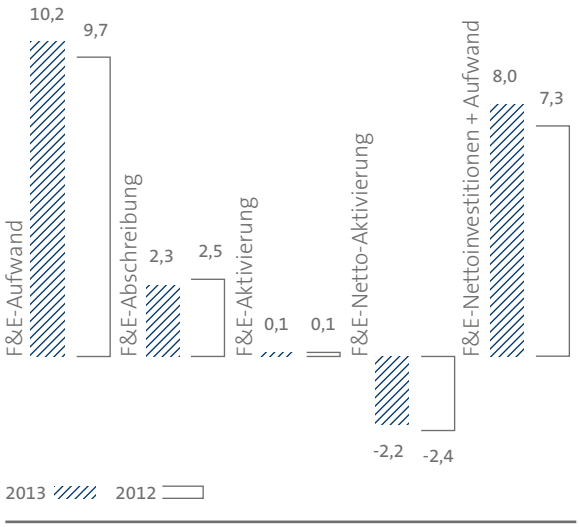
Immer kleinere Strukturen und eine immer höhere Integrationsdichte verlangen stets die Erweiterung bestehender als auch die Entwicklung neuer Lithografie-Technologien im Halbleiter-Frontend. Die 193-nm-Immersionslithografie, basierend auf der Verwendung optischer Transmissionsmasken, sowie die EUV-Lithografie, die hochempfindliche reflektierende Masken verwendet, sind dabei die beiden Technologien, die die Entwicklungen im Markt vorantreiben. Infolgedessen müssen auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie die Fotomaskenreinigung, eine der Kernkompetenzen von SÜSS MicroTec, angepasst werden.

Im Jahr 2013 lag ein wesentlicher Fokus auf der Evaluierung von Methoden zur Verbesserung der Sauberkeit der Rückseite von EUV-Masken während des Fotomaskenreinigungsprozesses. Neben der Optimierung der Reinigungsapplikation an sich wurde der Einsatz von verschiedenen Materialien und Geometrien für den Fotomaskensubstrathalter (Chuck) in der Reinigungskammer untersucht. Während bei dem vorherigen Chuck kleinste Partikel herausgelöst wurden und sich teilweise auf der Fotomaskenrückseite abgesetzt hatten, konnte mit einer neuartigen Chuck-Variante die intrinsische Reinheit auf ein Maximum angehoben werden. Hinzu kam, dass durch die Materialauswahl der Chuck wesentlich filigraner und mit reduzierten Störkanten geformt werden konnte, wodurch wiederum die Effizienz der Rückseitenspülung während der Reinigung gesteigert wird.

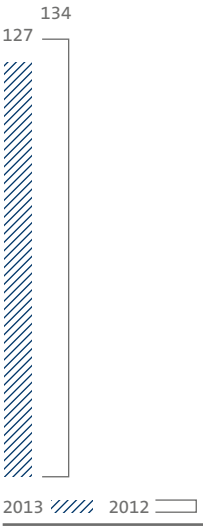
Das im Jahre 2012 in das MaskTrack Pro InSync-System integrierte Rückseiteninspektionsgerät, wodurch ein weiterer wesentlicher Schritt zur Unterstützung der gesamten EUVL-Infrastruktur und -logistik geschaffen wurde, wird mit einer von SÜSS MicroTec eigens entwickelten Software unterstützt. Diese erlaubt die Bewertung der ermittelten Defektdaten und automatisiert eine ggf. notwendige weitere Reinigung des Substrates. Im vergangenen Jahr wurde im Rahmen eines Projektes mit einem großen Chiphersteller diese Defektdatenanalyse weiter ausgebaut, die eine detaillierte Klassifizierung der Daten aufgrund ihrer Größe und Art zulässt.

Nach der Einführung eines neuen Reinigungsmediums konnte im Jahr 2013 der Reinigungsprozess dahingehend qualifiziert werden, dass eine Reinigung von Fotomasken für die optische Lithografie (193i) für einen Technologieknoten < 16 nm möglich ist. Hierdurch wird eine weitere Reduzierung der Beeinträchtigung der optischen Eigenschaften und der Beschädigung der Strukturen auf den Masken erzielt. Mit diesen Entwicklungen stellt SÜSS MicroTec die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplettlösungen für die EUV-Lithografie und 193i-Technologie anzubieten.

***F&E-AUSGABEN IM JAHRESVERGLEICH** in Mio. €*



F&E-MITARBEITER



Überblick über den Geschäftsverlauf

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

Den Aussagen des ifo-Instituts zufolge ist die deutsche Wirtschaft hoffnungsfroh ins neue Jahr gestartet. Das ifo-Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands hatte sich im Januar 2014 zum dritten Mal infolge verbessert. Die wirtschaftliche Situation in den Industrieländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanzkrise belastet, aber auch hier stehen die Zeichen auf Erholung. Insgesamt hat sich die seit Mitte 2013 anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften positiv auf das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Für das Gesamtjahr 2013 prognostiziert der International Monetary Fund in seinem World Economic Outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, für 2014 geht man von einem beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

BRANCHENSPEZIFISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 4,8 % gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. USD im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: Semiconductor Industry Association). Getragen wurde das Wachstum durch eine starke Nachfrage nach DRAM- und NAND-Speicherbausteinen für die Segmente Smartphones und Tablet Computer.

Der Markt für Halbleiter-Equipment wies dagegen erneut einen Rückgang aus. Im Jahr 2013 ist laut Gartner die Nachfrage nach Halbleiter-Equipment insgesamt um rund 8,5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken (Vorjahr: minus 16,1 %). Die Equipmentbranche verzeichnet seit fast drei Jahren ein zögerliches Investitionsverhalten der Kunden, die Fertigungskapazitäten werden zum letztmöglichen Zeitpunkt erweitert und große Neuinvestitionen finden nur vereinzelt statt.

UNTERNEHMENSENTWICKLUNG

Im Prognosebericht des Geschäftsberichts 2012 hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von rund 150 Mio. € sowie ein Ergebnis (EBIT) im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich in Aussicht gestellt. SÜSS MicroTec hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem Umsatz in Höhe von 134,5 Mio. € abgeschlossen. Der Grund für die Abweichung im Umsatz sind Verschiebungen der Endabnahme von einzelnen größeren Aufträgen, bei denen die Maschinen bereits zum Kunden ausgeliefert wurden, die finale Abnahme und somit Umsatzlegung jedoch erst im Geschäftsjahr 2014 stattgefunden hat bzw. stattfinden wird. Aufgrund des geringeren Umsatzvolumens, eines ungünstigen Produktmix im Hinblick auf 200-mm- und 300-mm-Systeme und unter Berücksichtigung der Sonderaufwendungen für den Bereich Permanentes Bonding in Höhe von 13,2 Mio. € hat das Unternehmen ein EBIT von minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr: 11,7 Mio. €).

Der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 14,1 % auf 135,0 Mio. € gesunken (Vorjahr: 157,2 Mio. €).

Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2013 auf 47,1 Mio. €. Die Nettoliquidität hat sich zum Jahresende 2013 auf 35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €) erhöht, obwohl im letzten Jahr 8,9 Mio. € in den Erwerb der Immobilie am Standort Garching investiert wurden. Der freie Cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 85,7 Mio. € und lag nur leicht unter dem Vorjahresniveau von 86,5 Mio. €.

Das Verhältnis von neu eingegangen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich 2013 auf 1,0 nach 0,96 im Vorjahr.

UMSÄTZE UND AUFTRAGSLAGE IN DEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien", um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

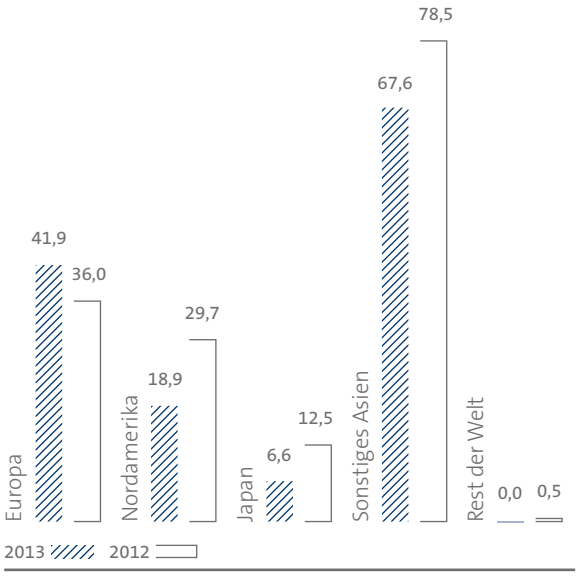
Auftragseingänge nach Regionen

Der Markt für Halbleiter-Equipment ist im Jahr 2013 um rund 8,5 % geschrumpft, dies spiegelt sich auch bei SÜSS MicroTec in rückläufigen Umsatz- und Auftragseingangszahlen wieder. Die Auftragseingänge haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,1 % verringert.

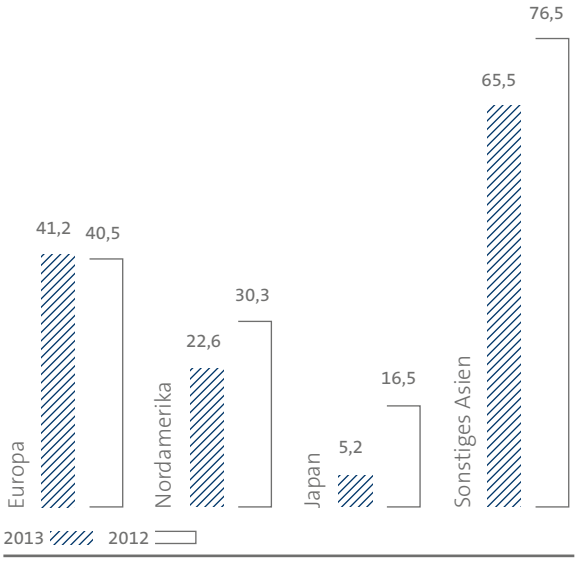
Europa ist die einzige Region, die steigende Auftragseingänge verbuchen konnte. Die Region erreichte mit einem Auftragseingang von 41,9 Mio. € (Vorjahr: 36,0 Mio. €) ein Plus gegenüber Vorjahr von rund 16 %. Aufgrund von weniger Aufträgen aus den Produktlinien Fotomasken Equipment und Mask Aligner verzeichnete die Region Nordamerika einen Rückgang um 36,4 % im Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2013 Aufträge in Höhe 18,9 Mio. € (Vorjahr: 29,7 Mio. €). Die Region Japan verzeichnete im Jahr 2013 einen Auftragseingang von 6,6 Mio. €, was ein Minus von 47,2 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. In dieser Region wurden im Vergleich zum Vorjahr vor allem weniger Aufträge aus dem Segment Substrat Bonder verbucht.

In der wichtigsten Region sonstiges Asien (ohne Japan) verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe ein Auftragsminus in Höhe von 13,9 % auf 67,6 Mio. € (Vorjahr: 78,5 Mio. €).

***AUFTRAGSEINGÄNGE NACH REGIONEN** in Mio. €*



***UMSÄTZE NACH REGIONEN** in Mio. €*



Umsätze nach Regionen
Alle Regionen, mit Ausnahme der Region Europa, mussten im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang im Umsatz hinnehmen. In Europa erhöhte sich der Umsatz um rund 2 % auf 41,2 Mio. € nach 40,5 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 25,4 % auf 22,6 Mio. € (Vorjahr: 30,3 Mio. €). Auch Japan erwirtschaftete mit 5,2 Mio. € einen deutlich niedrigeren Wert als im Vorjahr (16,5 Mio. €). Die Region sonstiges Asien verzeichnete einen Umsatzrückgang um 14,4 % auf 65,5 Mio. € (Vorjahr: 76,5 Mio. €).

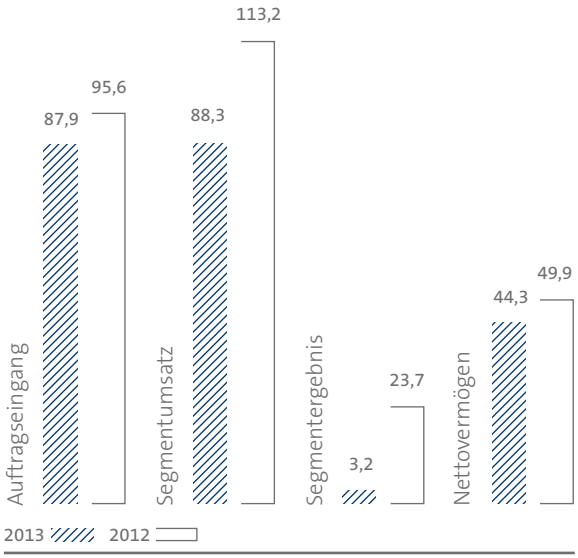
GESCHÄFTSENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN

Lithografie
Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, UV-Projektionsscanner, Laser Processing Tools sowie Developer und Coater. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 66 % der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 87,9 Mio. € sowie einen Umsatz von 88,3 Mio. €. Dies entspricht einem Rückgang im Auftragseingang um rund 8 % bzw. einem Minus im Umsatz um 22 % gegenüber dem Vorjahr. Obwohl viele unserer asiatischen Kunden mit hohen Auslastungsgraden im Bereich um 90 % arbeiten, werden Investitionen zur Kapazitätsausweitung weiterhin nur sehr zögerlich ausgeführt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es nur wenige nennenswerte Investitionen in 300-mm-Geräte, welche für SÜSS MicroTec typischerweise eine sehr gute Bruttomarge ausweisen.

Das verringerte Segmentergebnis (EBIT) ist dem ungünstigen Produktmix im Hinblick auf 200-mm- und 300-mm-Geräte, der Belastung durch den negativen Ergebnisbeitrag von SUSS MicroTec Photonic Systems sowie dem insgesamt gesunkenen Umsatz geschuldet. Das EBIT fiel von 23,7 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies ist ein Rückgang um 87 %. Die Bruttomarge hat sich gegenüber Vorjahr deutlich verringert und lag 2013 bei 27,2 % (Vorjahr: 40,7 %).

SEGMENTÜBERSICHT LITHOGRAFIE in Mio. €

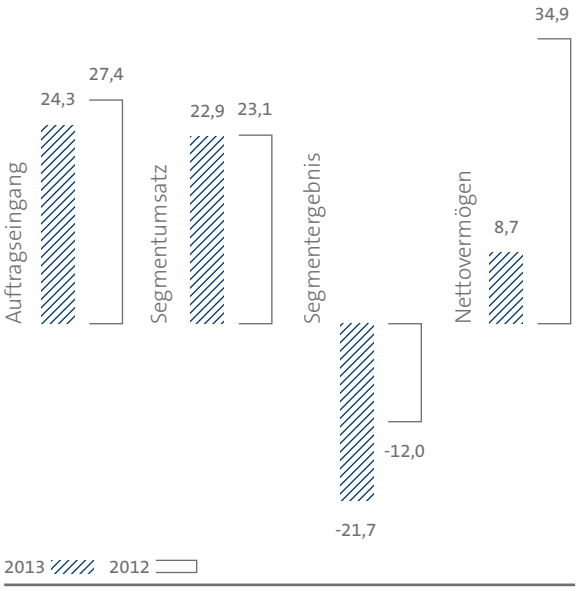


Substrat Bonder
Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 24,3 Mio. € (Vorjahr: 27,4 Mio. €) als auch im Umsatz mit 22,9 Mio. € (Vorjahr: 23,1 Mio. €) verhalten. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel aufgrund der Sonderbelastungen der Restrukturierung im Bereich permanentes Bonden in Höhe von 13,2 Mio. € von minus 12,0 Mio. € im Jahr 2012 auf minus 21,7 Mio. €. Die Bruttomarge verschlechterte sich von minus 10,1 % auf minus 53,5 %.

Aufgrund der Neubewertung der Geschäftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie wurden die im zweiten Quartal des Jahres 2013 eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erweitert und die Produktion von Permanenten Bond-Cluster-Systemen eingestellt. Die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent-Bonding-Systeme sind von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Restrukturierungsmaßnahmen haben im Gesamtjahr 2013 Sonderaufwendungen in Höhe von insgesamt 13,2 Mio. € nach sich gezogen. Die Sonderaufwendungen beinhalten 9,3 Mio. € aus der Abwertung von Vorräten (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie Demoequipment) sowie 2,7 Mio. € aus vorsorglich gebildeten Rückstellungen für einzelne Kundenprojekte und 1,2 Mio. € nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen, die im Wesentlichen auf aktivierte Entwicklungsleistungen aus den Jahren bis 2008 entfallen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das Management von SÜSS MicroTec in Zukunft eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder.

***SEGMENTÜBERSICHT SUBSTRAT BONDER** in Mio. €*

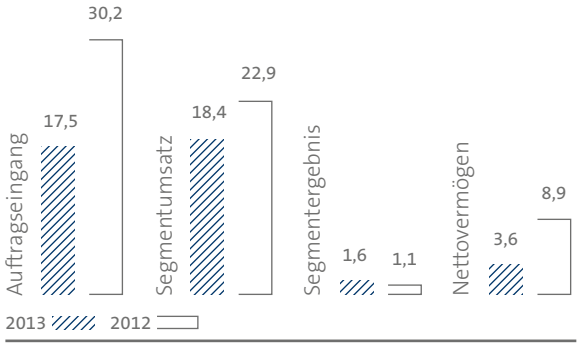


Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec im Frontend tätig.

Auch das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang und Umsatz verhalten. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2013 bei 17,5 Mio. € (Vorjahr: 30,2 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 18,4 Mio. € nach 22,9 Mio. € im Jahr 2012. Das Segmentergebnis (EBIT) hat sich verbessert und weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Wert von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) aus. Die Bruttomarge lag nach 27,6 % im Vorjahr bei 33,3 %.

***SEGMENTÜBERSICHT FOTOMASKEN EQUIPMENT** in Mio. €*

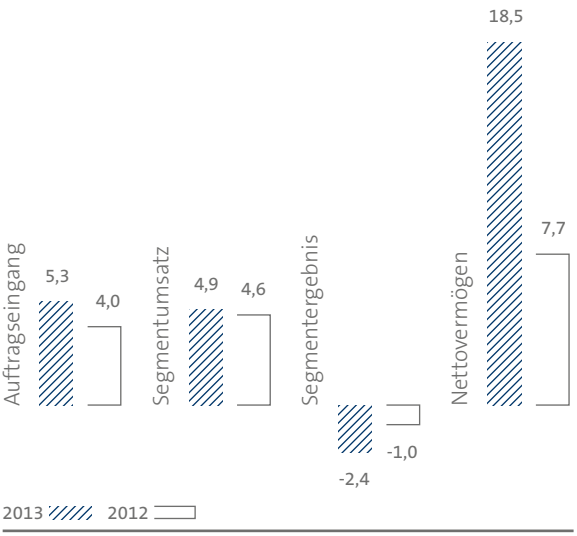


Sonstige

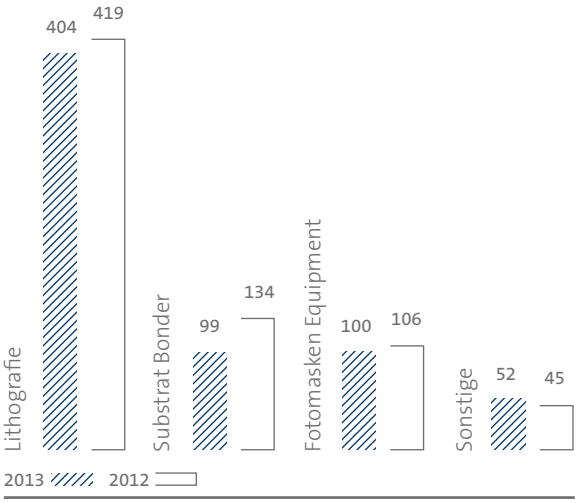
Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, und das Geschäftsfeld C4NP sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Der Anteil an dem Mikrooptik-Geschäft wurde im ersten Halbjahr 2012 von 85 % auf 100 % aufgestockt. Damit soll das Unternehmen SUSS MicroOptics, welches wichtige Schlüsseltechnologien beherrscht, noch enger an SÜSS MicroTec gebunden werden.

Der Auftragseingang steigerte sich von 4,0 Mio. € im Geschäftsjahr 2012 auf 5,3 Mio. € im Jahr 2013. Der Segmentumsatz belief sich auf 4,9 Mio. € nach 4,6 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei verzeichnete das Geschäftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang einen deutlichen Zuwachs von 3,9 Mio. € auf 5,2 Mio. € sowie einen stabilen Umsatz in Höhe von 4,6 Mio. €. Für das Geschäftsjahr 2013 belief sich das Segmentergebnis auf minus 2,4 Mio. € nach minus 1,0 Mio. € im Vorjahr.

SEGMENTÜBERSICHT SONSTIGE in Mio. €



MITARBEITER NACH SEGMENTEN



NICHTFINANZIELLE LEISTUNGSINDIKATOREN

SÜSS MicroTec verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Fertigung von Anlagen und Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen. Das Unternehmen hat für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereitzustellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht.

Qualitätsmanagement

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomasken Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen.

Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagement-System, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz unter ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit genießt bei uns eine sehr hohe Priorität. Als Technologieführer und Innovationstreiber fühlt sich das Unternehmen nicht nur der Erstklassigkeit der Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern, wir streben allzeit nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander. Darüber hinaus legt SÜSS MicroTec die gleichen hohen Maßstäbe an die Zulieferer und Geschäftspartner.

In den vergangenen Jahren hat SÜSS MicroTec am Produktionsstandort Garching verschiedene energieeffiziente Maßnahmen, wie beispielsweise die Optimierung der Pumpensysteme in der Heizungs- und Klimatechnik, den Einsatz von Druckluftkompressoren mit Wärmerückgewinnung, neue Beleuchtungskonzepte sowie generell einen bewussteren Umgang mit Energie eingeführt. Mit diesen Maßnahmen konnte der Stromverbrauch seit 2008 um mehr als 15 % gesenkt werden.

Aufgrund altersbedingter Funktionsdefizite wurden im Geschäftsjahr 2013 die Kälteaggregate am Standort Garching in mehreren Bauabschnitten in den Reinräumen erneuert. Die zwei neuen Kälteaggregate, die mit einer „freien Kühlung“ ausgestattet sind, können Energieeinsparungen bei Außentemperaturen unter 11°C bewirken. Erfahrungsgemäß geht man davon aus, dass sich bei diesen Temperaturen (an ca. 90 Tagen / Jahr) der Kühlbedarf um ca. 30 % reduziert, d. h. die Kompressoren der Kältemaschinen werden dadurch entlastet und die Energiekosten gesenkt. Die neuen Kältemaschinen wurden in einem Kälteverbund so installiert, dass jetzt eine redundante Kälteherstellung gegeben ist, d. h. im Störungsfall (z. B. Ausfall einer Kältemaschine, Wartungsarbeiten) wird die Produktion deshalb nicht beeinträchtigt. Mit diesen Umbauarbeiten hat das Unternehmen die Produktionssicherheit am Standort Garching erhöht und gleichzeitig eine weitere energieeffiziente Maßnahme durchgeführt.

SÜSS MicroTec ist weiterhin Partner der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) und bekennt sich zu nachhaltigem und verantwortungsbewusstem Handeln. Zudem fühlt sich das Unternehmen dem Verhaltenskodex der Electronic Industry Citizenship Coalition® (EICC®) verpflichtet und hat die für die ISO 14001-Zertifizierung notwendigen Teile umgesetzt. Der EICC® setzt Normen fest, die sichere Arbeitsbedingungen in der Beschaffungskette der Elektronikindustrie, eine respekt- und würdevolle Behandlung der Arbeitskräfte sowie umweltgerechte und ethisch vertretbare Geschäftsprozesse gewährleisten sollen.

Mitarbeiter

Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt, (*www.suss.com > Unternehmen > Qualitätsmanagement*) gibt es spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese regelmäßig aus. In regelmäßigen Abständen bieten wir darüber hinaus betriebsärztliche Termine z. B. zu kostenlosen Sehtests oder Schutzimpfungen an.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex („Code of Conduct“) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

Kundenbeziehungen
Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang mit insiderrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test Houses (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Ertragslage

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2013 einen deutlichen Umsatzrückgang und ein negatives Jahresergebnis. Die Umsätze sanken im Vergleich zum Vorjahr um rund 18 % und beliefen sich auf 134,5 Mio. €, während im Vorjahr noch Umsätze von 163,8 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf minus 19,4 Mio. €. 2012 wurde ein positives EBIT von 11,7 Mio. € erreicht.

Im EBIT des Geschäftsjahres 2013 sind Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen angefallen sind[1]. Dabei handelt es sich um Wertminderungen auf Lagerbestände (9,3 Mio. €), außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten (1,2 Mio. €), Wertberichtigungen auf Kundenforderungen (0,5 Mio. €) und Bildung von Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (2,2 Mio. €). Ohne diese Sonderaufwendungen würde das EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Der Rückgang der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus geringeren Umsätzen im Segment Lithografie. Während im Vorjahr noch Lithografie-Umsätze von 113,2 Mio. € erzielt werden konnten, beliefen sich die Umsätze im abgelaufenen Geschäftsjahr nur auf 88,3 Mio. €. Der Rückgang betraf sowohl die Produktlinie Mask Aligner als auch die Produktlinie Coater. Das 2012 neu hinzugekommene Geschäft von SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) mit den Produktlinien UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung trug mit Umsätzen von 11,6 Mio. € zum Konzernumsatz bei. In 2012 (seit dem Akquisitionszeitpunkt 29. März 2012) wurden mit den Photonic-Systems-Produktlinien lediglich Umsätze von 1,9 Mio. € erzielt. Die Umsätze im Segment Substrat Bonder bewegten sich mit 22,9 Mio. € in etwa auf Vorjahresniveau (Umsatz 2012: 23,1 Mio. €). Im Segment Fotomasken Equipment wurden mit 18,4 Mio. € rund 20 % geringere Umsätze erzielt als im Vorjahr. Die Umsätze im Bereich Mikrooptik erhöhten sich leicht von 4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €.

[1] Siehe Ad-Hoc-Mitteilung der SÜSS MicroTec AG vom 6. November 2013

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,3 Mio. € enthalten. Davon betreffen 1,2 Mio. € außerplanmäßige Abschreibungen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Bereich Permanent-Bond-Cluster aktiviert wurden. Die Neu-Aktivierungen beliefen sich auf knapp 0,1 Mio. €. Im Vorjahr wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 2,5 Mio. € erfasst, während sich die Neu-Aktivierungen ebenfalls auf 0,1 Mio. € summierten.

Im Geschäftsjahr 2013 wurde ein Rohertrag von 21,8 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 16,2 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 57,4 Mio. €; die Rohertragsmarge 2012 belief sich auf 35,0 %. Der Rohertrag des Geschäftsjahres 2013 ist belastet mit Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs. Von den gesamten Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € sind 10,5 Mio. € in den Umsatzkosten erfasst. Darüber hinaus enthalten die Umsatzkosten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. € auf Maschinen im Vorratsbestand der SUSS MicroTec Photonic Systems, die im Rahmen der Purchase Price Allocation im Vorjahr neu bewertet wurden.

Der Rohertrag im Segment Lithografie war im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich geringer als noch im Vorjahr. Die Rohertragsmarge war belastet durch das negative Rohergebnis der Photonic-Systems-Produktlinien, die mit Umsätzen von 11,6 Mio. € einen substantiellen Umsatzbeitrag geleistet haben. Darüber hinaus hat das geringe Umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie der ungünstige Produktmix die Rohertragsmarge negativ beeinflusst.

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war erneut negativ. Neben den erfassten Sonderaufwendungen von 13,2 Mio. € ist das Rohergebnis auch belastet durch die unterjährig angefallenen negativen Margen der Permanent-Bond-Cluster-Systeme. Die Umsätze im Bereich Temporary Bonding und De-Bonding erzielten – aufgrund der noch geringen Stückzahlen – nur niedrige Margen.

Erfreulich hat sich die Rohertragsmarge des Segments Fotomasken Equipment entwickelt. Aufgrund einiger margenstarker Aufträge lag die Rohertragsmarge deutlich über der im Vorjahr erzielten Marge.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres verringerten sich von 20,7 Mio. € im Vorjahr auf 17,5 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 13,0 % (Vorjahr: 12,6 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 17,0 Mio. € im Vorjahr auf nun 15,0 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 11,1 % (Vorjahr: 10,4 %).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 9,7 Mio. € im Vorjahr auf 10,2 Mio. €. Sie betrafen mit 5,4 Mio. € das Segment Lithografie und mit 3,0 Mio. € das Segment Substrat Bonder. 1,4 Mio. € waren dem Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen. In den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen des Segments Substrat Bonder sind im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,2 Mio. € Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen im Geschäftsjahr 5,5 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €) und beinhalten vor allem Erträge aus Fremdwährungsumrechnungen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Die Auflösung der entsprechenden Verbindlichkeit resultiert aus einer Neubeurteilung der voraussichtlichen Ertragslage von SUSS MicroTec Photonic Systems, auf deren Basis der Earn-Out für die Verkäufer und die Mitarbeiter von Photonic Systems ermittelt wird. Auch im Vorjahr wurden hier Erträge aus einer Anpassung der Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 2,1 Mio. € erfasst.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2013 auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: 4,4 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen sowie Aufwendungen für die Bildung von Wertberichtigungen auf Kundenforderungen. In den Wertberichtigungen auf Kundenforderungen sind 0,5 Mio. € enthalten, die ein Kundenprojekt des Bereichs Permanent-Bond-Cluster betreffen und daher im Rahmen der Restrukturierung dieses Bereichs wertberichtigt wurden.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 3,2 Mio. € (Vorjahr: 23,7 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 3,6 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert hat (Umsatzrendite des Vorjahres: 20,9 %). Der Rückgang des Ergebnisses und der Umsatzrendite des Segments Lithografie ist zum einen auf die nun enthaltenen Produktlinien von Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) zurückzuführen, die einen Umsatzbeitrag von 11,6 Mio. € und ein negatives EBIT von minus 5,1 Mio. € beisteuerten. In diesem EBIT-Betrag sind auch Erträge aus der Auflösung einer Earn-Out-Verbindlichkeit in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Zum anderen war das EBIT des Segments Lithografie negativ beeinflusst durch ein geringes Umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie durch einen ungünstigen, margenschwachen Produktmix.

Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von minus 21,7 Mio. € nach minus 12,0 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis ist belastet mit Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen angefallen sind. Zudem liegt die Bruttomarge von Substrat Bondern für temporäres Bonden und De-Bonden nach wie vor im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Ergebnis von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 8,4 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2012: 4,8 %) erhöht. Grund für die – trotz eines geringeren Umsatzes – erhöhte Umsatzrendite sind im Wesentlichen einige margenstarke Aufträge, die 2013 realisiert werden konnten.

Das Finanzergebnis belief sich 2013 auf minus 0,1 Mio. € (nach 11 Tsd. € im Vorjahr).

Das Konzernergebnis ist mit einem Steuerertrag in Höhe von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steuerquote von rund 18 % entspricht. Grund für die geringe Steuerquote sind im Geschäftsjahr 2013 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Im Vorjahr war das Konzernergebnis mit einem Steueraufwand von 4,1 Mio. € belastet; die durchschnittliche Steuerquote betrug im Vorjahr rund 35 %.

Im Konzern ergab sich ein Verlust nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von minus 16,0 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 7,6 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Vorjahr ein Ergebnis nach Steuern von 1,5 Mio. €, das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Der erzielte Ertrag resultierte aus einer nachträglichen Kaufpreiszahlung im Zusammenhang mit dem Verkauf des Test-Business, die der SÜSS MicroTec AG im Februar 2012 ausbezahlt wurde.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von minus 16,0 Mio. € (Vorjahr: 9,1 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten betrug minus 0,84 € nach 0,48 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 12,0 % von 233 Tsd. € auf 205 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

Finanz- und Vermögenslage

Die Net Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – erhöhte sich von 32,3 Mio. € im Vorjahr auf 35,7 Mio. € zum 31. Dezember 2013. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 36,6 Mio. € im Vorjahr auf 47,1 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 16,3 Mio. € (Vorjahr: minus 0,6 Mio. €). Hier machte sich vor allem der deutliche Anstieg des Bestands an erhaltenen Anzahlungen bemerkbar, aus dem ein Mittelzufluss in Höhe von 13,6 Mio. € resultierte. Daneben waren Mittelzuflüsse von 8,2 Mio. € aus dem Rückgang der Kundenforderungen zu verzeichnen. Die Veränderung der Lieferantenverbindlichkeiten sowie der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen haben Mittelabflüsse von 0,9 Mio. € und 2,3 Mio. € nach sich gezogen.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere minus 12,2 Mio. €. Für den Erwerb der Immobilie am Firmenhauptsitz in Garching flossen liquide Mittel in Höhe von 8,9 Mio. € ab. Neben dem Kaufpreis von 8,6 Mio. € sind hier Erwerbsnebenkosten von 0,3 Mio. € enthalten. Die übrigen Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise die Fertigstellung von Einbauten (insbesondere ein neuer Reinraum) in den neu gemieteten Räumen der SUSS MicroOptics (Hauterive / Schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 1,3 Mio. € zu verzeichnen waren. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften getätigt. Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrafen überwiegend Software. Im Vorjahr betrug der Cashflow aus Investitionstätigkeit ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere und bereinigt um den Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc. (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) sowie ohne Berücksichtigung der nachträglichen Kaufpreiszahlung für das Test-Business minus 4,2 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 4,1 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verkäufen und bereinigt um die Zahlungsströme aus dem Kauf Tamarack Scientific und dem Verkauf Test) von minus 4,5 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet einen Zufluss von 7,5 Mio. € aus der Aufnahme eines Bankdarlehens, mit dem der Erwerb der Immobilie Garching gegenfinanziert wurde. Das Darlehen weist einen fixen Zinssatz und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Es wurde im Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht.

Darüber hinaus zeigt sich im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit – wie im Vorjahr – die planmäßige Tilgung des Immobiliendarlehens Sternenfels. Im Vorjahr waren im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit auch Mittelabflüsse von 0,8 Mio. € enthalten, die die planmäßige Tilgung des Finanzierungsleasings für das konzernweite SAP-System betrafen. Im Dezember des Vorjahres wurde außerdem das Schuldscheindarlehen mit 9 Mio. € zur Rückzahlung fällig und komplett aus den vorhandenen liquiden Mitteln getilgt. Darüber hinaus war im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit des Vorjahres der Abfluss von 1,2 Mio. € für den Erwerb von 15 % der Anteile an der SUSS MicroOptics S.A. (Hauterive / Schweiz) erfasst, die bis zum Erwerbszeitpunkt von Minderheitsaktionären gehalten wurden.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 47,1 Mio. € (Vorjahr: 36,6 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 11,2 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 3,3 Mio. €.

Zum 1. April 2013 haben die SÜSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB neue Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 4,5 Mio. € gestellt wird. Dem Bankenkonsortium gehören außerdem die Deutsche Bank sowie die DZ Bank AG an. Die Kreditlinien werden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zwischen der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der Baden-Württembergischen Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,3 Mio. € (Vorjahr: 15,4 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in USD geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: Nach 3,0 Mio. € im Vorjahr betrugen sie zum Bilanzstichtag noch 0,8 Mio. €. Neben planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 1,1 Mio. € wurden außerplanmäßige Abschreibungen von 1,2 Mio. € im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs vorgenommen. Neu-Aktivierungen wurden nur noch in Höhe von knapp 0,1 Mio. € vorgenommen. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen vollständig auf das Segment Lithografie. Im Vorjahr waren neben Entwicklungskosten des Segments Lithografie in Höhe von 1,3 Mio. € weitere Entwicklungskosten in Höhe von 1,7 Mio. € aktiviert, die dem Segment Substrat Bonder zuzuordnen waren.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstände (SAP-Lizenzen) in Höhe von 2,3 Mio. € (Vorjahr: 2,7 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,3 Mio. € entfällt in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic-Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €) aufwies.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,8 Mio. € aufwiesen. Dort sind die SUSS MicroTec Lithography GmbH, die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS MicroTec AG ansässig. Das Grundstück in Sternenfels gehört bereits seit 2010 zum Konzernvermögen, während das Grundstück in Garching in 2013 für insgesamt 8,9 Mio. € erworben wurde.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden bzw. Gebäude) im Berichtsjahr auf 2,4 Mio. € im Vergleich zu 4,8 Mio. € im Vorjahr. Als größte Investition ist die Fertigstellung von Einbauten (insbesondere eines Reinraums) und die Neuanschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gemieteten Geschäftsräume der SUSS MicroOptics S.A. (Hauterive / Schweiz) zu nennen, die im Geschäftsjahr 2013 insgesamt Anschaffungskosten von rund 1,3 Mio. € verursachte.

Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 8,8 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 5,7 Mio. € nach 1,5 Mio. € im Vorjahr. Sie erhöhten sich im Wesentlichen durch die Neubildung von aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge. Dabei wurde unterstellt, dass die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SÜSS MicroTec AG als Organträger und den Organgesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec Reman GmbH) die 2013 aufgelaufenen Verluste vollständig nutzen wird. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften wurden hingegen – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung – keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 10,2 Mio. € auf nun 132,9 Mio. € zurückgegangen. Dieser Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einem geringeren Bestand an Vorratsvermögen und Kundenforderungen. Der Bestand an Wertpapieren ist ebenfalls zurückgegangen.

Im Gegenzug sind jedoch die flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag deutlich angestiegen.

Die Vorräte verringerten sich von 82,2 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 71,1 Mio. € zum Jahresende. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die zusätzlich vorgenommenen Wertberichtigungen zurückzuführen, die im Geschäftsjahr rund 10,5 Mio. € betrugen. Davon entfielen 9,3 Mio. € auf Sonderabwertungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat sich von 27,5 Mio. € im Vorjahr auf nun 25,2 Mio. € reduziert. Auch der Bestand an unfertigen Erzeugnissen ist von 34,0 Mio. € im Vorjahr auf 23,3 Mio. € zurückgegangen. Im Gegenzug erhöhte sich der Bestand an Fertigerzeugnissen von 14,6 Mio. € im Vorjahr auf 24,2 Mio. €. Davon entfallen 22,6 Mio. € (Vorjahr: 12,6 Mio. €) auf Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aussteht. Auch der Bestand an Demonstrationsgeräten stieg von 19,9 Mio. € im Vorjahr auf 21,5 Mio. € an.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 21,8 Mio. € auf 11,1 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns ging 2013 von 11,4 Mio. € auf 2,1 Mio. € zurück. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Gegenzug von 25,2 Mio. € auf 45,1 Mio. €.

Der Zuwachs der sonstigen Vermögenswerte von 1,7 Mio. € im Vorjahr auf 2,5 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf einen höheren Stand an geleisteten Anzahlungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden erhöhten sich von 11,0 Mio. € auf 14,6 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr auf 10,3 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) beliefen. Neben dem langfristigen Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der langfristige Teil des neuen Darlehens ausgewiesen, das für die Grundstücksfinanzierung Garching aufgenommen wurde. Unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind im Geschäftsjahr außerdem der langfristige Teil der Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 0,2 Mio. € für die Akquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems sowie der langfristige Teil der noch ausstehenden Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der Minderheitenanteile an der SUSS MicroOptics in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Anstieg von 42,2 Mio. € im Vorjahr auf 55,8 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der Stand der erhaltenen Kundenanzahlungen, die sich zum Jahresende auf 30,8 Mio. € (Vorjahr: 17,6 Mio. €) beliefen. Die Erhöhung ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Darüber hinaus sind auch die sonstigen Rückstellungen von 3,6 Mio. € im Vorjahr auf 5,9 Mio. € zum Jahresende angestiegen. In dem Betrag sind 2,0 Mio. € Rückstellungen für Verpflichtungen enthalten, die im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs stehen. Auch die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten haben sich um 0,9 Mio. € auf 1,2 Mio. € erhöht. Hier zeigt sich der kurzfristige Teil des neu aufgenommenen Darlehens, das der Grundstücksfinanzierung Garching dient. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich hingegen stichtagsbedingt um 1,3 Mio. € auf 5,6 Mio. € verringert.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2012 um 17,8 Mio. € auf 109,4 Mio. € verringert. Die Eigenkapitalquote sank im Jahresvergleich von 70,5 % auf 60,8 %. Die für das Vorjahr angegebenen Werte beziehen sich auf das Eigenkapital, das sich durch die retrospektive Anpassung der Vorjahreswerte aufgrund der erstmaligen Anwendung von IAS 19 (2011) ergeben hat. Die retrospektive Anpassung ist unter Punkt 2 D des Konzernanhangs detailliert erläutert.

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SÜSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr negativ dargestellt. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat ein EBIT von minus 19,4 Mio. € erzielt.

Die Net Cash-Position des Konzerns hat sich jedoch verbessert. Der Net Cash-Bestand des Konzerns betrug zum Ende des Geschäftsjahres 35,7 Mio. € (Vorjahr: 32,3 Mio. €). Dadurch verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Investitionen

2013 hat die SÜSS MicroTec AG das Betriebsgrundstück am Firmenhauptsitz in Garching erworben. Dort hat neben der SÜSS MicroTec AG auch die SUSS MicroTec Lithography GmbH ihren Sitz. Die Anschaffungskosten für das Grundstück und die Betriebsgebäude beliefen sich (inklusive Erwerbsnebenkosten) auf insgesamt 8,9 Mio. €.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2 % des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Um diesen Bereich weiter auszubauen, ist die SUSS MicroOptic S.A. (Hauterive / Schweiz) im zweiten Halbjahr 2012 in neue gemietete Geschäftsräume umgezogen und hat in diese neuen Räume einen Reinraum eingebaut sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung neu angeschafft. Seit Mitte 2012 sind hierfür Kosten von insgesamt rund 3,0 Mio. € aufgelaufen.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

Im Vorjahr sind dem Konzern durch die Akquisition Tamarack Scientific (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen von insgesamt rund 4,2 Mio. € zugegangen. SUSS MicroTec Photonic Systems ist in Corona (Kalifornien / USA) in gemieteten Räumen angesiedelt und betreibt seine Wertschöpfungskette ähnlich wie die bereits zur SÜSS MicroTec-Gruppe gehörenden Produktionsunternehmen. Somit sind auch für die Produktion der Photonic-Systems-Maschinen keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Die Holding – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDING

GESELLSCHAFT		SMT AG (HGB)		
in Tsd. €	2013	2012	Änderung	in %
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-20.601	7.595	-28.196	-
Eigenkapital	89.159	109.760	-20.601	-19
Bilanzsumme	132.869	127.264	5.605	4
EK-Quote in %	67	86		
Anlagevermögen	88.336	76.816	11.520	15
der Bilanzsumme	66	60		
Umlaufvermögen inkl. RAP	44.534	50.448	-5.914	12
der Bilanzsumme	34	40		

WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,1 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 1,4 Mio. €. Der Rückgang beruht ausschließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 53,2 Mio. € und sind damit um 4,0 Mio. € geringer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (USA). Durch die Änderung des Geschäftsmodells wird die Gesellschaft zukünftig lediglich eine für eine Vertriebsgesellschaft übliche EBIT-Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um rund 4,0 Mio. € an.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen um rund 6,5 Mio. € resultiert überwiegend aus einer Aufstockung eines Darlehens, das der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (USA), gewährt wurde.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen sanken um 16,7 Mio. €. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem Effekt aus dem Cashpooling und der Ergebnisabführung der SUSS MicroTec Lithography GmbH sowie aus der Veränderung von Intercompany-Forderungen gegen die SUSS MicroTec KK, Yokohama (Japan).

Im Berichtsjahr stieg die Liquiditätsposition der SÜSS Micro Tec AG deutlich. Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Der Anstieg der Liquiditätsposition wird im Zuwachs der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 19,8 Mio. € sichtbar. Im Gegenzug ist der Bestand an Wertpapieren um rund 9,1 Mio. € zurückgegangen. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen, die über ein Rating im Investmentgradebereich verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen stiegen im Berichtsjahr um 19,8 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Verlustübernahme der SUSS MicroTec Lithography GmbH (aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages) sowie aus Veränderungen der Intercompany-Verbindlichkeiten gegenüber der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich im Verlauf des Jahres 2013 um 7,3 Mio €. Der Anstieg resultiert aus einem neu aufgenommenen Bankdarlehen zur Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching in Höhe von 7,5 Mio. €. Gegenläufig wirkten sich die planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels aus.

Der Rückgang des Eigenkapitals um 20,6 Mio. € ist ausschließlich auf den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres von 20,6 Mio. € zurückzuführen.

WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2013 ein Jahresfehlbetrag von 20,6 Mio. € (Vorjahr: Jahresüberschuss 7,6 Mio. €).

Aufgrund des zum 01. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Aufwand aus Verlustübernahme in Höhe von 18,2 Mio. € (Vorjahr: Ertrag aus Gewinnübernahme 6,6 Mio. €) aufwandswirksam erfasst. Zudem wurde eine Wertberichtigung auf den Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec, Inc. von 4,0 Mio. € gebucht.

Gegenläufig wirkte sich ein Ertrag aus Gewinnübernahme von 0,8 Mio. € (Vorjahr: 0,5 Mio. €) aus, der aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, vereinnahmt wurde. Darüber hinaus hat die Holding aus einer Dividendenausschüttung der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan), Beteiligungserträge von rund 0,7 Mio. € erzielt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,8 Mio. € (Vorjahr: 1,9 Mio. €) und Mieterlöse in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 0,6 Mio. € (nach 2,0 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen sanken im Geschäftsjahr um 0,5 Mio. €, was im Wesentlichen auf das im Dezember 2012 zurückgeführte Schuldscheindarlehen und den damit verbundenen Zinsen zurückzuführen ist. Das neu aufgenommene Bankdarlehen in Höhe von 7,5 Mio. € wurde erst im Dezember 2013 valutiert und ausgezahlt, so dass darauf im abgelaufenen Geschäftsjahr nur geringe Zinsaufwendungen entfielen.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2013 durchschnittlich 20 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter tätig.

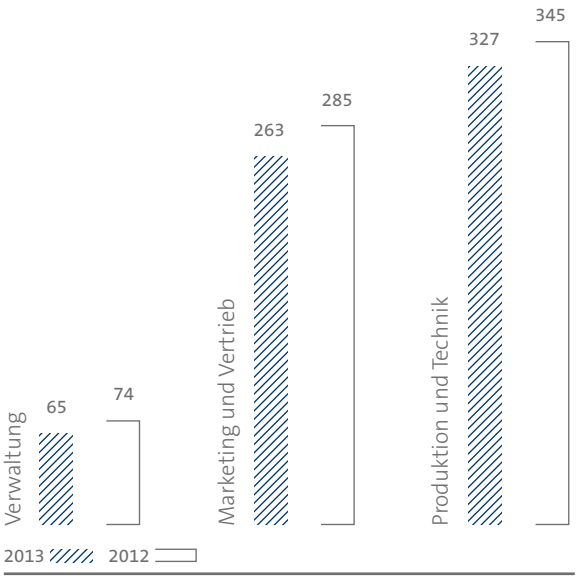
Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich aus der Veränderung der Wechselkurse von USD und JPY ergeben.

Mitarbeiter im Konzern

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2013 waren 655 (Vorjahr: 704) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

MITARBEITER NACH BEREICHEN



Bericht zu wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen

Im Geschäftsjahr 2013 ergaben sich keine wesentlichen Geschäfte mit nahestehenden Personen, die den Angabepflichten nach IAS 24 unterliegen.

ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN

Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

1. ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS

Zum 31. Dezember 2013 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00 € (Vorjahr: 19.115.538,00 €). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00 € je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

2. BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN BETREFFEN

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

3. BETEILIGUNGEN AM KAPITAL, DIE 10 % DER STIMMRECHTE ÜBERSCHREITEN

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10 % der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

4. AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, DIE KONTROLLBEFUGNISSE VERLEIHEN

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

5. ART DER STIMMRECHTSKONTROLLE, WENN ARBEITNEHMER AM KAPITAL BETEILIGT SIND UND IHRE KONTROLLRECHTE NICHT UNMITTELBAR AUSÜBEN

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen ihres Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

6. GESETZLICHE VORSCHRIFTEN UND BESTIMMUNGEN DER SATZUNG ÜBER DIE ERNENNUNG UND ABBERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN UND DIE ÄNDERUNG DER SATZUNG

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

7. BEFUGNISSE DES VORSTANDS, AKTIEN AUSZUGEBEN ODER ZURÜCKZUKAUFEN

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebotes erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

8. WESENTLICHE VEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE UNTER DER BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS INFOLGE EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS STEHEN

Mit den drei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

9. ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE FÜR DEN FALL EINES ÜBERNAHMEANGEBOTS MIT VORSTANDSMITGLIEDERN ODER ARBEITNEHMERN GETROFFEN SIND

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 4. März 2014 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter *www.suss.de > Investor Relations > Corporate Governance > Erklärung zur Unternehmensführung* allgemein zugänglich gemacht.

VERGÜTUNGSBERICHT

Vergütung des Vorstands

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTech ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden, aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen, darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

VERGÜTUNGSSTRUKTUR

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2012 bestand zudem eine aktienbasierte Vergütung.

VARIABLE VERGÜTUNG

Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 höchstens 150 % der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen. 70 % der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30 % nach Mehrjahreszielen.

AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE-VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

Die Jahresziele (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 130 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages („Vorbehaltshälfte“) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG B)

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Dabei wurden für die jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele („Milestones“) definiert, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht werden sollten. Der Aufsichtsrat legte nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach Anhörung des Vorstands durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 % und 130 % vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wurde der Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wurde zu 50 % als Vorschuss ausgezahlt und zu 50 % auf das Verrechnungskonto für die variable Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele stellte der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 % bis 130 % den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend fest. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre waren nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maßgeblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienten nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Festlegung von Mehrjahreszielen (EBIT-Marge) für drei Geschäftsjahre im Voraus. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 150 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

ABFINDUNGEN

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Für die Mitglieder des Vorstands wurde folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2013 festgesetzt:

VORSTANDSVERGÜTUNG

2013 in €	Grundgehalt[1]	Variable Vergütung	Sonstige Leistungen[2]	Aufwand für Altersversorgung
VORSTAND				
Frank Averdung	316.929,60	128.089,73	6.577,20	2.148,00
Michael Knopp	250.226,32	98.202,12	6.577,20	2.148,00

Für die Mitglieder des Vorstands wurde folgende Vergütung für das Geschäftsjahr 2012 festgesetzt:

2012 in €	Grundgehalt[1]	Variable Vergütung	Sonstige Leistungen[2]	Aufwand für Altersversorgung
VORSTAND				
Frank Averdung	316.794,24	398.046,17	6.585,60	2.148,00
Michael Knopp	237.559,80	300.193,44	6.585,60	2.148,00

[1] Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

[2] Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung
Ergänzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands (Vorjahr: 35 Tsd. €).

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG

2013 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
AUFSICHTSRAT			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	10.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	10.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	10.500,00	638,27

2012 in €	Vergütung	Sitzungsgeld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungsprämie
AUFSICHTSRAT			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	10.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	10.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	10.500,00	638,27

Im Geschäftsjahr 2013 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

NACHTRAGSBERICHT

Bericht zu wesentlichen Ereignissen nach Ende des Geschäftsjahres

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

Stimmrechtsmitteilungen nach dem Stichtag

Die Henderson Group PLC, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,17 % beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) PLC, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betrug (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % betrug (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,003 % betrug (574.032 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,275 % (243.632 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728 % (330.400 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via Baillie Gifford Overseas Limited) zuzurechnen.

BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG MIT IHREN WESENTLICHEN CHANCEN UND RISIKEN

Chancen- und Risikobericht

RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagementsystem seit Langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagementsystems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend" angesehen.

Risikohandhabung
Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB
Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2013 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit.

Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP schließlich bei der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA) implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware „INFOR PM Application Studio". Die Einzelabschlüsse werden schließlich über ein zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Nach einem verhaltenen Start ins Jahr 2013 hat die Weltkonjunktur Mitte des Jahres an Schwung gewonnen. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt ist 2013 um real 3,0 % gestiegen (nach einem Anstieg um real 3,1 % im Vorjahr). Auch das weltweite Handelsvolumen hat 2013 im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 % zugelegt. Der deutlichste Anstieg im Bruttoinlandsprodukt war erneut in den aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften (China, Indien, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand und Vietnam) zu verzeichnen. Hier wurden für 2013 Wachstumsraten zwischen 4,4 % und 7,7 % festgestellt. Auch die Bruttoinlandsprodukte der USA und Japans wuchsen 2013 um 1,9 % bzw. 1,7 %, während in den Volkswirtschaften des Euroraums insgesamt ein Rückgang um rund 0,4 % zu verzeichnen war[1].

Der gesamte Halbleitermarkt ist 2013 um rund 4,8 % gewachsen. So summierte sich das Gesamtvolumen im Halbleitermarkt 2013 auf rund 305,6 Mrd. USD (nach 291,6 Mrd. USD 2012[2]) und erreichte damit ein historisch einmalig hohes Niveau. Der Markt für Halbleiter-Equipment wies dagegen erneut einen Rückgang auf. Semi hat in seiner Pressemeldung vom Dezember 2013 für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Gesamtvolumen von rund 32,02 Mrd. USD prognostiziert, nachdem 2012 ein Gesamtvolumen von rund 36,93 Mrd. USD und 2011 ein Gesamtvolumen von rund 43,53 Mrd. USD erreicht wurde. 2013 wird somit im Halbleiter-Equipment-Markt ein Rückgang um rund 13,3 % erwartet, nachdem bereits im Vorjahr ein Rückgang um 15,2 % festgestellt wurde[3].

SÜSS MicroTec verzeichnete 2013 einen Umsatzrückgang um rund 18 %. Der höchste Umsatzanteil wurde wieder in den Regionen China, Taiwan und sonstiges Asien erzielt. Die Umsätze in diesen Regionen waren jedoch im Vergleich zum Vorjahr rückläufig und verzeichneten ein Minus von 14 %. Auch die Umsätze mit Kunden in den USA reduzierten sich deutlich um 25 %. Der prozentual größte Rückgang war jedoch in Japan zu verzeichnen: Die Umsätze mit japanischen Kunden waren um rund 69 % geringer als im Vorjahr. Lediglich die Umsätze in Europa lagen etwas über Vorjahresniveau. Der Auftragseingang erreichte mit 135 Mio. € ein um 14 % geringeres Niveau als noch 2012. Mit 29 Mio. € war vor allem der Auftragseingang des vierten Quartals 2013 unterdurchschnittlich gering.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können. Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten unserem Unternehmen jedoch – je nach Art der Entwicklung – auch zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftragseingänge und Umsätze sorgen können.

[1] Quelle: WEO Update des International Monetary Fund (IMF) vom 21. Januar 2014

[2] Quelle: Semiconductor Industry Association, Pressemeldung vom 3. Februar 2014

[3] Quelle: Semi, Pressemeldung vom 3. Dezember 2013

Marktpositionierung
Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere Technologiekompetenz werden wir als Marktführer in Mikrostrukturanwendungen wahrgenommen. Wir gehen davon aus, dass wir auch in Zukunft vom schnellen technologischen Wandel profitieren können und durch unsere Neuentwicklungen und durchdachten Prozesslösungen unsere Marktstellung weiter ausbauen können.

Abhängigkeit von einzelnen Know-how-Trägern
In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

BETRIEBLICHE RISIKEN

Vermögens- und Ertragslage
Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Durch die vorgenommenen Restrukturierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Permanent-Bond-Cluster-Bereich ist das Ergebnis 2013 mit Sonderaufwendungen in Höhe von rund 13,2 Mio. € belastet. Aufgrund der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen[1] und unter Berücksichtigung der 2013 vorgenommenen Wertberichtigungen sind aus diesem Bereich zukünftig keine weiteren Verluste mehr zu erwarten. Ohne die angefallenen Sonderaufwendungen würde das EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2013 vorhandenen Auftragsbestands und den verhaltenen Aussichten für die Halbleiter-Equipment-Branche im Jahr 2014 müssen wir damit rechnen, auch 2014 ein negatives Ergebnis zu erzielen.

[1] vgl. Ad-Hoc-Mitteilung der SÜSS MicroTec AG vom 6. November 2013

Zum 31. Dezember 2013 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,3 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Segment Substrat Bonder
Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment Substrat Bonder erneut defizitär. Im Ergebnis des Segments Substrat Bonder sind die Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen erfasst. Im Einzelnen wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 1,2 Mio. €, Wertberichtigungen auf Vorratsbestände und Kundenforderungen von 9,3 Mio. € bzw. 0,5 Mio. € sowie Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen von 2,2 Mio. € erfasst. Bereinigt um diese Sondereffekte belief sich das EBIT des Segments Substrat Bonder auf minus 8,5 Mio. €. In diesem um Sondereffekte bereinigten Ergebnis sind auch die 2013 unterjährig angefallenen negativen Margen der Permanent-Bond-Cluster-Systeme enthalten.

Auch 2014 wird das Segment Substrat Bonder ein negatives Ergebnis erzielen. Die noch im aktuellen Auftragsbestand abgebildeten Permanent-Bond-Cluster-Systeme, die in 2014 bei den Kunden installiert werden, werden zwar zum Substrat Bonder-Umsatz 2014 beitragen, jedoch keinen Beitrag zur Marge des Segments leisten. Die für das kommende Jahr erwarteten Umsätze für Temporary Bonding und De-Bonding werden noch kein hohes Niveau erreichen und damit kein positives Ergebnis erzielen.

Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SÜSS Micro Tec entwickelt wurden und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary Bonding und De-Bonding hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt durchsetzen und ob sich die 3D-Integration in der industriellen Fertigung für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den Verkauf hoher Stückzahlen werden wir zukünftig im Segment Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse erzielen können.

Einstellung von Permanent-Bond-Cluster-Systemen
Mit der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen hat SÜSS MicroTec sein Produktportfolio um eine Produktlinie bereinigt, die in der Vergangenheit nachhaltig Verluste erzielt und das Konzernergebnis negativ beeinflusst hat. SÜSS MicroTec wird alle Permanent-Bond-Cluster-Systeme, die momentan noch im Auftragsbestand abgebildet sind, vertragsgemäß bei den Kunden installieren. Es besteht jedoch das Risiko, dass die Wettbewerbsfähigkeit von SÜSS MicroTec durch diese strategische Maßnahme negativ beeinträchtigt werden könnte. Möglicherweise ergeben sich auch negative Auswirkungen auf das Geschäft mit unseren anderen Produktlinien. Diesem Risiko begegnen wir, indem wir uns auf unsere Kernkompetenzen konzentrieren und unsere Kunden mit hoher Qualität und hochwertiger Technologie zufriedenstellen.

Segment Lithografie: SUSS MicroTec Photonic Systems
Das Segment Lithografie hat 2013 ein EBIT von 3,2 Mio. € und damit eine EBIT-Marge von 3,6 % erzielt. 2012 konnte noch eine EBIT-Marge von 20,9 % erzielt werden. Im Segment Lithografie ist seit März 2012 auch das Geschäft der SUSS MicroTec Photonic Systems erfasst, die Produktlinien für UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung entwickelt und vertreibt. 2013 konnte mit diesen Produktlinien kein positives Ergebnis erzielt werden. SUSS MicroTec Photonic Systems erzielte 2013 Umsätze von 11,6 Mio. € und steuerte ein negatives EBIT von minus 5,1 Mio. € zum Konzernergebnis bei. Darin sind einmalige Erträge aus der Auflösung einer Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Aus dem operativen Geschäft der SUSS MicroTec Photonic Systems resultiert 2013 somit ein EBIT von minus 7,2 Mio. €. Ein positiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic-Systems-Produktlinien nur erzielt werden, wenn es SÜSS MicroTec gelingt, die Scanner-Systeme erfolgreich am Markt zu platzieren und ein deutlich höheres Volumen zu erreichen. Hierfür müssen zunächst aus den momentan laufenden Evaluierungsprozessen Aufträge gewonnen werden.

Preisdruck
Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken
Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

BETRIEBLICHE CHANCEN

Segment Substrat Bonder
Wir gehen fest davon aus, dass sich bei unseren Kunden in den kommenden Jahren die 3D-Integration für die industrielle Fertigung und Volumenproduktion durchsetzen wird. Mit den von uns entwickelten Technologien und Prozessen für Temporary Bonding und De-Bonding sehen wir uns sehr gut gerüstet für die kommenden Herausforderungen. Sollte die von uns erwartete Entwicklung so eintreten, sehen wir uns in der Lage, mit unseren Produktlinien im Temporary Bonding- und De-Bonding-Bereich einen substantiellen Umsatzbeitrag und – bedingt durch hohe Volumina – positive Margen zu erzielen.

Segment Lithografie: SUSS MicroTec Photonic Systems
Mit den Technologien der SUSS MicroTec Photonic Systems – der UV-Projektionsbelichtung und der Laserprozessierung – haben wir unser Produktportfolio im Bereich Lithografie ergänzt und erweitert. 2013 haben wir mehrere

Laser-Tools (ELP300) erfolgreich bei Kunden installiert und haben in ungewöhnlich kurzer Zeit von den Kunden eine Abnahme ohne Beanstandungen erzielt. Wir sehen die Chance, in den kommenden Monaten weitere Aufträge für Laser-Tools zu gewinnen und damit die Marktposition der SUSS MicroTec Photonic Systems weiter zu stärken.

Die von SUSS MicroTec Photonic Systems ebenfalls entwickelten und produzierten Scanner-Systeme (DSC300, DSC500) müssen am Markt noch Fuß fassen. Es gibt allerdings bereits vielversprechende Anfragen für diese Systeme. Derzeit evaluiert einer unserer großen Kunden intensiv einen DSC300. Sollte dieser Evaluierungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden, erwarten wir weitere positive Impulse im Marktumfeld und gehen davon aus, dass sich auch andere Kunden für diese Technologie entscheiden werden. Damit könnten wir in den nächsten Jahren substantielle Auftragsvolumen und Umsätze mit diesen Systemen erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

FINANZMARKTRISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment" implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten Risk Countries angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten Non Risk Countries ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12,9 Mio. € (Vorjahr: 22,4 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 6,1 Mio. € (Vorjahr: 15,5 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2013 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

ALTERSANALYSE DER ÜBERFÄLLIGEN FORDERUNGEN OHNE WERTBERICHTIGUNG

in Tsd. €	2013	2012
1 – 30 Tage	2.232	1.439
31 – 60 Tage	294	458
61 – 90 Tage	1.038	3.636
91 – 180 Tage	226	105
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	**3.790**	**5.638**

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 3,0 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. In dem Betrag sind auch Forderungen von 1,1 Mio. € für zwei spezielle Kundenprojekte berücksichtigt, bei denen die vertraglich zugesicherten Spezifikationen noch nicht erreicht werden konnten.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

ALTERSANALYSE DER ÜBERFÄLLIGEN FORDERUNGEN MIT WERTBERICHTIGUNG

in Tsd. €	2013	2012
< 91 Tage	73	0
91 – 180 Tage	767	368
181 – 360 Tage	1.404	535
> 360 Tage	765	366
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	**3.009**	**1.269**

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken
Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash-Bestand von 35,7 Mio. € aus (Vorjahr: 32,3 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 4,1 Mio. € (Vorjahr: minus 4,5 Mio. €).

Mit Kreditvertrag vom 23./28. Oktober 2013 hat die SÜSS MicroTec AG bei der IKB Deutsche Industriebank AG ein Darlehen über 7,5 Mio. € aufgenommen, das der Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Garching dient und eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 aufweist. Zusammen mit dem bereits bestehenden Bankdarlehen bei einer lokalen Volksbank, das der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels dient, weist der SÜSS MicroTec-Konzern zum 31 Dezember 2013 Bankverbindlichkeiten von 11,5 Mio. € aus. Die jährliche Tilgung für die beiden Darlehen wird sich für die kommenden Jahre auf 1,2 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für die beiden Darlehen bankübliche Zinsen an.

Derzeit stellen drei Banken der SUSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Bankenkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darüber hinaus besteht im Rahmen eines Kautionsversicherungsvertrages ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €, der von der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec Reman GmbH genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2013 sind diese Kredit- und Avallinien lediglich in Höhe von 3,3 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen.

Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken
Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnprozentigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 114 Tsd. € (Vorjahr: Reduzierung um 217 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

	2013		
in Tsd. €	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.615	609	**4.224**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.575	805	**2.380**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.351	-114	**-1.465**
Kundenanzahlungen	-3.861	-26	**-3.887**
Netto-Exposure	**-22**	**1.274**	**1.252**
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 % iger Aufwertung des Euro	2	-116	**-114**

	2012		
in Tsd. €	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.681	1.811	**3.492**
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.635	544	**3.179**
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.138	-138	**-1.276**
Kundenanzahlungen	-2.851	-156	**-3007**
Netto-Exposure	**327**	**2.061**	**2.388**
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 % iger Aufwertung des Euro	-30	-187	**-217**

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel verzinste Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine Bank oder über die Börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern (z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante Kursverluste entstehen.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2013 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

PROGNOSEBERICHT

Insgesamt sehen die Prognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute nach einigen schwierigen Jahren wieder positiv aus. Seit Mitte 2013 hat sich laut der „Gemeinschaftsdiagnose 2013“ führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute die anziehende Konjunktur in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften sehr positiv auf das Weltwirtschaftsklima ausgewirkt. Die wirtschaftliche Situation in den Industrieländern wird zwar weiterhin durch die Folgen der Finanzkrise belastet, aber die Zeichen stehen auf Erholung. In den Schwellenländern dagegen setzte sich die Verlangsamung des Wachstums fort und erreichte laut Schätzungen des International Monetary Fund im Jahr 2013 ein Plus von 4,7 %. Mögliche Gründe hierfür sind durch anziehende Inflationssorgen steigende Leitzinsen in vielen Schwellenländern sowie das Auslaufen verschiedener Konjunkturprogramme in China. Für das Gesamtjahr 2013 prognostiziert der International Monetary Fund in seinem World Economic Outlook ein Weltwirtschaftswachstum um 3,0 %, für 2014 geht man von einem beschleunigten Wachstum um 3,7 % aus.

Europa wird nach einem moderaten Jahr 2013 voraussichtlich wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und das Bruttoinlandsprodukt soll erwartungsgemäß um 1,0 % zulegen. Insbesondere die Krisenländer des Euroraumes haben Fortschritte bei der Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie der Umsetzung von Sparmaßnahmen erzielt. Obwohl ein Ende der Euro-Krise weiterhin nicht abzusehen ist, so scheinen die Anstrengungen zur Krisenbewältigung erste Früchte zu tragen. In Ländern wie Griechenland, Italien oder Spanien dürften die weiterhin nötigen Anpassungsprozesse einem kräftigen Wirtschaftswachstum im Wege stehen.

Für Deutschland erwartet der Sachverständigenrat eine weitere Aufhellung der konjunkturellen Lage. Nach einem moderaten Wachstum von 0,4 % im Jahr 2013 werden für 2014 ein Anspringen der Konjunktur und damit ein Wachstum von rund 1,6 % erwartet. Getragen wird dieser Aufschwung insbesondere durch erstarkte Nachfrageimpulse aus dem Inland. Der erwartete Beschäftigungsstand ist weiterhin hoch und das historisch niedrige Zinsniveau erleichtert es den Unternehmen, kreditfinanzierte Investitionen zu tätigen. Die positiven Konjunkturaussichten spiegeln sich auch am Aktienmarkt wider. In Deutschland hat der Leitindex DAX im Dezember 2013 die 9.500er-Marke durchbrochen und neue Rekordstände erreicht.

Halbleiterindustrie

Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 4,8 % gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 291,6 Mrd. USD im Jahr 2012 auf rund 305,6 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: Semiconductor Industry Association). Getragen wurde das Wachstum durch eine starke Nachfrage nach DRAM- und NAND-Speicherbausteinen für die Segmente Smartphones und Tablet Computer. Ohne diese beiden Bereiche hätte die gesamte Halbleiterindustrie im Jahr 2013 kein Wachstum verzeichnen können (Quelle: Gartner).

Für das Geschäftsjahr 2014 erwarten die Analysten der Bank of America einen erneuten Anstieg der Nachfrage im Halbleitersegment. Der Markt soll nach rund fünf Prozent im Jahr 2013 um mehr als zehn Prozent im Jahr 2014 wachsen. Die wesentlichen Wachstumstreiber werden weiterhin Speicherelemente für Smartphones und Tablet Computer, aber auch Bausteine für Logik- und analoge Anwendungen sein. Der PC-Markt wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2014 verhalten entwickeln und lediglich ein Wachstum von rund zwei Prozent erreichen.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklizität im Halbleiterbereich sehr begrenzt, so unterscheiden sich die Schätzungen der Marktforschungsinstitute zum Jahresende 2013 deutlich von den eigenen Schätzungen zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

Halbleiter-Equipment-Industrie

Der Branchenverband SEMI hat in einer Analyse des Auftragsverhaltens im Equipment-Bereich festgestellt, dass große Investitionen in Kapazitätserweiterungen und der Aufbau neuer Fabriken in den letzten beiden Jahren eher schwach ausgeprägt waren. Derzeit bewegt man sich auf einem niedrigen Investitionsniveau, wie es in Zeiten der Finanzkrise um das Jahr 2009 der Fall war. Investitionen werden überwiegend für Upgrades an bestehenden Produktionslinien vorgenommen. Neben der weiterhin vorherrschenden Marktunsicherheit sind die deutlich angestiegenen Kosten, die bei einem Aufbau neuer Fabriken entstehen, ein möglicher Grund für ein zögerliches Investitionsverhalten.

Der Markt für Halbleiter-Equipment wies entsprechend erneut einen Rückgang aus. Im Jahr 2013 ist laut Gartner die Nachfrage nach Halbleiter-Equipment insgesamt um rund 8,5 % gegenüber dem Vorjahr gesunken (Vorjahr: minus 16,1 %). Marktforscher Gartner erwartet nach zwei schwierigen Jahren mit rückläufigem Geschäftsvolumen einen Anstieg der Nachfrage nach Halbleiter-Equipment um 15,8 % im Jahr 2014. Für 2015 erwartet Gartner ein weiteres Wachstum um 17,0 %. Ein erheblicher Anteil der Nachfrage wird aus Taiwan, Korea und der Region Nordamerika kommen.

Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten

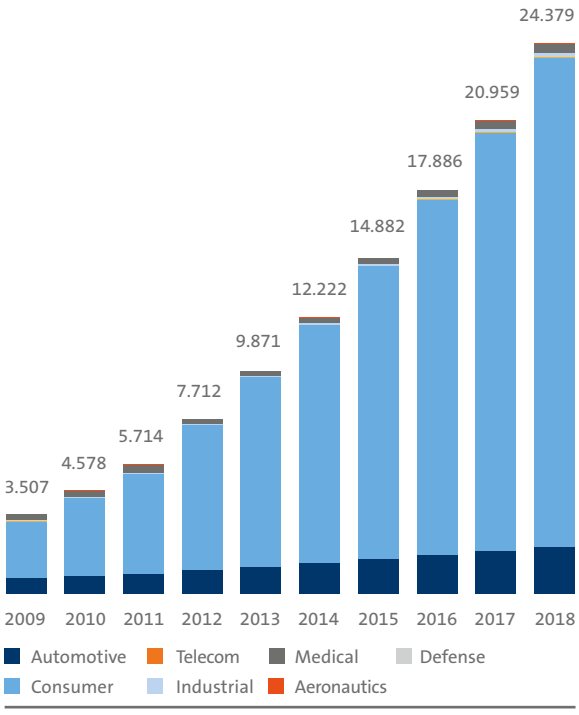
MARKT FÜR MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Mit dem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen für Smartphones und Tablet Computern sowie mobilen Navigationsgeräten hat sich die Nachfrage nach MEMS-Sensoren, insbesondere Gyroskopen, Beschleunigungssensoren und elektronischen Kompassen, in den letzten Jahren spürbar erhöht und wird auch zukünftig weiter ansteigen. Einen

weiteren vielversprechenden Wachstumsbereich stellen die MEMS-Mikrofone dar. Laut dem Marktforschungsinstitut Yole verwenden hochwertige Smartphones mittlerweile bis zu drei MEMS-Mikrofone, dazu gehören neben der klassischen Mikrofonfunktion Anwendungen wie Spracherkennung oder Geräuschunterdrückung. Auch in Spielekonsolen und anderen Konsumelektronikgeräten kommen verstärkt MEMS-Bausteine zum Einsatz.

Die Grafik zeigt deutlich, dass sich der Bereich Konsumelektronik bisher am dynamischsten entwickelt hat und auch zukünftig der größte Anwendungsbereich sein wird. Yole schätzt das durchschnittliche jährliche Wachstum des gesamten MEMS-Marktes in den Jahren 2012 bis 2018 auf über 20 %. Bei der Interpretation der Marktzahlen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Equipment-Markt in diesem Bereich weniger schnell wächst als der MEMS-Markt selbst, da durch die gesteigerte Produktivität der Fertigungssysteme eine stets höhere Anzahl an MEMS-Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

***PROGNOSE FÜR DEN MEMS-MARKT** in Mio. Stück*



Quelle: Yole 2013

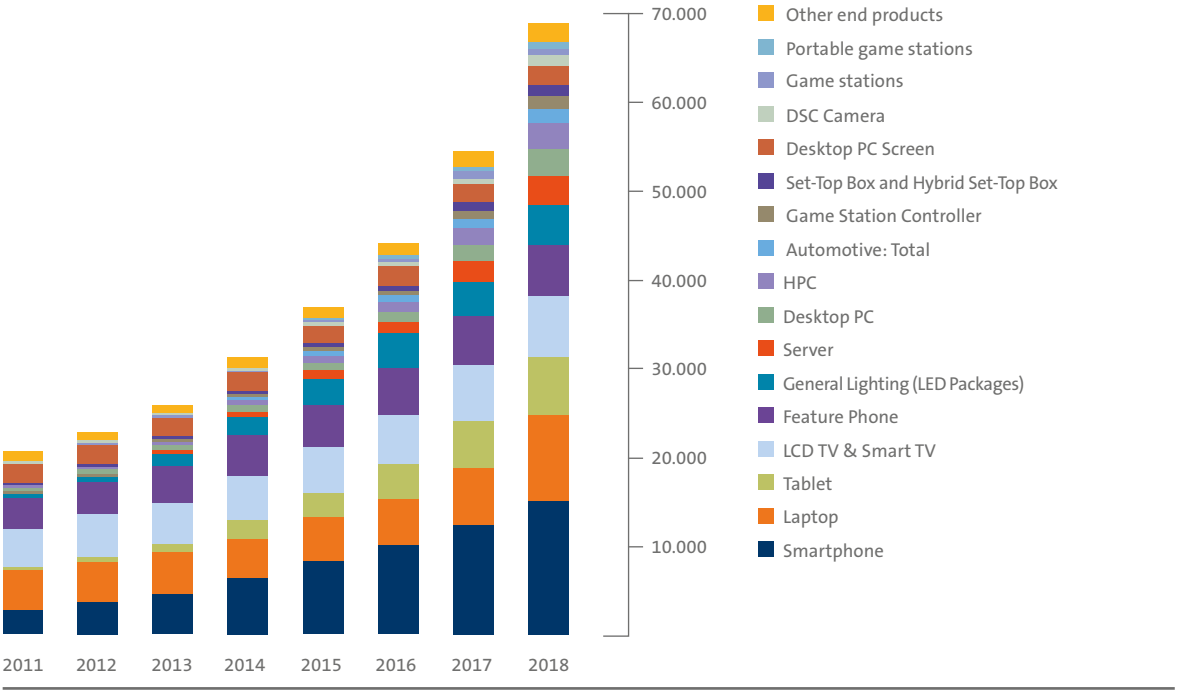
ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Laut Aussage des Branchenverbands Semi werden aktuell rund 80 % aller Mikrochips über das herkömmliche Verdrahten (Wire Bonding) mit der Außenwelt verbunden. Die verbleibenden 20 % der Chips werden über sogenannte fortschrittliche Verpackungstechnologien (Advanced Packaging) mit der Außenwelt verbunden. Neben kürzeren Verbindungswegen und einer höheren Verbindungsgeschwindigkeit ist ein weiterer Vorteil der geringere Platzverbrauch, welcher bei Smartphones und Tablet Computern eine wichtige Rolle spielt. Ohne Advanced Packaging-Technologien könnten darüber hinaus die schlanken Formfaktoren von Smartphones und Tablet Computern nicht dargestellt werden.

Unter den Advanced Packaging-Technologien subsummiert man heute verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer Level Packaging (Kontaktierung findet statt, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden) mit seinen Unterformen fan-in und fan-out, Flip Chip-Bonding, Wafer Level Chip Scale Packaging sowie die 2,5D-Integration und die 3D-Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Die Flip Chip-Verpackungstechnologie hat in den letzten Jahren bereits eine sehr dynamische Entwicklung vollzogen und ist für SÜSS MicroTec ein sehr bedeutendes Marktsegment. Marktforscher von Yole Development erwarten auch zukünftig nennenswertes Wachstum in diesem Bereich.

MARKTVOLUMEN FLIP CHIP-PACKAGING in Mio. Stück



Quelle: Yole Februar 2013

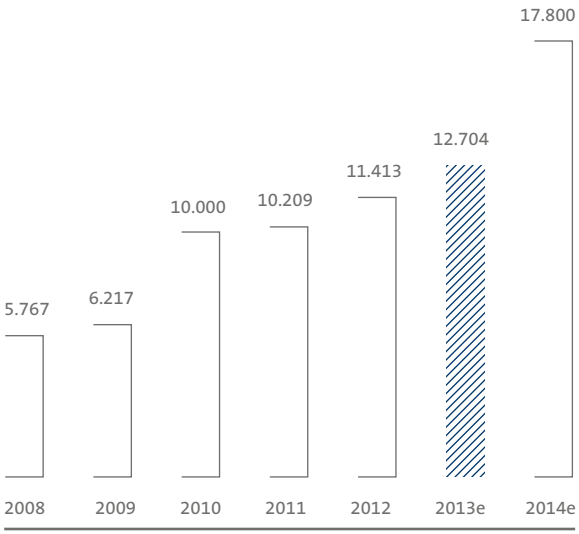
Die 3D-Integration ist eine Weiterführung der heute im Volumen eingesetzten Verpackungstechnologien, hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt und durch sogenannte TSV (Thru Silicon Vias) miteinander verbunden. Die entscheidenden Vorteile sind die hohe Packungsdichte und die enorme Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D-Integration ist es zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen. Bisher fanden diese Prozesse ausschließlich im forschungsnahen Umfeld statt. Im Jahr 2013 ist es SÜSS MicroTec jedoch gelungen, den weltweit ersten Auftrag für Geräte zur Pilotproduktion von gestapelten Chips zu verbuchen. Der Kunde wird 2014 mit der Pilotserienproduktion sowie der Prozessoptimierung beginnen. Nach Abschluss dieser Phase erfolgt üblicherweise der Übergang zur Volumenproduktion. Wie schnell dieser Übergang erfolgen wird, ist allerdings zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer zu prognostizieren.

VERBINDUNGSHALBLEITER LED (LEUCHTDIODEN)

SÜSS MicroTec konzentriert sich im Markt für Verbindungshalbleiter auf das Wachstumssegment LED (Leuchtdioden) und adressiert mit seinen Produktlösungen insbesondere Hersteller von höherwertigen Leuchtdioden, sogenannte High-Brightness (HB)- und Ultra-High-Brightness (UHB)-LED.

Im Prognosebericht 2012 haben wir von der Erwartung, dass die Umsätze mit LED ab 2013 wieder steigen, berichtet. Rückblickend lässt sich festhalten, dass das Marktvolumen von 2012 auf 2013 deutlich angestiegen ist und dass die Schätzungen für 2014 einen weiteren Wachstumsschub vorhersagen (siehe Grafik). Im Auftragseingang von SÜSS MicroTec ist bisher keine Belebung der LED-Nachfrage spürbar.

***MARKTVOLUMEN PACKAGES LEDS** in Mio. USD*



Quelle: Yole 2008 – 2013e; LEDinside für 2014e

Neben LED für die Hintergrundbeleuchtung von Fernsehgeräten rückt das Thema generelle Beleuchtung immer mehr in den Vordergrund. Fallende Preise für LED im Zusammenhang mit der überzeugenden Lebensdauer und der guten Lichtausbeute haben einen Austausch anderer Leuchtmittel gegen LED auch für Privathaushalte attraktiver gemacht. Während für den globalen LED-Markt ein Wachstum von rund 68 % erwartet wird, liegen die erwarteten Wachstumsraten für 2014 in Nordamerika bei plus 72 % und in China bei plus 86 %.

Endogene Indikatoren

Kundenzufriedenheit ist ein bedeutender Erfolgsfaktor in der Halbleiterbranche. Aufgrund der außerordentlichen Leistungen der SÜSS MicroTec-Mitarbeiter konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2013 von zwei namhaften asiatischen Packaging-Häusern, SPIL und Amkor, eine Auszeichnung für unsere herausragenden Leistungen als Zulieferer bekommen.

Produkt- und Prozessinnovationen sowie die Erschließung neuer Marktsegmente sind ein weiterer Erfolgsfaktor für das Unternehmen. Produktseitig konnten wir im Geschäftsjahr 2013 verschiedene sehr zukunftsträchtige Aufträge für unser Bonder-Segment verbuchen. Im März 2013 hat ein führender asiatischer IDM einen Folgeauftrag für die neueste Generation von Produktions-Bond-Clustern bei uns platziert. Die Systeme wurden für das temporäre Bonden von 300-mm-Wafern für 3D-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen konfiguriert. Daneben haben wir im Verlauf des Geschäftsjahres 2013 mehrere Aufträge für das ELP300 Excimer Laser-Stepper-System von SUSS MicroTec Photonic Systems erhalten. Zu den Kunden gehören zwei US-amerikanische IDM sowie ein asiatischer OSAT und das Fraunhofer IZM, Berlin. Mit Hilfe der Lasertechnologie können, unter Umgehung der herkömmlichen Lithografie- und Ätzverfahren, Mikrostrukturen direkt auf dem Substrat hergestellt werden. Dies sind zwei wichtige Beispiele, die die Innovationskraft und die technologische Leistungsfähigkeit von SÜSS MicroTec-Maschinen unter Beweis stellen.

Ohne den Einsatz und die Schaffenskraft der Mitarbeiter wären diese Leistungen nicht möglich gewesen. Wir haben uns mit dem Erwerb der Immobilie am Standort Garching neben der Mietersparnis ein hohes Maß an operationaler Flexibilität im Hinblick auf unternehmensspezifische Anforderungen an die Immobilie gesichert und bekennen uns klar zur Produktion in Garching.

Am 6. November 2013 hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass aufgrund einer Neubewertung der Geschäftssituation im Bereich Permanentes Bonding und der weiterhin unbefriedigenden Ertragslage in dieser Produktlinie, die im zweiten Quartal dieses Jahres eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen erweitert werden und die Produktion von Permanenten-Bond-Cluster-Systemen eingestellt wird. Die am Markt erfolgreichen manuellen Permanent-Bonding-Systeme waren von dieser Maßnahme nicht betroffen. Mit Vollzug dieser Maßnahme erwartet das Unternehmen eine deutliche Reduzierung der Verluste im Segment Substrat Bonder.

Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

Zum Jahresende 2013 beträgt der Auftragsbestand rund 85,7 Mio. €. Auf Basis dieses Auftragsbestands und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2014 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das Geschäftsjahr 2014 in der Bandbreite zwischen 135 Mio. € und 145 Mio. € und ein Ergebnis (EBIT) zwischen minus 5 und 0 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2013 wurde mit einem Umsatz in Höhe von 134,5 Mio. € ein Ergebnis (EBIT) von minus 19,4 Mio. € erwirtschaftet. Das EBIT für das Geschäftsjahr 2013 beinhaltet einen Sondereffekt für die Restrukturierung des Segments Substrat Bonder in Höhe von 13,2 Mio. €, das Unternehmen erwirtschaftete somit im Berichtsjahr ein operatives Ergebnis von minus 6,2 Mio. €.

Das Segment Lithografie wird auch 2014 geprägt sein durch die weiterhin schwierige Auftragslage im Bereich der margenstarken 300-mm-Geräte sowie die Ergebnisbelastungen durch SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack Scientific). Gleichwohl wird das Segment Lithografie wieder den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Wir erwarten gegenüber 2013 eine Umsatzsteigerung zwischen 5 und 10 % und einen gegenüber dem Vorjahr verbesserten EBIT im mittleren bis höheren einstelligen Millionenbereich. Im Segment Substrat Bonder erwarten wir einen leichten Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Ergebnisverbesserung, jedoch mit einem weiterhin negativen EBIT im mittleren einstelligen Millionenbereich. Die Umsätze des Segments Fotomasken Equipment werden im kommenden Jahr ein Niveau leicht unter 2013 erreichen bei einem ausgeglichenen EBIT. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

ZUKUNFTSGERICHTETE ANGABEN

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. März 2014

Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp
Finanzvorstand

KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2013

» **075 Konzernabschluss nach IFRS**

076 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
077 Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
078 Konzernbilanz (IFRS)
080 Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)
082 Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)
084 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2013
086 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2012
088 Segmentberichterstattung (IFRS)

» **090 Anhang zum Konzernabschluss**

111 Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
119 Erläuterungen zu den Aktiva
123 Erläuterungen zu den Passiva
125 Aktienoptionspläne der SÜSS MicroTec AG
134 Sonstige Angaben

» **146 Versicherung der gesetzlichen Vertreter**

» **147 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

» **148 Glossar**

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (IFRS)

in Tsd. €	Anhang	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2012 – 31.12.2012
Umsatzerlöse	(3)	134.508	163.827
Umsatzkosten	(4)	-112.724	-106.437
Bruttoergebnis vom Umsatz		**21.784**	**57.390**
Vertriebskosten		-17.493	-20.673
Forschungs- und Entwicklungskosten		-10.186	-9.705
Verwaltungskosten		-14.976	-16.976
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	5.501	6.069
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-4.053	-4.365
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT)			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		-13.400	18.581
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-6.023	-6.841
Operatives Ergebnis (EBIT)		**-19.423**	**11.740**
Finanzerträge		464	940
Finanzaufwendungen		-597	-929
Finanzergebnis	**(7)**	**-133**	**11**
Gewinn / Verlust aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern		**-19.556**	**11.751**
Ertragsteuern	(8)	3.584	-4.131
Gewinn / Verlust aus fortgeführten Aktivitäten		**-15.972**	**7.620**
Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern)		**0**	**1.507**
Gewinn / Verlust		**-15.972**	**9.127**
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		-15.972	9.097
davon nicht beherrschende Anteile		0	30
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	**(9)**		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		-0,84	0,40
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,00	0,08
Ergebnis je Aktie (verwässert)	**(9)**		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		-0,84	0,40
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,00	0,08

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (IFRS)

in Tsd. €	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2012 – 31.12.2012 angepasst[1]
Periodenergebnis	**-15.972**	**9.127**
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		
Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne	-89	-691
Latente Steuern	6	187
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	**-83**	**-504**
Posten die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	-218	9
Fremdwährungsanpassung	-1.657	228
Absicherung künftiger Zahlungsströme	163	-189
Latente Steuern	7	22
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	**-1.705**	**70**
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	**-1.788**	**-434**
Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen	**-17.760**	**8.693**
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	-17.760	8.654
davon nicht beherrschende Anteile	0	39

[1] Seit 1. Januar 2013 wendet die SÜSS MicroTec-Gruppe IAS 19 (revised) an. Diese Änderung der Grundsätze zur Rechnungslegung wurde retrospektiv angewendet; die Vergleichszahlen zum 31.12.2012 wurden angepasst. Die Effekte dieser Anpassungen sind im Anhang in Kapitel D dargestellt.

KONZERNBILANZ (IFRS)

AKTIVA in Tsd. €	Anhang	31.12.2013	31.12.2012 angepasst[1]
Langfristige Vermögenswerte		**46.995**	**37.325**
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	4.517	7.504
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	15.318	15.394
Sachanlagen	(13)	20.906	12.068
Steuererstattungsansprüche	(19)	65	80
Sonstige Vermögenswerte	(14)	522	773
Latente Steueransprüche	(8)	5.667	1.506
Kurzfristige Vermögenswerte		**132.872**	**143.088**
Vorräte	(15)	71.133	82.179
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	11.073	21.758
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	320	547
Wertpapiere	(18)	2.072	11.394
Steuererstattungsansprüche	(19)	721	295
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		45.059	25.192
Sonstige Vermögenswerte	(20)	2.494	1.723
» Bilanzsumme		**179.867**	**180.413**

[1] Seit 1. Januar 2013 wendet die SÜSS MicroTec-Gruppe IAS 19 (revised) an. Diese Änderung der Grundsätze zur Rechnungslegung wurde retrospektiv angewendet; die Vergleichszahlen zum 31 Dezember 2012 wurden angepasst. Die Effekte dieser Anpassungen sind im Anhang in Kapitel D dargestellt.

PASSIVA in Tsd. €	Anhang	31.12.2013	31.12.2012 angepasst[1]
Eigenkapital		**109.432**	**127.193**
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		109.432	127.193
Gezeichnetes Kapital	(21)	19.116	19.116
Rücklagen	(21)	93.971	109.944
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-3.655	-1.867
Langfristige Schulden		**14.613**	**11.039**
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	3.760	4.119
Rückstellungen	(23)	62	296
Finanzschulden	(24)	10.280	3.981
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(25)	496	2.577
Latente Steuerschulden	(8)	15	66
Kurzfristige Schulden		**55.822**	**42.181**
Rückstellungen	(26)	5.939	3.602
Steuerschulden	(29)	651	1.050
Finanzschulden	(24)	1.191	288
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(27)	6.366	6.815
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.563	6.862
Sonstige Verbindlichkeiten	(28)	36.112	23.564
» Bilanzsumme		**179.867**	**180.413**

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)

in Tsd.€	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2012 – 31.12.2012
Gewinn / Verlust (nach Steuern)	-15.972	9.127
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	3.464	4.661
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.558	2.180
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	68	0
Ergebnis aus dem Abgang von Wertpapieren	8	0
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	10.465	2.729
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	1.198	70
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-10	-480
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	1.531	-1.469
Gewinn aus nachträglicher Kaufpreiszahlung für den Bereich Test	0	-1.507
Veränderung des Vorratsvermögens	-145	-4.712
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.187	-3.910
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	-293	1.410
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-359	5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-900	-555
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen	13.575	-6.123
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-2.339	782
Veränderung der Steuerforderungen und Steuerverbindlichkeiten	-4.729	-2.773
» Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	**16.307**	**-565**

in Tsd. €	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2012 – 31.12.2012
Auszahlungen für den Kauf der Immobilie Garching (Grundstück und Gebäude)	-8.939[1]	0
Auszahlungen für Investitionen in sonstige Sachanlagen	-2.679	-3.377
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-588	-801
Auszahlungen für den Erwerb von kurzfristigen zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	0	-3.071
Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	9.097	11.046
Einzahlungen aus nachträglicher Kaufpreiszahlung für den Bereich Test	0	1.507
Auszahlungen für den Erwerb Tamarack Scientific	0	-5.184
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**-3.109**	**120**
Aufnahme von Bankdarlehen	7.500	0
Tilgung von Bankdarlehen	-180	-180
Tilgung des Schuldscheindarlehens	0	-9.000
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	-97	-118
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-21	-843
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an der SMO	0	-1.155
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	0	19
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**7.202**	**-11.277**
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-533	-122
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	**19.867**	**-11.844**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang	**25.192**	**37.036**
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	**45.059**	**25.192**
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	189	816
Zinseinnahmen während der Periode	592	1.052
Steuerzahlungen während der Periode	1.146	6.801
Steuererstattungen während der Periode	41	0

[1] In dem Betrag sind neben dem Kaufpreis von 8.600 Tsd. € Erwerbsnebenkosten in Höhe von 339 Tsd. € enthalten.

KONZERNEIGENKAPITAL-VERÄNDERUNGSRECHNUNG (IFRS)

in Tsd.€	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Gewinn-rücklage	Bilanzgewinn / Verlust	
Stand 01.01.2012	**19.101**	**98.383**	**433**	**2.799**	
Anpassungen [1]	0	0	0	0	
Stand 01.01.2012 (angepasst)	**19.101**	**98.383**	**433**	**2.799**	
Periodenergebnis	0	0	0	9.097	
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	
Gesamtergebnis	0	0	0	9.097	
Ausübung von Aktienoptionen	15	4	0	0	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten	0	0	0	0	
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen SMO	0	-773	0	0	
Stand 31.12.2012	**19.116**	**97.614**	**433**	**11.896**	
Stand 01.01.2013	**19.116**	**97.614**	**433**	**11.896**	
Periodenergebnis	0	0	0	-15.972	
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	0	0	0	0	
Gesamtergebnis	0	0	0	-15.972	
Ausübung von Aktienoptionen	0	0	0	0	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten	0	0	0	0	
Stand 31.12.2013	**19.116**	**97.614**	**433**	**-4.076**	

[1] Seit 1. Januar 2013 wendet die SÜSS MicroTec-Gruppe IAS 19 (revised) an. Diese Änderung der Grundsätze zur Rechnungslegung wurde retrospektiv angewendet; die Vortragswerte wurden angepasst.

	Kumuliertes übriges Eigenkapital						Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
	Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden		Posten die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden						
	Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	Latente Steuern	Fremdwährungsanpassungen	Absicherung künftiger Zahlungsströme	Marktwert-Änderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	Latente Steuern			
	0	**0**	**-987**	**-316**	**239**	**51**	**119.703**	**689**	**120.392**
	-551	140	0	0	0	0	-411	0	-411
	-551	**140**	**-987**	**-316**	**239**	**51**	**119.292**	**689**	**119.981**
	0	0	0	0	0	0	9.097	30	9.127
	-691	187	219	-189	9	22	-443	9	-434
	-691	187	219	-189	9	22	8.654	39	8.693
	0	0	0	0	0	0	19	0	19
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	-773	-728	-1.501
	-1.242	**327**	**-768**	**-505**	**248**	**73**	**127.192**	**0**	**127.192**
	-1.242	**327**	**-768**	**-505**	**248**	**73**	**127.192**	**0**	**127.192**
	0	0	0	0	0	0	-15.972	0	-15.972
	-89	6	-1.657	163	-218	7	-1.788	0	-1.788
	-89	6	-1.657	163	-218	7	-17.760	0	-17.760
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-1.331	**333**	**-2.425**	**-342**	**30**	**80**	**109.432**	**0**	**109.432**

ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS
ANLAGESPIEGEL 2013

DER ANLAGESPIEGEL IST TEIL DES KONZERNANHANGS

	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					
in Tsd. €	01.01.2013	Währungs-differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.111	-83	526	0	825	
2. Entwicklungskosten	29.329	-31	62	0	0	
3. Aktivierte Leasinggegenstände	0	0	0	0	0	
Software	3.168	-45	0	0	2.957	
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	2.922	-82	0	0	0	
	52.530	**-241**	**588**	**0**	**3.782**	
II. Geschäfts- oder Firmenwert	**34.231**	**-74**	**0**	**0**	**4.426**	
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.852	-202	9.221	0	389	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.280	-133	1.499	208	87	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.629	-137	814	0	1.419	
4. Fahrzeuge	373	0	32	0	5	
5. Anlagen im Bau	207	1	52	-208	0	
6. Aktivierte Leasinggegenstände	0	0	0	0	0	
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0	0	0	0	0	
Technische Anlagen und Maschinen	725	-76	0	0	39	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	714	-7	0	0	689	
Fuhrpark	33	-7	0	0	0	
	27.813	**-561**	**11.618**	**0**	**2.628**	
IV. Finanzanlagen						
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0	
	2.263	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte	
	31.12.2013	01.01.2013	Währungs-differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	**31.12.2013**	31.12.2012	**31.12.2013**
	16.729	14.448	-47	854	0	824	14.431	2.663	2.298
	29.360	26.331	-30	2.266	0	0	28.567	2.998	793
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	166	3.094	-45	74	0	2.957	166	74	0
	2.840	1.153	-10	271	0		1.414	1.769	1.426
	49.095	**45.026**	**-132**	**3.465**	**0**	**3.781**	**44.578**	**7.504**	**4.517**
	29.731	**18.837**	**2**	**0**	**0**	**4.426**	**14.413**	**15.394**	**15.318**
	16.482	1.977	-145	524	-1	336	2.019	5.875	14.463
	8.767	3.742	-65	1.064	1	83	4.659	3.538	4.108
	9.887	8.248	-114	936	0	1.410	7.660	2.381	2.227
	400	352	0	8	0	1	359	21	41
	52	0	0	0	0	0	0	207	52
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	610	705	-76	17	0	39	607	20	3
	18	712	-7	2	0	689	18	2	0
	26	9	-2	7	0	0	14	24	12
	36.242	**15.745**	**-409**	**2.558**	**0**	**2.558**	**15.336**	**12.068**	**20.906**
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0
	2.263	**2.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.263**	**0**	**0**

ENTWICKLUNG DES KONZERN-ANLAGEVERMÖGENS
ANLAGESPIEGEL 2012

DER ANLAGESPIEGEL IST TEIL DES KONZERNANHANGS

	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten						
in Tsd.€	01.01.2012	Währungs-differenz	Zugang aus Investitionen	Zugang aus Erwerb Tamarack Scientific	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	
I. Immaterielle Vermögenswerte							
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.568	-22	727	838	0	0	
2. Entwicklungskosten	29.269	-14	74	0	0	0	
3. Aktivierte Leasinggegenstände							
Software	3.197	-29	0	0	0	0	
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	960	0	0	1.962	0	0	
	48.994	**-65**	**801**	**2.800**	**0**	**0**	
II. Geschäfts- oder Firmenwert	**32.436**	**0**	**0**	**1.795**	**0**	**0**	
III. Sachanlagen							
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.542	-111	396	25	0	0	
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.078	17	1.851	1.334	0	0	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.680	-62	936	95	0	20	
4. Fahrzeuge	373	-1	5	0	0	4	
5. Anlagen im Bau	16	0	191	0	0	0	
6. Aktivierte Leasinggegenstände							
Technische Anlagen und Maschinen	771	-46	0	0	0	0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	719	-5	0	0	0	0	
Fuhrpark	38	-5	0	0	0	0	
	23.217	**-213**	**3.379**	**1.454**	**0**	**24**	
IV. Finanzanlagen							
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0	0	
	2.263	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte	
	31.12.2012	01.01.2012	Währungs-differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
	17.111	13.706	-21	763	0	0	14.448	1.862	2.663
	29.329	23.823	-11	2.519	0	0	26.331	5.446	2.998
	3.168	2.236	-29	887	0	0	3.094	961	74
	2.922	661	0	492	0	0	1.153	299	1.769
	52.530	**40.426**	**-61**	**4.661**	**0**	**0**	**45.026**	**8.568**	**7.504**
	34.231	**18.837**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.837**	**13.599**	**15.394**
	7.852	1.592	-77	462	0	0	1.977	5.950	5.875
	7.280	3.004	16	722	0	0	3.742	1.074	3.538
	10.629	7.379	-55	943	0	19	8.248	2.301	2.381
	373	353	-1	4	0	4	352	20	21
	207	0	0	0	0	0	0	16	207
	725	712	-45	38	0	0	705	59	20
	714	714	-5	3	0	0	712	5	2
	33	1	0	8	0	0	9	37	24
	27.813	**13.755**	**-167**	**2.180**	**0**	**23**	**15.745**	**9.462**	**12.068**
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0
	2.263	**2.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.263**	**0**	**0**

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

SEGMENTINFORMATIONEN NACH GESCHÄFTSFELDERN

DIE SEGMENTBERICHTERSTATTUNG IST TEIL DES KONZERNANHANGS

in Tsd.€	Lithografie		Substrat Bonder		Fotomasken Equipment	
	2013	2012	**2013**	2012	**2013**	2012
Außenumsatz	88.305	113.194	22.854	23.149	18.438	22.869
Innenumsatz	0	0	0	0	0	0
Gesamter Umsatz	**88.305**	**113.194**	**22.854**	**23.149**	**18.438**	**22.869**
Segmentergebnis (EBIT)	3.156	23.689	-21.687	-12.009	1.557	1.104
Ergebnis vor Steuern	2.821	23.493	-21.689	-12.009	1.552	1.099
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-) / Erträge (+)	240	1.980	-12.019	-2.335	-781	-190
Segmentvermögen	67.872	76.617	21.764	39.869	12.518	11.306
davon Geschäfts- oder Firmenwert	15.318	15.394	0	0	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
Konzernaktiva						
Segmentschulden	**-23.567**	**-26.757**	**-13.445**	**-4.929**	**-8.880**	**-2.443**
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
Konzernschulden						
Abschreibungen	2.093	2.264	2.098	2.174	299	604
davon planmäßig	2.093	2.264	942	2.174	299	604
davon außerplanmäßig	0	0	1.156	0	0	0
Investitionen	523	5.231	98	199	136	60
Mitarbeiter zum 31.12.	404	419	99	134	100	106

SEGMENTINFORMATIONEN NACH REGIONEN

in Tsd.€	Umsatzerlöse (fortgeführte Aktivitäten)		Investitionen		Vermögen (ohne Goodwill)	
	2013	2012	**2013**	2012	**2013**	2012
Europa	41.258	40.520	11.925	3.856	86.526	98.140
Nordamerika	22.577	30.276	145	4.536	15.464	20.425
Japan	5.196	16.518	55	3	3.055	3.689
Sonstiges Asien	65.477	76.513	81	37	2.652	1.544
Rest der Welt	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-66	-290
Gesamt	**134.508**	**163.827**	**12.206**	**8.432**	**107.631**	**123.508**

	Sonstige		Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten (Test Business)		Konsolidierungseffekte		Summe	
	2013	2012	**2013**	2012	**2013**	2012	**2013**	2012	**2013**	2012
	4.911	4.615	134.508	163.827	0	0	-	-	134.508	163.827
	5.870	8.387	5.870	8.387	0	0	-5.870	-8.387	0	0
	10.781	**13.002**	**140.378**	**172.214**	**0**	**0**	**-5.870**	**-8.387**	**134.508**	**163.827**
	-2.449	-1.044	-19.423	11.740	0	1.507	-	-	-19.423	13.247
	-2.240	-832	-19.556	11.751	0	1.507	-	-	-19.556	13.258
	-237	22	-12.797	-523	0	0	-	-	-12.797	-523
	20.795	11.110	122.949	138.902	0	0	-	-	122.949	138.902
	0	0	15.318	15.394	0	0	-	-	15.318	15.394
									56.918	41.511
									179.867	**180.413**
	-2.287	**-3.376**	**-48.179**	**-37.505**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-48.179**	**-37.505**
									-22.256	-15.715
									-70.435	**-53.220**
	1.533	1.799	6.023	6.841	0	0	-	-	6.023	6.841
	1.533	1.799	4.867	6.841	0	0	-	-	4.867	6.841
	0	0	1.156	0	0	0	-	-	1.156	0
	11.449	2.942	12.206	8.432	0	0	-	-	12.206	8.432
	52	45	655	704	0	0	-	-	655	704

ANHANG ZUM IFRS-KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2013

(1) BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen" oder die „Gesellschaft") mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Corona (seit März 2012) in den USA und Hauterive (Kanton Neuchâtel) in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

A) Grundlage der Darstellung

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC) aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2013 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

B) Erstmalig angewandte Standards und Interpretationen

Das IASB und das International Financial Reporting Interpretations Committee haben die nachfolgenden Standards geändert; die geänderten Standards sind verpflichtend im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 anzuwenden und haben Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Gesellschaft:

IAS 1: „DARSTELLUNG DES ABSCHLUSSES"

Am 16. Juni 2011 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses". Nach dem geänderten Standard ist die IFRS-Erfolgsrechnung formal als ein einziger Abschlussbestandteil darzustellen, dem „Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income". Gleichwohl muss diese formal zusammengefasste Erfolgsrechnung nun verpflichtend in zwei Sektionen unterteilt werden, die zum einen den Gewinn oder Verlust und zum anderen das sonstige Ergebnis ausweisen. Zudem verlangt der geänderte Standard, dass die Bestandteile des sonstigen Ergebnisses separat dargestellt werden, als Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung reklassifiziert werden, und Posten, die niemals reklassifiziert werden, sondern im sonstigen Ergebnis verbleiben.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 6. Juni 2012 wurde die Verordnung Nr. 475 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 1 übernommen wurden.

Der Konzern hat die sich aus dem geänderten IAS 1 ergebenden erforderlichen Angaben in der Gesamtergebnisrechnung sowie in der Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung abgebildet. Die Vergleichszahlen des Vorjahres wurden entsprechend angepasst.

IAS 19: „LEISTUNGEN AN ARBEITNEHMER“

Am 16. Juni 2011 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“. Der geänderte Standard regelt, dass künftig unerwartete Schwankungen der Pensionsverpflichtungen sowie etwaiger Planvermögensbestände unmittelbar im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) erfasst werden müssen. Das bisherige Wahlrecht zwischen sofortiger Erfassung im Gewinn oder Verlust, im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) oder der zeitverzögerten Erfassung nach der sogenannten Korridormethode wurde abgeschafft. Die erwarteten Erträge des Planvermögens sind nach IAS 19 (2011) ausschließlich als typisierende Verzinsung des Planvermögens unter Anwendung des aktuellen Diskontierungszinssatzes der Pensionsverpflichtung zu ermitteln. Eine Ermittlung anhand der subjektiven Erwartungen des Managements über die Wertentwicklung des Anlageportfolios ist nicht mehr zulässig.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 6. Juni 2012 wurde die Verordnung Nr. 475 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 19 übernommen wurden.

Der geänderte IAS 19 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Der Konzern hat die erstmalige Anwendung von IAS 19 (2011) retrospektiv vorgenommen und die Vergleichszahlen entsprechend angepasst. Die Auswirkungen der retrospektiven Anpassung sind unter Punkt D dieses Abschnitts „Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ dargestellt.

IFRS 13: „BEMESSUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 13 „Bemessung des beizulegenden Zeitwerts“. Der Standard ersetzt und erweitert die Angabepflichten hinsichtlich der Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (Fair Value) in anderen IFRS (mit Ausnahme spezieller Regelungen in IAS 17 und IFRS 2). Der Fair Value nach IFRS 13 ist als Abgangspreis (exit price) definiert, das heißt als Preis, der durch den Verkauf eines Vermögenswertes erzielt werden würde bzw. als Preis, der gezahlt werden müsste, um eine Schuld zu übertragen. Hierfür wird ein dreistufiges Hierarchiesystem eingeführt, das hinsichtlich der Abhängigkeit von beobachtbaren Marktpreisen abgestuft ist. In Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften des IFRS 13 werden die neuen Vorschriften zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert prospektiv angewendet und keine Vorjahres-Vergleichsinformationen für neue Angaben zur Verfügung gestellt. Ungeachtet dessen hat die Änderung keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden der SÜSS MicroTec AG.

ANNUAL IMPROVEMENT PROJECT:

Im Rahmen der jährlichen Verbesserungen (Zyklus 2009 – 2011) sind kleinere Änderungen an einzelnen Standards zur Klarstellung und Anpassung zu beachten.

C) Nicht vorzeitig angewandte Standards und Interpretationen

Das IASB hat den nachfolgend dargestellten Standard herausgegeben, dessen Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht (endorsement) erfordert:

IFRS 9: „FINANCIAL INSTRUMENTS“

Im November 2009 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 9 „Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Dieser Standard ist der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“. Im Oktober 2010 veröffentlichte das IASB Vorschriften zur Bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten, die den IFRS 9 „Financial Instruments“ ergänzen und die Phase zur Klassifizierung und Bewertung des IASB-Projekts zur Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ abschließen. Ergänzend zum IFRS 9 (2009) enthält der IFRS 9 (2010) Regelungen für die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten sowie zur Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Am 16. Dezember 2011 hat das IASB unter dem Titel „Verpflichtender Anwendungszeitpunkt und Anhangangaben bei Übergang“ Änderungen an IFRS 9 veröffentlicht.

Gemäß der Methodik von IFRS 9 sind finanzielle Vermögenswerte entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer der beiden Bewertungskategorien hängt davon ab, wie das Unternehmen seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschäftsmodell) und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermögenswerte haben.

Am 19. November 2013 hat das IASB die Veröffentlichung von Ergänzungen an IFRS 9 „Financial Instruments" bekanntgegeben. Die Ergänzungen an IFRS 9 enthalten neue Regelungen zum Hedge Accounting in Form eines neuen allgemeinen Modells für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Die Ergänzung wurde als Kapitel 6 in IFRS 9 eingefügt und ersetzt die entsprechenden Regelungen zum Hedge Accounting in IAS 39. Allerdings besteht bei Anwendung der neuen Hedge Accounting-Regeln in IFRS 9 die Möglichkeit, die Spezialregeln für Portfolio Fair Value Hedges für Zinsrisiken in IAS 39 weiter anzuwenden. Durch die Ergänzungen des IFRS 9 wird zudem die Möglichkeit geschaffen, den ergebnisneutralen Ausweis von bonitätsbedingten Fair Value-Änderungen für Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, vorzeitig umzusetzen, ohne die vollständigen Regelungen von IFRS 9 anzuwenden.

Des Weiteren hat das IASB den bisher in IFRS 9 enthaltenen Zeitpunkt für seine Erstanwendungspflicht ab dem 1. Januar 2015 aufgehoben. Ein neuer Erstanwendungszeitpunkt wird erst festgelegt, wenn der Standard vollständig vorliegt. Erst dann ist ein Endorsement durch die EU vorgesehen.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard verabschiedet und von der EU in dieser Form übernommen wird.

Die nachfolgend dargestellten neuen und geänderten Standards wurden bereits von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, sind jedoch im Geschäftsjahr 2013 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Eine Anwendung der neuen und geänderten Standards ist ab den obligatorischen Erstanwendungszeitpunkten vorgesehen. Von einer vorzeitigen Anwendung der neuen und geänderten Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

IFRS 10: „CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS"

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 10 „Consolidated Financial Statements", mit dem eine einheitliche Definition für den Begriff „Beherrschung" und damit eine einheitliche Grundlage für das Vorliegen einer Mutter-Tochter-Beziehung und die hiermit verbundene Abgrenzung des Konsolidierungskreises geschaffen wird. Der neue Standard ersetzt die bisher relevanten IAS 27 (2008) „Consolidated and Separate Financial Statements" und SIC-12 „Consolidation – Special Purpose Entities".

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 10 übernommen wurde. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission auch die Übergangsleitlinien an IFRS 10 und Änderungen an IFRS 10, die für die Konsolidierung von Tochterunternehmen von Investmentgesellschaften relevant sind, in EU-Recht übernommen (Amtsblatt der Europäischen Union, Verordnung Nr. 313 / 2013 vom 4. April 2013 bzw. Verordnung Nr. 1174 / 2013 vom 20. November 2013).

IFRS 10 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 11 und IFRS 12 sowie mit den 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig. Für EU-IFRS-Anwender sind IFRS 10 und die Übergangsleitlinien an den IFRS 10 erstmals verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IFRS 11: „JOINT ARRANGEMENTS“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 11 „Joint Arrangements”. Der Standard regelt die Bilanzierung von Sachverhalten, in denen ein Unternehmen gemeinschaftliche Führung (joint control) über ein Gemeinschaftsunternehmen (joint venture) oder eine gemeinschaftliche Tätigkeit (joint operation) ausübt. Der neue Standard ersetzt IAS 31 „Interests in Joint Ventures“ und SIC-13 „Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturers“ als die bisher für Fragen der Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen einschlägigen Vorschriften.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 11 übernommen wurde. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission auch die Übergangsleitlinien an IFRS 11 in EU-Recht übernommen (Amtsblatt der Europäischen Union, Verordnung Nr. 313 / 2013 vom 4. April 2013).

IFRS 11 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 12 sowie mit den 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig. Für EU-IFRS-Anwender sind IFRS 11 und die Übergangsleitlinien an den IFRS 11 erstmals verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IFRS 12: „DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 12 „Disclosure of Interests in Other Entities”. Aus dem Standard ergeben sich die Anhangangaben zu Unternehmensverbindungen im Konzernabschluss (neuer IFRS 10) und Joint Arrangements (neuer IFRS 11).

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der der vom IASB veröffentlichte IFRS 12 übernommen wurde. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission auch die Übergangsleitlinien an IFRS 12 und Änderungen an IFRS 12, die für die Konsolidierung von Tochterunternehmen von Investmentgesellschaften relevant sind, in EU-Recht übernommen (Amtsblatt der Europäischen Union, Verordnung Nr. 313 / 2013 vom 4. April 2013 bzw. Verordnung Nr. 1174 / 2013 vom 20. November 2013).

IFRS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 11 sowie mit den 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig. Für EU-IFRS-Anwender sind IFRS 12 und die Übergangsleitlinien an den IFRS 12 erstmals verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 27 (2011): „SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS”

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den geänderten Standard IAS 27 (2011) „Separate Financial Statements“. Im Rahmen der Verabschiedung des IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“ werden die Regelungen für das Kontrollprinzip und die Anforderungen an die Erstellung von Konzernabschlüssen aus dem IAS 27 ausgelagert und abschließend im IFRS 10 behandelt (siehe Ausführungen zu IFRS 10). Im Ergebnis enthält IAS 27 künftig nur die Regelungen zur Bilanzierung von Tochtergesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen in IFRS-Einzelabschlüssen.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 27 (2011) übernommen wurden. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission auch Änderungen an IAS 27, die für die Konsolidierung von Tochterunternehmen von Investmentgesellschaften relevant sind, in EU-Recht übernommen (Amtsblatt der Europäischen Union, Verordnung Nr. 1174 / 2013 vom 20. November 2013).

IAS 27 (2011) ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Für EU-IFRS-Anwender ist IAS 27 (2011) erstmals verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 28 (2011): „INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES"

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den geänderten Standard IAS 28 (2011) „Investments in Associates and Joint Ventures". Im Rahmen der Verabschiedung des IFRS 11 „Joint Arrangements" erfolgten auch Anpassungen des IAS 28, dessen Anwendungsbereich durch den neuen IFRS 11 erheblich erweitert wird.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1254 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen des IAS 28 (2011) übernommen wurden.

IAS 28 (2011) ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen. Für EU-IFRS-Anwender ist IAS 28 (2011) erstmals verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 32: „FINANZINSTRUMENTE: DARSTELLUNG"

Am 16. Dezember 2011 veröffentlichte das IASB eine Ergänzung zum IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung", die die Voraussetzungen für die Saldierung von Finanzinstrumenten klarstellt.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 29. Dezember 2012 wurde die Verordnung Nr. 1256 / 2012 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichte Ergänzung des IAS 32 übernommen wurde.

Die Ergänzung zu IAS 32 ist verpflichtend retrospektiv anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 36: „WERTMINDERUNG VON VERMÖGENSWERTEN"

Am 29. Mai 2013 veröffentlichte das IASB Änderungen zu IAS 36 „Wertminderung von Vermögenswerten" hinsichtlich der Angaben zum erzielbaren Betrag bei nicht-finanziellen Vermögenswerten.

Im Zuge der Entwicklung von IFRS 13 „Bewertung zum beizulegenden Zeitwert" hatte das IASB IAS 36 dahingehend angepasst, dass detaillierte Informationen für alle zahlungsmittelgenerierenden Einheiten zu machen sind, die einen wesentlichen Anteil am Goodwill enthalten, unabhängig davon, ob sie wertgemindert sind. Die nun veröffentlichten Änderungen stellen klar, dass diese Angaben nur für wertgeminderte Vermögenswerte oder wertgeminderte zahlungsmittelgenerierende Einheiten zu machen sind. Zudem beinhalten die Änderungen Konkretisierungen bei den Angaben, wann ein Vermögenswert wertgemindert ist.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 20. Dezember 2013 wurde die Verordnung Nr. 1374 / 2013 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichte Änderung des IAS 36 übernommen wurde.

Die Änderungen zu IAS 36 sind verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig, soweit IFRS 13 bereits angewendet wird.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

IAS 39: „FINANZINSTRUMENTE: ANSATZ UND BEWERTUNG“

Am 27. Juni 2013 veröffentlichte das IASB eine Änderung an IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“, die Novationen von Derivaten zum Inhalt hat.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 20. Dezember 2013 wurde die Verordnung Nr. 1375 / 2013 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichte Änderung des IAS 39 übernommen wurde.

Die Änderung an IAS 39 ist verpflichtend anzuwenden für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

D) Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des True and Fair Views sowie der Fair Presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – mit Ausnahme der im Folgenden beschriebenen Änderung – unverändert gegenüber Vorjahr angewendet.

Die überarbeitete Fassung des IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“ ist erstmals für Geschäftsjahre, die ab dem 1. Januar 2013 beginnen, verpflichtend anzuwenden. Aus der erstmaligen Anwendung des IAS 19 (2011) ergeben sich folgende Änderungen:

- Wegfall der Korridormethode: Durch den Wegfall des bisherigen Wahlrechts bei der Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste sind diese sofort in voller Höhe im Eigenkapital zu erfassen.
- Berechnung des Vorsorgeaufwands: Der Nettozinsaufwand aus den leistungsorientierten Pensionsplänen wird auf Basis einer Nettoverbindlichkeit (dem Saldo aus der Pensionsverpflichtung und dem beizulegenden Wert des Planvermögens) ermittelt.
- Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand: Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.
- Risikoaufteilung: Die neue Regelung zur Risikoaufteilung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber wirkt sich sowohl auf die Vorsorgeverpflichtung als auch auf die Verteilung des Dienstzeitaufwands aus.

Der Konzern hat die erstmalige Anwendung von IAS 19 (2011) retrospektiv vorgenommen und die Vergleichszahlen entsprechend angepasst. Hieraus resultieren die nachfolgend dargestellten Auswirkungen auf die Gesamtergebnisrechnung 2012 sowie auf die Konzernbilanz 2012. Auf eine Anpassung der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 2012 wurde aufgrund der geringen Effekte verzichtet. Insoweit ergaben sich auch keine Auswirkungen auf das unverwässerte bzw. verwässerte Ergebnis je Aktie.

Geänderte Darstellung in der Gesamtergebnisrechnung:

in Tsd.€	01.01.–31.12.2012 ursprünglich ausgewiesen	Anpassung nach IAS 8	01.01.–31.12.2012 angepasst
Periodenergebnis	**9.127**	**0**	**9.127**
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden			
Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne	0	-691	-691
Latente Steuern	0	187	187
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	0	-504	-504
Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden			
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	70	0	70
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	70	-504	-434
Summe der in der Periode erfassten gesamten Erträge und Aufwendungen	**9.197**	**-504**	**8.693**
davon SÜSS MicroTec Aktionäre	9.158	-504	8.654
davon nicht beherrschende Anteile	39	0	39

Geänderte Darstellung in der Konzernbilanz:

in Tsd.€	01.01.2012 ursprünglich ausgewiesen	Anpassung nach IAS 8	01.01.2012 angepasst
Summe Aktiva	187.746	140	187.886
davon: latente Steueransprüche	5.383	140	5.523
Summe Langfristige Schulden	10.500	551	11.051
davon: Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.872	551	3.423
Summe Eigenkapital	120.392	-411	119.981
davon: kumuliertes übriges Eigenkapital	-1.013	-411	-1.424

		Anpassung nach IAS 8		
in Tsd.€	31.12.2012 ursprünglich ausgewiesen	auf 01.01.2012	auf 31.12.2012	31.12.2012 angepasst
Summe Aktiva	180.086	140	187	180.413
davon: latente Steueransprüche	1.179	140	187	1.506
Summe Langfristige Schulden	9.797	551	691	11.039
davon: Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.877	551	691	4.119
Summe Eigenkapital	128.108	-411	-504	127.193
davon: kumuliertes übriges Eigenkapital	-952	-411	-504	-1.867

VERGLEICHENDE DARSTELLUNG ZWISCHEN IAS 19 (2011) UND IAS 19 (2008):

Wäre 2013 weiterhin der bisherige IAS 19 in der Fassung von 2008 zur Anwendung gekommen, hätte sich – im Vergleich zu IAS 19 (2011) – folgender Deckungsstatus ergeben:

in Tsd. €	2013 IAS 19 rev.	2013 IAS 19 alt	2012 IAS 19 rev.	2012 IAS 19 alt
Anwartschaftsbarwert	5.935	6.026	6.086	6.201
Nicht realisierte versicherungsmath. Gewinne / Verluste	0	-815	0	-1.358
Planvermögen	2.175	2.175	1.967	1.966
Deckungsstatus	3.760	3.036	4.119	2.877

Das sonstige Ergebnis und das kumulierte übrige Eigenkapital für das Geschäftsjahr 2013 ist durch die Umstellung auf IAS 19 (2011) wie folgt beeinflusst:

in Tsd. €	2013 unter Anwendung von IAS 19 rev.	Effekt aus Umstellung auf IAS 19 rev.	2013 unter Anwendung von IAS 19 alt
Periodenergebnis	**-15.972**	**603**	**-16.575**
Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden	-83	-83	0
Summe der in der Periode erfassten gesamten Erträge und Aufwendungen	-1.705	0	-1.705
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	**-1.788**	**-83**	**-1.705**
Summe der in der Periode erfassten gesamten Erträge und Aufwendungen	**-17.760**	**520**	**-18.280**

in Tsd. €	2013
Eigenkapital des Konzerns zum 31.12.2013	109.432
Summe der Effekte aufgrund der Umstellung auf IAS 19 rev.	-520
Veränderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital in 2012, die unter Anwendung des neuen IAS 19 (2011) erfasst wurden	504
Anpassungsbetrag, der zum 31.12.2011 / 01.01.2012 aufgrund der Umstellung auf IAS 19 (2011) berücksichtigt wurde	411
Eigenkapital des Konzerns zum 31.12.2013, das sich bei Anwendung des alten IAS 19 (2008) ergeben hätte	**109.827**

Hätte der Konzern 2013 die Pensionsverpflichtungen weiterhin nach IAS 19 in der Fassung von 2008 passiviert, hätte sich für 2013 ein um 603 Tsd. € niedrigeres Periodenergebnis ergeben. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2013 wäre bei Anwendung von IAS 19 (2008) – unter Berücksichtigung der Effekte in den Jahren 2012 und 2013 – insgesamt um rund 395 Tsd. € höher gewesen und hätte 109.827 Tsd. € betragen.

GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (triggering events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (cash generating units), die im SÜSS-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf der Basis des Nutzungswertes errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

SONSTIGE IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich ist und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt sind. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS-Gruppe nicht vor.

SACHANLAGEN

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

WERTMINDERUNGEN AUF IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE UND SACHANLAGEN

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

VORRÄTE

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

FINANZINSTRUMENTE

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorie „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option” werden nicht genutzt.

FORDERUNGEN UND SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

WERTPAPIERE

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert, da sie nicht zu Spekulationszwecken gehalten werden. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

ZAHLUNGSMITTEL UND ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

AKTIENBASIERTE VERGÜTUNGEN

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black Scholes-Modells.

PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert.

Beitragsorientierte Pläne (defined contribution plans) führen in der Regel nicht zu einer Rückstellungsbildung, da sich die Verpflichtung des Unternehmens auf die Zahlung von Beiträgen an die Versorgungsträger / Fonds beschränken. Die Prämienzahlungen an die Versorgungsträger / Fonds werden in der Periode ihres Anfalls als Aufwand erfasst.

Bei leistungsorientierten Plänen (defined benefit plans) besteht die Verpflichtung des Unternehmens in der Gewährung der zugesagten Leistungen an aktive und frühere Arbeitnehmer. Leistungsorientierte Pläne führen in der Regel zur Bildung von Pensionsrückstellungen.

Die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung abzüglich bewertetem Planvermögen) wird mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens (projected unit credit method) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Planvermögen). Die Effekte aus der Neubewertung der Nettoschuld (versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, Erträge aus dem Planvermögen sowie die Veränderungen in der Auswirkung der Vermögensobergrenze) werden in voller Höhe im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.

Aus der erstmaligen Anwendung des IAS 19 (2011) ergeben sich folgende Änderungen:

- Wegfall der Korridormethode: Durch den Wegfall des bisherigen Wahlrechts bei der Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste sind diese sofort in voller Höhe im Eigenkapital zu erfassen.
- Berechnung des Vorsorgeaufwands: Der Nettozinsaufwand aus den leistungsorientierten Pensionsplänen wird auf Basis einer Nettoverbindlichkeit (dem Saldo aus der Pensionsverpflichtung und dem beizulegenden Wert des Planvermögens) ermittelt.
- Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand: Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuverrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.
- Risikoaufteilung: Die neue Regelung zur Risikoaufteilung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgeber wirkt sich sowohl auf die Vorsorgeverpflichtung als auch auf die Verteilung des Dienstzeitaufwands aus.

Der Konzern hat die erstmalige Anwendung von IAS 19 (2011) retrospektiv vorgenommen und die Vergleichszahlen 2012 entsprechend angepasst. Der Effekt aus der retrospektiven Anpassung ist in Punkt 2 D dargestellt.

RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

FINANZSCHULDEN

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

VERBINDLICHKEITEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

LEASING

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf Basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt, selbst wenn dieses Recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

Bei Leasingvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden, gilt in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften von IFRIC 4 der 1. Januar 2005 als Zeitpunkt des Abschlusses der Leasingvereinbarung.

Finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur Aktivierung des Leasinggegenstands zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in Finanzierungsaufwendungen und den Tilgungsanteil der Restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. Finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

Leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands abgeschrieben. Ist der Eigentumsübergang auf den Konzern am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig abgeschrieben. Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand für Operating-Leasingverhältnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

NICHT FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

UMSATZREALISIERUNG

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart ist, der Umsatz erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

UMSATZKOSTEN

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN UND ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

LATENTE STEUERN

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

ERGEBNIS PRO AKTIE (EPS – EARNINGS PER SHARE)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

CASHFLOW HEDGES

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

BILANZIERUNG VON ZUSCHÜSSEN

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden von diesen abgesetzt.

TRANSAKTIONEN IN FREMDWÄHRUNG

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

E) Verwendung von Schätzungen

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunkturentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2013 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.815 Tsd. € (Vorjahr: 617 Tsd. €).

WERTMINDERUNGEN

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert abzüglich der Verkaufskosten und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich dabei für das Segment Lithografie, dem der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 9,7 % (Vorjahr: 13,0 %). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 10,0 % (Vorjahr: 10,0 %) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrundeliegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

SONSTIGE FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sie werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Abhängig vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen sind Schätzungen notwendig, um den wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag zu bestimmen.

PURCHASE PRICE ALLOCATION

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

F) Konsolidierung

KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

UMRECHNUNG VON JAHRESABSCHLÜSSEN IN FREMDER WÄHRUNG

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2013		2012	
	Bilanz	G&V	Bilanz	G&V
1 EUR vs 1 USD	1,377	1,329	1,319	1,293
1 EUR vs 1 JPY	144,510	128,878	113,620	103,253
1 EUR vs 1 GBP	0,833	0,848	0,816	0,813
1 EUR vs 1 CHF	1,227	1,227	1,207	1,205
1 EUR vs 1 TWD	41,337	39,609	38,491	38,262
1 EUR vs 1 SGD	1,739	1,663	1,611	1,613
1 EUR vs 1 CNY	8,418	8,250	8,349	8,161
1 EUR vs 1 KRW	1.463,890	1.456,471	1.411,150	1.456,037
1 EUR vs 1 THB	45,238	41,018	40,333	40,300

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

ANGABEN ZUM KONSOLIDIERUNGSKREIS

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 ergaben sich folgende Veränderungen im Konsolidierungskreis:

Die SUSS MicroTec Precision Photomask, Inc., Sunnyvale (USA) – eine 100-%-Tochtergesellschaft der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (USA) – betrieb bis Oktober 2011 das Maskengeschäft der SÜSS MicroTec-Gruppe. Nach Verkauf des Maskengeschäfts im Oktober 2011 ruhte der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft. Die SUSS MicroTec Precision Photomask, Inc. wurde im November 2013 liquidiert und zum 31.12.2013 entkonsolidiert.

Die Tamarack Scientific Ltd., London (Großbritannien) – eine 100-%-Tochtergesellschaft der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (USA) (vormals: Tamarack Scientific Co., Inc.) – fungierte bis zum Erwerb von Tamarack Scientific durch SÜSS MicroTec als Vertriebsgesellschaft für die Tamarack-Produkte in Großbritannien. Seit der Zugehörigkeit zum SÜSS MicroTec-Konzern werden sämtliche Vertriebsaktivitäten für SÜSS MicroTec-Produkte in Großbritannien von der SUSS MicroTec Ltd., Coventry (Großbritannien) wahrgenommen. Die Tamarack Scientific Ltd. wurde daher im Dezember 2013 liquidiert und zum 31.12.2013 entkonsolidiert.

Weitere Veränderungen im Konsolidierungskreis haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht ergeben.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

Gesellschaft / Sitz	Währung	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching [1]	EUR	19.115.538,00	Holding	106.598.213,25	-3.161.739,79	voll
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching [2]	EUR	2.000.100,00	100 %	22.502.623,91	-18.223.852,34	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100 %	356.400,99	344.129,30	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100 %	15.885,13	491,61	voll
SUSS MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100 %	1.151.154,00	15.766,00	voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100 %	-516.905.890,00	-213.511.226,00	voll
SUSS MicroTec S.a.r.l., Pierre Bénite	EUR	114.750,00	100 %	965.975,83	86.184,00	voll
SUSS MicroOptics S.A., Hauterive	CHF	500.000,00	100 %	8.115.336,00	274.092,00	voll
SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale	USD	4.197.000,00	100 %	20.162.069,92	-739.750,38	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	TWD	5.000.000,00	100 %	216.217.018,00	85.005.665,00	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100 %	32.177.591,25	5.679.384,02	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose [3]	USD	1.190.442,00	53,1 %	-39.579,00	-1.968,00	at cost
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim [2]	EUR	25.564,59	100 %	990.432,01	784.559,95	voll
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	618.276,81	-464.113,88	voll
SUSS MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100 %	2.084.513.221,00	1.121.855.551,00	voll
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona	USD	10.400,00	100 %	-3.047.422,43	-6.783.485,22	voll
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand [4]	EUR	52.000,00	10 %	716.815,00	-214.883,00	at cost

[1] Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec Reman GmbH

[2] Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

[3] aufgrund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

[4] Zahlen laut Jahresabschluss 31. Dezember 2012; der Fair Value der Beteiligung wurde wegen Unwesentlichkeit nicht ermittelt.

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, und die SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

UNTERNEHMENSERWERBE

Im Vorjahr: Erwerb von 100 % an Tamarack Scientific Co., Inc.

Mit Kaufvertrag vom 29. März 2012 hat der SÜSS MicroTec-Konzern 100 % der Anteile an der Tamarack Scientific Co., Inc. (Corona / USA) (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) erworben.

SUSS MicroTec Photonic Systems entwickelt, produziert und vertreibt UV-Projektionsbelichtungsgeräte sowie laserbasierte Mikrostrukturierungssysteme. Schwerpunktmärkte sind Advanced Packaging, 3D-Integration, MEMS und LED. Die Geräte kommen sowohl in der industriellen Produktion als auch in der Forschung und Entwicklung zum Einsatz. Mit der Akquisition der Gesellschaft verfolgte SÜSS MicroTec eine Konsolidierungsstrategie im Halbleiter-Backend und ergänzte die vorhandene Lithografie-Kompetenz um die Projektionsbelichtung.

Der Erwerb der Anteile und Vermögenswerte bzw. Schulden wurde im Vorjahr im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG nach den International Financial Reporting Standards als Unternehmenszusammenschluss gemäß IFRS 3 (rev. 2008) abgebildet. In diesem Zusammenhang sind die erworbenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden (mit einzelnen Ausnahmen) zu ihrem beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt anzusetzen (IFRS 3.18). Hierbei sind – nach den Vorschriften des IFRS 3 in Verbindung mit IAS 38 – nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

Vor diesem Hintergrund wurde für die erworbenen Vermögenswerte und Schulden eine Purchase Price Allocation durchgeführt. Die erworbenen Vermögenswerte und Schulden wurden zum Erstkonsolidierungszeitpunkt, dem 31. März 2012, wie folgt angesetzt:

in Tsd. USD	Buchwert nach IFRS per 31.03.2012	Bei Erwerb angesetzt (gemäß PPA)
Immaterielle Vermögenswerte	1.146	3.733
Sachanlagen	1.728	1.938
Sonstige langfristige Vermögenswerte	300	300
Kurzfristige Vermögenswerte	12.820	14.881
Summe Vermögenswerte	**15.994**	**20.852**
Langfristige Schulden	-	-
Kurzfristige Schulden	9.181	9.181
Summe Schulden	**9.181**	**9.181**
Nettovermögen	6.813	11.671
Anschaffungskosten		9.340
Rückstellungen für Earn-Out		4.697
Geschäfts- oder Firmenwert		2.366

Zum Erstkonsolidierungszeitpunkt wurden bisher nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von rund 2,6 Mio. USD aktiviert, die zum größten Teil die erworbene Technologie betreffen. Die Bewertung der Technologie basierte auf einer Planung für die Jahre 2012 bis 2020 und den daraus resultierenden Zahlungsströmen. Darüber hinaus wurden stille Reserven in den Sachanlagen in Höhe von 0,2 Mio. USD aufgedeckt. In den kurzfristigen Vermögenswerten wurden stille Reserven in Höhe von rund 2,0 Mio. USD angesetzt, die Maschinen und unfertige Erzeugnisse des Vorratsvermögens betreffen. Die kurzfristigen Vermögenswerte beinhalteten außerdem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,4 Mio. USD. Stille Reserven waren hier nicht enthalten.

Neben dem fixen Kaufpreis von rund 9,34 Mio. USD war eine variable Kaufpreiskomponente vereinbart, die von der Umsatz- und Margenentwicklung der kommenden drei Jahre abhängt. Die Höhe der voraussichtlichen Earn-Out-Verpflichtung wurde anhand der vorliegenden Unternehmensplanungen auf rund 6,8 Mio. USD geschätzt. Davon entfielen rund 5,6 Mio. USD auf die beiden bisherigen Anteilseigner der Tamarack Scientific Co., Inc., die ihre Anteile an SÜSS MicroTec verkauft haben. Die übrigen 1,2 Mio. USD entfielen auf fünf Mitarbeiter, denen in der Vergangenheit Aktienoptionen gewährt wurden und die deshalb im Kaufvertrag ebenfalls als Anteilseigner behandelt wurden.

Der Earn-Out, der auf die beiden bisherigen Anteilseigner entfiel, wurde in der Purchase Price Allocation als Kaufpreis behandelt und im Rahmen der Erstkonsolidierung in Höhe des Barwerts von rund 4,7 Mio. USD passiviert. Der variable Kaufpreis, der auf die fünf Mitarbeiter entfiel, wurde als Vergütung für Arbeitsleistung angesehen und wird über einen Zeitraum von 24 Monaten ratierlich zugeführt. 2012 wurden für den variablen Kaufpreis, der auf die fünf Mitarbeiter entfällt, rund 0,4 Mio. USD aufwandswirksam passiviert.

Zum 31. Dezember 2012 wurde eine Neueinschätzung der Earn-Out-Verpflichtung vorgenommen und die Beträge entsprechend angepasst. Anhand der vorliegenden Unternehmensplanungen für Tamarack Scientific wurde die Höhe der gesamten Earn-Out-Verpflichtung zum 31. Dezember 2012 auf rund 3,43 Mio. USD (nominal) geschätzt. Von den bisher für den variablen Kaufpreis gebildeten Rückstellungen konnten somit im Vorjahr rund 2,7 Mio. USD ertragswirksam aufgelöst werden.

In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres waren die Erträge und Aufwendungen der Tamarack Scientific Co., Inc. der Monate April bis Dezember 2012 eingeflossen. In diesem Zeitraum trug Tamarack Scientific mit Umsätzen von 1,9 Mio. € sowie einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von -2,9 Mio. € zum Konzernumsatz und -ergebnis bei. Darüber hinaus resultierte aus der Abwertung der durch die Purchase Price Allocation aufgedeckten stillen Reserven, der Zuführung zur Earn-Out-Verbindlichkeit für die Mitarbeiter und der Neubeurteilung der Earn-Out-Verbindlichkeiten zum Jahresende ein zusätzlicher positiver Ergebnisbeitrag von 1,2 Mio. €. Hätte der SÜSS MicroTec-Konzern die Tamarack Scientific bereits zum Beginn der Berichtsperiode 2012 erworben, hätten sich Konzernumsätze 2012 von 167,0 Mio. € und ein Konzernergebnis 2012 nach Steuern von 6,1 Mio. € (fortgeführte Aktivitäten) ergeben.

Zum 31. Dezember 2013 wurde erneut eine Neueinschätzung der Earn-out-Verpflichtung vorgenommen und die Beträge wurden entsprechend angepasst. Aufgrund der vorliegenden Unternehmensplanung der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (vormals: Tamarack Scientific Co., Inc.) wurde die Höhe der gesamten Earn-Out-Verpflichtung zum 31. Dezember 2013 auf rund 0,52 Mio. USD (nominal) geschätzt. Von den bisher für den variablen Kaufpreis gebildeten Rückstellungen konnten somit zum 31.12.2013 rund 2,84 Mio. USD ertragswirksam aufgelöst werden. Zudem wurden die im Vorjahr im Rahmen der Purchase Price Allocation aufgedeckten stillen Reserven auf Maschinen und unfertige Erzeugnisse des Vorratsvermögens, die bisher einer planmäßigen Abschreibung unterlagen, komplett abgeschrieben. Dadurch ergaben sich im Geschäftsjahr 2013 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 1,21 Mio. USD.

Im Vorjahr: Aufstockung der Beteiligung SUSS MicroOptics S.A., Hauterive (Schweiz) auf 100 %
Mit Kaufvertrag vom 14. Mai 2012 hat die SÜSS MicroTec AG 15 % der Anteile der SUSS MicroOptics S.A., Hauterive (Schweiz) erworben und damit ihre Beteiligung von 85 % auf 100 % aufgestockt. Der fixe Kaufpreis betrug 1,35 Mio. CHF und wurde im Mai 2012 ausbezahlt. Neben dem fixen Kaufpreis wurde mit den Verkäufern ein variabler Kaufpreis vereinbart, der in den Jahren 2013 bis 2015 zur Auszahlung kommen wird. Der variable Kaufpreis belief sich auf rund 0,45 Mio. CHF (nominal); hierfür wurden entsprechende Rückstellungen passiviert.

Im Vorjahres-Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG wurde der Kauf der Anteile gemäß IAS 27 als Eigenkapitaltransaktion abgebildet. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem gesamten Kaufpreis von 1,8 Mio. CHF und dem niedrigeren Buchwert der erworbenen Minderheiten betrug im Vorjahr rund 0,8 Mio. € und wurde mit der Konzernkapitalrücklage verrechnet.

Am 31. Dezember 2013 war die erste Tranche des variablen Kaufpreises zur Auszahlung fällig. Der Gesamtbetrag von 0,15 Mio. CHF kam im Januar 2014 zur Auszahlung.

G) Nicht fortgeführte Aktivitäten

2010 hat sich die SÜSS MicroTec AG von ihrem Geschäft mit Test Systemen getrennt und das Segment Test Systeme zum 28. Januar 2010 veräußert. Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren die Anteile an der SUSS MicroTec Test Systems GmbH. Zudem wurden einzelne Vermögenswerte von Auslandstöchtern veräußert, die ebenfalls dem Bereich Test Systeme zugeordnet waren.

Der Kaufpreis für das Segment Test Systeme bestand aus einem festen und einem treuhänderisch verwalteten Anteil. Die fixe Komponente betrug 4,5 Mio. €, wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Käuferin (Cascade MicroTech Inc.) bezahlt wurden. Ein weiterer Betrag von 2,5 Mio. € wurde auf ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten Bedingungen abhängig war, die nach der Transaktion von dem Verkäufer erfüllt werden mussten und zu einer entsprechenden Kaufpreisanpassung führten. Bis zum 31. Dezember 2011 sind der SÜSS MicroTec AG aus diesem Treuhandkonto 0,8 Mio. € zugeflossen. Darüber hinaus hat die SÜSS MicroTec AG aus Kaufpreisanpassungen 0,8 Mio. € erhalten. Im Februar 2012 wurden die auf den Treuhandkonten verbliebenen Beträge in Höhe von 1,5 Mio. € an die SÜSS MicroTec AG ausbezahlt. Daraus resultierte 2012 ein positives Ergebnis aus nicht fortgeführten Aktivitäten in Höhe von 1.507 Tsd. €.

Im Januar 2010 wurde die SUSS MicroTec Test Systems GmbH entkonsolidiert.

Das Ergebnis des Segments Test Systeme, das in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wird, stellt sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2013	2012
Umsatzerlöse	0	0
Kosten und Aufwendungen	0	0
Erträge aus nachträglicher Kaufpreiszahlung	0	1.507
›› Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern	**0**	**1.507**
Ertragsteuern	0	0
›› Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern	**0**	**1.507**

ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erläuterungen zur Konzerngewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(3) UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Maschinen	102.107	133.083
Ersatzteile und Upgrades	18.332	16.669
Serviceleistungen	9.481	9.751
Sonstige	4.588	4.324
» Umsatzerlöse	**134.508**	**163.827**

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Bereich Mikrooptik.

(4) UMSATZKOSTEN

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 1.110 Tsd. € (Vorjahr: 2.519 Tsd. €) und außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 1.156 Tsd. € enthalten. Die planmäßigen Abschreibungen betreffen mit 552 Tsd. € (Vorjahr: 769 Tsd. €) Entwicklungsprojekte im Segment Lithografie und mit 558 Tsd. € (Vorjahr: 1.750 Tsd. €) das Segment Substrat Bonder. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden vorgenommen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Produktlinie Permanent-Bond-Cluster aktiviert wurden. Der zum 31. Dezember 2013 verbleibende Restbuchwert der aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 793 Tsd. € betrifft ausschließlich das Segment Lithografie.

In den Umsatzkosten sind darüber hinaus planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photomask Equipment in Höhe von 43 Tsd. € (Vorjahr: 256 Tsd. €) sowie auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) in Höhe von 236 Tsd. € (Vorjahr: 182 Tsd. €) enthalten. Die Technologie der SUSS MicroTec Photomask Equipment ist damit zum 31. Dezember 2013 komplett (planmäßig) abgeschrieben.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von 17.194 Tsd. € (Vorjahr: 5.170 Tsd. €) eingeflossen. Dabei entfallen 4.161 Tsd. € (Vorjahr: 1.752 Tsd. €) auf Bestände des Segments Lithografie und 12.729 Tsd. € (Vorjahr: 3.031 Tsd. €) auf Bestände des Segments Substrat Bonder. In den Abwertungen des Segments Lithografie sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.904 Tsd. € auf insgesamt vier Demonstrationsmaschinen der SUSS MicroTec Photonic Systems enthalten, die im Rahmen der Purchase Price Allocation im Vorjahr neu bewertet wurden. Die Wertminderungen des Segments Substrat Bonder enthalten Sonderabwertungen in Höhe von 9.337 Tsd. €, die im Zusammenhang mit der Restrukturierung der Permanent-Bond-Cluster-Systeme gebildet wurden. Die Bestände des Segments Fotomasken Equipment wurden um 251 Tsd. € (Vorjahr: 384 Tsd. €) abgewertet. Auf die Bestände des Segments Sonstiges entfallen Abwertungen in Höhe von 52 Tsd. € (Vorjahr: 3 Tsd. €).

(5) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Fremdwährungsgewinne	2.127	2.135
Kommissionen	430	391
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	253	14
Kfz-Sachbezüge	274	264
Sonstige Zuschüsse	130	192
Rückstellungsauflösungen	10	480
Auflösung Rückbauverpflichtung Reinraum Garching	75	0
Reduzierung Earn-Out-Verpflichtung SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific)	2.136	2.107
Erstattungen von Versicherungen	40	145
Sonstiges	26	341
» Sonstige betriebliche Erträge	**5.501**	**6.069**

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in USD und JPY) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem realisierte das Unternehmen Kursgewinne aus der Devisenkurssicherung.

Die Kommissionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt.

Sonstige Zuschüsse in Höhe von rund 50 Tsd. € wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt. Weitere Zuschüsse von rund 80 Tsd. € betrafen Zuschüsse des Kantons Neuchâtel, die der SMO gewährt wurden. Die Zuschüsse des Vorjahres wurden ebenfalls von der SMO erzielt.

Die Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) resultieren aus einer Teil-Auflösung der Earn-Out-Verpflichtung, die im Rahmen der Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. passiviert wurde (1.817 Tsd. €). Darüber hinaus wurde auch ein Teil der Earn-Out-Verbindlichkeit für die Mitarbeiter aufgelöst (319 Tsd. €), die in den Jahren 2012 und 2013 aufwandswirksam passiviert wurde. Auch im Vorjahr hat der Konzern bereits einen Ertrag aus der Auflösung eines Teilbetrags dieser Earn-Out-Rückstellung realisiert. Der Sachverhalt ist unter Punkt F „Konsolidierung“ näher erläutert.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren aus der SÜSS MicroTec AG. Im Vorjahr resultierten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Wesentlichen aus der SUSS MicroTec Lithography GmbH (163 Tsd. €) sowie aus der Tamarack Scientific Co., Inc. (296 Tsd. €).

(6) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Fremdwährungsverluste	1.485	3.423
Sonstige Steuern	391	395
Verluste aus Anlagenabgang	68	0
Vertragsstrafen	45	19
Lizenzgebühren	0	12
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	1.451	104
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Niederlassung Japan	295	0
Aufwendungen für Earn-Out SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific)	201	309
Sonstiges	117	103
›› Sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.053**	**4.365**

Die Fremdwährungsverluste entstanden – wie im Vorjahr – im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in USD aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung. Darüber hinaus sind dem Konzern Kursverluste aus Devisenkurssicherungsgeschäften entstanden. Im Vorjahr resultierten 574 Tsd. € der Fremdwährungsverluste aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die SÜSS MicroTec AG gegenüber der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale. Dieser Betrag wurde bis zur Rückführung der Kredite im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst.

Die Lizenzgebühren des Vorjahres betrafen die SUSS MicroTec Precision Photomask, Inc.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Tamarack Scientific Co., Inc. (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) wurden einzelnen Mitarbeitern von Tamarack Scientific erfolgsabhängige Vergütungen gewährt, die innerhalb der nächsten drei Jahre zur Auszahlung kommen sollen. Diese Earn-Out-Verbindlichkeiten gegenüber den Mitarbeitern wurden – im Gegensatz zu den Earn-Out-Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern – aufwandswirksam passiviert. Im Geschäftsjahr 2012 wurden von insgesamt 24 Monatsraten acht Monatsraten als Aufwand erfasst. Im Geschäftsjahr 2013 wurden weitere zwölf Monatsraten aufwandswirksam erfasst.

Von den Aufwendungen für die Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen betreffen 490 Tsd. € Forderungen, die im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Bereichs Permanent-Bond-Cluster stehen. Weitere 645 Tsd. € resultieren aus Wertberichtigungen auf eine Kundenforderung der SUSS MicroTec Photomask Equipment. Die übrigen Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden im Wesentlichen von der SUSS MicroTec Lithography gebildet.

(7) FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzerträge in Höhe von 464 Tsd. € (Vorjahr: 940 Tsd. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen für Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Bankverbindlichkeiten	198	745
Zinsswaps	0	-161
Bezahlte Stückzinsen	0	55
Zinsen für Finanzierungsleasing	1	20
Avalprovisionen	37	48
Aufzinsung von Rückstellungen	350	186
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	11	36
» Finanzaufwendungen	**597**	**929**

Die Höhe der gesamten Finanzaufwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten betrafen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels (Darlehensstand zum 31. Dezember 2013: 3.960 Tsd. €). Für das im Dezember 2013 ausbezahlte Bankdarlehen für die Grundstücksfinanzierung Garching (Darlehensstand zum 31. Dezember 2013: 7.500 Tsd. €) fielen 11 Tsd. € Zinsaufwand an. Im Vorjahr waren in den Zinsen für Bankverbindlichkeiten außerdem die Zinsen für das im Dezember 2012 getilgte Schuldscheindarlehen enthalten. Für die Zinsswaps, die im Zusammenhang mit dem Schuldscheindarlehen stehen, ergab sich im Vorjahr ein positiver Effekt und damit ein Ertrag in Höhe von insgesamt 161 Tsd. €. Die Zinsaufwendungen für die Aufzinsung von langfristigen Verbindlichkeiten resultieren aus der Barwertermittlung der Earn-Out-Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. sowie in geringem Umfang aus der Barwertermittlung der bedingten Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der verbleibenden Anteile an der SUSS MicroOptics.

(8) ERTRAGSTEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2013	2012
Laufender Steueraufwand	587	2.595
Latenter Steuerertrag (-) / -aufwand	-4.171	1.536
davon auf temporäre Differenzen	-886	332
» Gesamtaufwand	**-3.584**	**4.131**

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

Angenommener Steuersatz	2013	2012
Körperschaftsteuer	15,00 %	15,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbesteuer	12,43 %	12,43 %
» Kombinierter Steuersatz	**28,25 %**	**28,25 %**

in Tsd. €	2013	2012
Ergebnis vor Steuern	**-19.556**	**11.751**
Erwartete Ertragsteuern	**-5.525**	**3.320**
Abweichende Steuersätze im Ausland	-1.216	-946
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	33	19
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	195	282
Steueraufwand Vorjahre	-453	-73
Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern	3.789	2.600
Inanspruchnahme wertberichtigter Verlustvorträge	9	-69
Steuerfreie Erträge	-639	-1.103
Sonstiges	223	101
» Effektive Ertragsteuern	**-3.584**	**4.131**

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von -1.941 Tsd. € (Vorjahr: 811 Tsd. €). Anstatt eines erwarteten Steuerertrags in Höhe von 5.525 Tsd. € ergab sich auf Konzernebene im Berichtsjahr ein Steuerertrag in Höhe von 3.584 Tsd. €.

Im Berichtsjahr wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von 3.789 Tsd. € gebildet. Der größte Wertberichtigungsbedarf entstand bei den US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA), und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (Kalifornien / USA). Die beiden US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc. und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bilden eine „Tax Group", deren zu versteuerndes Einkommen in den USA der Gruppenbesteuerung unterliegt. Auf Basis der aktuellen Konzernplanung wird für die SUSS MicroTec Photonic Systems in den nächsten drei Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Grund für das negative Ergebnis ist vor allem die für den aktuellen Auftragsbestand erwartete geringe Rohertragsmarge sowie eine verhaltene Umsatzerwartung bis 2016. Das Ergebnis der SUSS MicroTec, Inc. wird im kommenden Jahr voraussichtlich negativ sein. Für 2015 und 2016 erwarten wir ein positives Ergebnis. Insgesamt wird die US-amerikanische „Tax Group" bis 2015 ein negatives Ergebnis erzielen, ab 2016 wird das Ergebnis in den USA voraussichtlich positiv sein.

Der positive Steuereffekt aus der Erzielung von steuerfreien Erträgen ist – wie auch im Vorjahr – im Wesentlichen auf die Erträge aus der Auflösung der Earn-Out-Verpflichtung zurückzuführen, die im Zuge der Neubeurteilung zum Jahresende erfasst wurden.

Der positive Effekt aus Steuern für Vorjahre resultiert im Wesentlichen aus einem steuerlichen Rücktrag des negativen zu versteuernden Einkommens 2013 der SÜSS MicroTec AG (Organträger).

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

	Aktiva		Passiva	
	2013	2012	**2013**	2012
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	555	37	0	40
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	959	612	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	17	63
Langfristige Rückstellungen	9	39	3	66
Immaterielle Vermögenswerte	2.653	2.616	0	703
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	64	64	0	0
Finanzschulden	1	5	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	2.064	2.044
Passiver Ausgleichsposten SMT Photomask Equipment	0	0	370	403
Vorräte	338	182	68	68
Sachanlagen	0	0	5	82
Sonstiges	315	142	0	0
Verlustvorträge	3.285	885	0	0
Saldierung	-2.512	-3.403	-2.512	-3.403
» Gesamt	**5.667**	**1.179**	**15**	**66**

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 43.907 Tsd. € (Vorjahr: 27.730 Tsd. €). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 insgesamt 4.621 Tsd. €. Im Zeitraum von 2028 bis 2033 verfallen insgesamt 26.861 Tsd. €. Verlustvorträge in Höhe von 12.425 Tsd. € sind unbegrenzt nutzbar.

Der Anstieg der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem negativen Jahresergebnis der steuerlichen Organschaft der SÜSS MicroTec AG (mit den Organgesellschaften SUSS MicroTec Lithography GmbH und SUSS MicroTec REMAN GmbH). Zum 31. Dezember 2013 verfügt diese Organschaft in Deutschland über Verlustvorträge in Höhe von 11.627 Tsd. €. Daneben erhöhten sich durch das negative Ergebnis des laufenden Jahres die Verlustvorträge der Tax Group in den USA, die sich zum Jahresende auf insgesamt 26.861 Tsd. € belaufen.

Für Verlustvorträge in Höhe von 32.280 Tsd. € (Vorjahr: 25.663 Tsd. €) und temporäre Differenzen in Höhe von 4.651 Tsd. € (Vorjahr: 6.500 Tsd. €) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

Nach IAS 12.74 f. ist eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorzunehmen, wenn zum einen eine zivilrechtliche Aufrechnungslage gegeben ist und zum anderen die latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden. Zum 31. Dezember 2013 wurden somit aktive und passive latente Steuern in Höhe von 2.512 Tsd. € (Vorjahr: 3.403 Tsd. €) saldiert.

(9) ERGEBNIS JE AKTIE

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in Tsd. €	2013	2012
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten	-15.972	7.620
Abzüglich nicht beherrschende Anteile	0	-30
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	-15.972	7.590
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.108.700
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück)	0	6.838
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
» Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert –	**-0,84**	**0,40**
» Ergebnis je Aktie in € aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert –	**-0,84**	**0,40**

Weitere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 21.

(10) SONSTIGE ANGABEN ZUR IFRS-KONZERNGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

Neben den in der Gewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind im Geschäftsjahr auch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten erfasst worden sowie in geringem Umfang Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten vorgenommen worden.

Die Netto-Investitionen und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2013	2012
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen	**10.186**	**9.705**
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten	2.266	2.519
Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten	62	74
» Netto-Investitionen	**-2.204**	**-2.445**

Personalaufwand

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in Tsd. €	2013	2012
Löhne und Gehälter	45.458	46.001
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.875	4.054
Aufwendungen für Altersvorsorge	3.028	2.804
» Personalaufwand	**52.361**	**52.859**

In den Löhnen und Gehältern sind Zuführungen zu den Earn-Out-Verbindlichkeiten für die Mitarbeiter der SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack Scientific) in Höhe von 201 Tsd. € (Vorjahr: 309 Tsd. €) enthalten.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Materialaufwand

Die Materialaufwendungen betrugen in 2013 62.550 Tsd. € (Vorjahr: 62.895 Tsd. €).

Abschreibungen

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Immaterielle Vermögenswerte	3.465	4.661
Sachanlagen	2.558	2.180
» Abschreibungen	**6.023**	**6.841**

In den Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 2.266 Tsd. € sind außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten des Segments Substrat Bonder in Höhe von 1.156 Tsd. € enthalten. Im Vorjahr betrafen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2.519 Tsd. € ausschließlich planmäßige Abschreibungen. Daneben wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von 854 Tsd. € (Vorjahr: 763 Tsd. €) abgeschrieben.

Außerdem wurden Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurückgeleaste SAP-Software in Höhe von 74 Tsd. € (Vorjahr: 887 Tsd. €) vorgenommen. Damit endete der Leasingvertrag für die SAP-Software. Die SÜSS MicroTec AG erwarb im Januar 2013 die SAP-Software von der Leasinggesellschaft zurück. Der Kaufpreis betrug 228 Tsd. €.

Auf die im Rahmen der Unternehmensakquisition HamaTech (umfirmiert; nun: SUSS MicroTec Photomask Equipment) erworbene Technologie wurden Abschreibungen in Höhe von 43 Tsd. € (Vorjahr: 256 Tsd. €) vorgenommen. Die HamaTech-Technologie ist damit komplett abgeschrieben. Die im Rahmen der Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific (umfirmiert; nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) angesetzte Technologie und weitere erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden mit 259 Tsd. € (Vorjahr: 236 Tsd. €) abgeschrieben.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

(11) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 2.298 Tsd. € (Vorjahr: 2.663 Tsd. €) Entwicklungsleistungen von 793 Tsd. € (Vorjahr: 2.998 Tsd. €) und die erworbene Technologie der Tamarack Scientific (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) von 1.426 Tsd. € (Vorjahr: 1.726 Tsd. €) ausgewiesen.

In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das konzernweite SAP-System enthalten. Der zum 1. Oktober 2009 geschlossene Sale-and-Lease-Back-Vertrag endete im Januar 2013. Die SÜSS MicroTec AG erwarb im Januar 2013 das SAP-System von der Leasinggesellschaft für einen Kaufpreis von 228 Tsd. €. Im Vorjahr wurde das SAP-System mit seinem Restbuchwert von 74 Tsd. € unter „Aktivierte Leasinggegenstände: Software" ausgewiesen.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen. Der Restbuchwert zum 31. Dezember 2013 betrifft allein das Segment Lithografie.

Unter den anderen immateriellen Vermögenswerten wird die im Rahmen der Unternehmensakquisition der Tamarack Scientific (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) erworbene Technologie mit einem Restbuchwert von 1.426 Tsd. € (Vorjahr: 1.726 Tsd. €) ausgewiesen. Die Technologie der HamaTech (nun: SUSS MicroTec Photomask Equipment), die im Vorjahr noch einen Restbuchwert von 43 Tsd. € auswies, wurde 2013 komplett abgeschrieben.

(12) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.318 Tsd. € (Vorjahr: 15.394 Tsd. €) entfällt in voller Höhe auf das Segment Lithografie. Der Geschäfts- oder Firmenwert, der auf die Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) entfällt, ist darin mit 1.719 Tsd. € (Vorjahr: 1.795 Tsd. €) enthalten. Dieser Geschäfts- oder Firmenwert wurde im Rahmen der Erstkonsolidierung mit 2.366 Tsd. USD erfasst und wird für die kommenden Jahre in USD fortgeführt. Die Veränderung resultiert ausschließlich aus Währungsschwankungen.

(13) SACHANLAGEN

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von 15 Tsd. € (Vorjahr: 46 Tsd. €) auch geleaste technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleaster Fuhrpark enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrunde liegenden Leasingverträge (Finance Lease) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

In den Zugängen zum Sachanlagevermögen ist der Immobilienerwerb des Firmenhauptsitzes in Garching mit 8.939 Tsd. € berücksichtigt. Neben dem Kaufpreis von 8.600 Tsd. € sind hier Erwerbsnebenkosten von 339 Tsd. € enthalten.

(14) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in Tsd. €	2013	2012
Rückdeckungsversicherung	145	346
Kautionen	377	418
Sonstiges	0	9
» Sonstige langfristige Vermögenswerte	**522**	**773**

(15) VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in Tsd. €	2013	2012
Materialien und Hilfsstoffe	25.204	27.527
Unfertige Erzeugnisse	23.332	33.997
Fertigerzeugnisse	24.156	14.586
Demonstrationsgeräte	21.467	18.960
Handelswaren	700	371
Wertberichtigungen	-23.726	-13.262
» Vorratsvermögen	**71.133**	**82.179**

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2013 bilanzierten Vorräte in Höhe von 71.133 Tsd. € (Vorjahr: 82.179 Tsd. €) sind 37.173 Tsd. € (Vorjahr: 33.960 Tsd. €) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorräte, der im Geschäftsjahr als Aufwand erfasst wurde, beträgt rund 85.316 Tsd. € (Vorjahr: 95.987 Tsd. €).

(16) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2013	2012
Forderungen gegen Dritte	12.888	22.375
Wertberichtigungen	-1.815	-617
» Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**11.073**	**21.758**

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in Tsd. €	2013	2012
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	**617**	**546**
Ausbuchung von Forderungen	-89	-19
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-164	-14
Zuführung	1.451	104
» Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende	**1.815**	**617**

(17) SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in Tsd. €	2013	2012
Zinsabgrenzungen	104	260
Förderprojekte	56	24
Lieferantenboni	37	37
Bietungsgarantien	71	89
Versicherungsentschädigungen	0	68
Sonstiges	52	69
» Sonstige finanzielle Vermögenswerte	**320**	**547**

Die Zinsabgrenzungen betreffen im Wesentlichen Zinsansprüche aus Wertpapieren.

(18) WERTPAPIERE

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von 2.072 Tsd. € (Vorjahr: 11.394 Tsd. €).

(19) STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von 65 Tsd. € (Vorjahr: 80 Tsd. €) infolge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,1 % p. a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Geleistete Steuervorauszahlungen	518	295
Steuerliche Zuschüsse	45	0
Rückerstattungsansprüche aufgrund eines steuerlichen Verlustrücktrags	158	0
» Steuererstattungsansprüche	**721**	**295**

(20) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in Tsd. €	2013	2012
Aktive Rechnungsabgrenzung	592	597
Geleistete Anzahlungen	1.357	651
Umsatzsteuer	514	352
Kautionen	20	32
Forderungen aus Förderprojekten	5	85
Sonstiges	6	6
» Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	**2.494**	**1.723**

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

Die geleisteten Anzahlungen betreffen zum Großteil Vorauszahlungen der SUSS MicroTec Lithography GmbH für ein Kooperationsprojekt mit einem Forschungsinstitut.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

(21) EIGENKAPITAL

Gezeichnetes Kapital

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug unverändert zum Bilanzstichtag 19.115.538,00 € (eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen lautende und voll einbezahlte Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €). Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 9.000 Tsd. € (Vorjahr: 9.053 Tsd. €).

Am 31. Dezember 2013 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt 0 Tsd. € (Vorjahr: 0 Tsd. €).

in Tsd. €	2013	2012
Grundkapital	19.116	19.116
genehmigtes Kapital	9.000	9.053
bedingtes Kapital	0	0

Rücklagen

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Kapitalrücklage	97.614	97.614
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-4.076	11.897
» Rücklagen	**93.971**	**109.944**

Die Kapitalrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Aufgrund des negativen Jahresergebnisses in Höhe von -15.972 Tsd. € ergibt sich zum 31. Dezember 2013 ein Bilanzverlust in Höhe von -4.076 Tsd. €.

Kumuliertes übriges Eigenkapital

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2013	2012
Retrospektive Anpassung aufgrund der erstmaligen Anwendung von IAS 19 (2011) – bisher nicht erfasste versicherungsmathematische Verluste	0	-551
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-1.242	0
Fremdwährungsanpassungen	-769	-988
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-505	-316
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	248	239
Steuereffekte		
Retrospektive Anpassung aufgrund der erstmaligen Anwendung von IAS 19 (2011) – latente Steuern auf bisher nicht erfasste versicherungsmathematische Verluste	0	140
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	327	0
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-69	-67
Absicherung künftiger Zahlungsströme	143	119
Stand zu Beginn der Periode	**-1.867**	**-1.424**
Veränderungen vor Steuern		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-89	-691
Fremdwährungsanpassungen	-1.657	219
Absicherung künftiger Zahlungsströme	163	-189
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-218	9
Steuereffekte		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	6	187
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	69	-2
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-62	24
» Stand am Ende der Periode	**-3.655**	**-1.867**

Der SÜSS MicroTec Konzern hat die erstmalige Anwendung von IAS 19 (2011) retrospektiv vorgenommen und die Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2011 / 01. Januar 2012 entsprechend angepasst. Dadurch ergab sich im kumulierten übrigen Eigenkapital ein Anpassungsbetrag in Höhe von -411 Tsd. €. Er resultiert aus (bisher nicht erfassten) versicherungsmathematischen Verlusten in Höhe von 551 Tsd. € und darauf entfallende aktive latente Steuern von 140 Tsd. €.

Die SÜSS MicroTec AG hat im Jahr 2010 einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting angewendet: Anstelle in der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Eigenkapitalmanagement

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Bei einer Verfehlung der Planung besteht die Gefahr, dass sich das Eigenkapital infolge eines Jahresfehlbetrags verringern könnte.

AKTIENOPTIONSPLÄNE DER SÜSS MICROTEC AG

Aktienoptionsplan 2005

Auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2005 wurde die Schaffung eines bedingten Kapitals 2005 / I in Höhe von 750.000 € beschlossen. Es dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals wurden insgesamt 749.800 Bezugsrechte ausgegeben. Sämtliche ausgegebenen Bezugsrechte sind zum 31. Dezember 2012 verfallen.

Aktienoptionsplan 2008

Auf der Hauptversammlung am 19. Juni 2008 wurde die Schaffung eines bedingten Kapitals 2008 / I in Höhe von 438.250 € beschlossen. Es dient zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften. Aus diesem Teil des bedingten Kapitals wurden insgesamt 438.250 Bezugsrechte ausgegeben. Hieraus wurden im Geschäftsjahr 2011 379.990 und im Geschäftsjahr 2012 14.510 Bezugsrechte ausgeübt. Alle übrigen Bezugsrechte sind zum 31. Dezember 2012 verfallen.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von 0 Tsd. € (Vorjahr: 0 Tsd. €) für diese Pläne vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden wie im Vorjahr keine Bezugsrechte ausgegeben.

Am 31. Dezember 2013 bestanden keine begebbaren Bezugsrechte mehr (Vorjahr: 0 begebbare Bezugsrechte).

(22) PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter und der Dauer der Betriebszugehörigkeit der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012 angepasst
Inländische Verpflichtungen	2.312	2.628
Ausländische Verpflichtungen	1.448	1.491
›› Gesamt	3.760	4.119

Leistungsorientierte Pläne (defined benefit plans)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2013	2012
Abzinsungssatz	3,10 %	2,54 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	3,10 %	2,54 %
Gehaltssteigerung	0,00 %	0,00 %
Rentensteigerung	2,00 %	2,00 %

Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G

Beim Gehalt wurden nur in der Schweiz Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2013	2012
Abzinsungssatz	2,30 %	2,00 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	2,30 %	3,00 %
Gehaltssteigerung	1,50 %	1,50 %
Rentensteigerung	0,00 %	0,00 %

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2013	2012
Abzinsungssatz	2,00 %	2,00 %
Gehaltssteigerung	1,62 %	1,62 %
Rentensteigerung	0,00 %	0,00 %

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und beizulegenden Zeitwerte des Planvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2013 und 2012 wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2013	2012 angepasst
Anwartschaftsbarwert am 1.1.	**6.086**	**5.324**
Dienstzeitaufwand	277	264
Zinsaufwand	132	196
Pensionszahlungen	-438	-341
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust aus Veränderungen der finanziellen Annahmen	-264	733
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust aus Veränderungen der demografischen Annahmen	176	0
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust aus erfahrungsbedingten Anpassungen	185	8
Währungsveränderungen	-219	-98
» Anwartschaftsbarwert am 31.12.	**5.935**	**6.086**

in Tsd. €	2013	2012
Planvermögen am 1.1.	**1.967**	**1.901**
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	43	82
Geleistete Fondsdotierungen	162	-7
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	21	-16
Währungsveränderungen	-18	7
» Planvermögen am 31.12.	**2.175**	**1.967**

Die wesentlichen Komponenten des Planvermögens sind Rückdeckungsversicherungen. Im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen in Deutschland wurden entsprechende Rückdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. Die Pensionsverpflichtungen in der Schweiz sind über die Helvetia Sammelstiftung abgesichert, die hierfür entsprechende Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen hat. Die beiden Rückdeckungsversicherungen sind als konservative, risikoarme Anlageform zu sehen, deren Wert nur geringen Marktschwankungen unterliegt.

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in Tsd. €	2013	2012 angepass)
Barwert der Pensionsverpflichtungen	5.935	6.086
Zeitwert des Planvermögens	-2.175	-1.967
» Errechnete Pensionsverbindlichkeit	**3.760**	**4.119**

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von 3.767 Tsd.€ (Vorjahr: 3.677 Tsd.€) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Tsd. €	2013	2012
Dienstzeitaufwand	172	183
Personalaufwandskomponente	**172**	**183**
Zinsaufwand	110	196
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-21	-79
versicherungsmathematische Gewinne / Verluste	-13	57
›› Zinsaufwandskomponente	**76**	**174**

Für 2014 erwartet der Konzern zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen Zahlungsmittelabflüsse von insgesamt 315 Tsd. €.

In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, in welcher Weise der Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen durch Veränderungen der maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen beeinflusst worden wäre:

in Tsd. €	2013
Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen falls	
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte niedriger wäre	6.334
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte höher wäre	5.584
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte niedriger wäre	5.873
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte höher wäre	6.000
die künftige Rentensteigerung 0,50 % niedriger wäre	5.813
die künftige Rentensteigerung 0,50 % höher wäre	6.178

Der Konzern hat die erstmalige Anwendung von IAS 19 (2011) retrospektiv vorgenommen und die Vergleichszahlen 2012 entsprechend angepasst. Die Auswirkungen der retrospektiven Anpassung sind unter Punkt 2 D „Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden“ dargestellt.

Beitragsorientierte Pläne (defined contribution plans)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Von dem Plan profitieren alle Mitarbeiter der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona) und der SUSS MicroTec, Inc. (Sunnyvale) ab einem Alter von 18 bzw. 21 Jahren und einem Minimum an geleisteten Arbeitsstunden von 1.000 Stunden pro Jahr. Beide Defined Contribution Plans beinhalten zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Bei der SUSS MicroTec, Inc. werden die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag 0,50 USD für jeden 1,00 USD des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von 3.000 USD (d. h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt 1.500 USD). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Der 401 (k) Plan der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 25 % ihrer jährlichen Vergütung in den 401 (k) Plan einzubezahlen. Für jeden 1,00 USD Arbeitnehmerbeitrag wird ein Arbeitgeberbeitrag von 1,00 USD beigesteuert bis zu einem Maximalbetrag von 3 % des Gehalts. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen einen unverfallbaren Leistungsanspruch gestaffelt in 20 %-Schritten über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Im Geschäftsjahr 2013 betrugen die Aufwendungen des Konzerns für den 401 (k) Plan 145 Tsd. USD (Vorjahr: 160 Tsd. USD).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 2.919 Tsd. € (Vorjahr: 2.621 Tsd. €) abgeführt.

(23) (LANGFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

	Stand 01.01.2013	Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.2013
Altersteilzeit	296	-234	0	62

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung / Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(24) FINANZSCHULDEN

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2013 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31.12.2013 in Tsd.€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.180	4.720	5.560	11.460
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	11	0	0	11
Gesamt	**1.191**	**4.720**	**5.560**	**11.471**

31.12.2012 in Tsd.€	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182	720	3.240	4.142
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	106	21	0	127
» Gesamt	**288**	**741**	**3.240**	**4.269**

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag in Höhe von 3.960 Tsd.€ (Vorjahr: 4.140 Tsd.€), der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels dient. Der Darlehensvertrag wurde am 25./28. Mai 2010 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf 4,5 Mio.€ und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten in Höhe von 7.500 Tsd.€ enthalten, die der Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks Garching dienen. Der neue Darlehensvertrag wurde am 23./28. Oktober 2013 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht.

Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

Konzerngesellschaft in Tsd.€	2013	2012	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	3.960	4.140	3,98 %	30.06.2020
SÜSS MicroTec AG	7.500	0	3,65 %	30.06.2021
Gesamt	**11.460**	**4.140**		
davon kurzfristig fällig	1.180	180		
davon langfristig fällig	10.280	3.960		
fällig 2014	1.180			
2015	1.180			
2016	1.180			
2017	1.180			
2018	1.180			
später	5.560			
	11.460			

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2013	2012
Kreditlinie	8.000	11.200
Inanspruchnahme	3.347	1.913
›› **Verfügbare Kreditlinie**	**4.653**	**9.287**

Die von dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB und unter Beteiligung der Deutschen Bank AG sowie der DZ Bank AG bereitgestellte Kredit- und Avallinie in Höhe von 7,5 Mio. € lief bis zum 31. März 2013.

Zum 1. April 2013 haben die SÜSS MicroTec AG und die SUSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium neue Kreditverträge abgeschlossen. Mit den neuen Kreditverträgen wurden Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. € vereinbart. Die neuen Kreditlinien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt. Sie dienen in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften. Die SÜSS MicroTec AG hat sich für eine Reduzierung der Avallinien entschieden, da die bisher zur Verfügung stehenden Linien bei weitem nicht ausgeschöpft wurden.

Im Mai 2010 hat die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG mit der BW-Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften in Höhe von 2,5 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von 3.347 Tsd. € (Vorjahr: 1.913 Tsd. €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien in Form von Avalen betrug 1,01 % (Vorjahr: 1,25 %).

Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Der Konzern least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Software, Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	Finance Lease	Operating Lease
Abschreibungen / Aufwendungen 2013	98	2.112
Abschreibungen / Aufwendungen 2012	987	2.465
Künftige Verpflichtungen fällig 2014	11	965
2015		448
2016		178
2017		47
2018		0
später		
Gesamt zukünftig	**11**	**1.638**
Zinsanteil	0	
Verbindlichkeit 31.12.2013	11	
davon kurzfristig	11	
davon langfristig	0	

Größten Anteil an den Aufwendungen für Finance Lease haben die Leasing-Raten für das in Deutschland, den USA und Taiwan genutzte SAP-System. Dieser Leasing-Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2013. Der Vertrag beinhaltet eine Kaufoption, die mit Beendigung des Leasing-Vertrags ausgeübt werden konnte. Die SÜSS MicroTec AG hat diese Kaufoption ausgeübt und das SAP-System zum 1. Februar 2013 für einen Kaufpreis von 228 Tsd. € erworben.

(25) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Rückbauverpflichtung	0	75
ERA Anpassungsfond	140	140
Sonstiges	39	33
Bedingte Kaufpreisverpflichtung aus dem Erwerb der SMO	115	346
Earn-Out SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack)	202	1.983
» Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	**496**	**2.577**

(26) (KURZFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Garantierückstellungen	2.098	2.012
Rückstellungen für Abfindungen	451	270
Übrige Rückstellungen	3.390	1.320
» Kurzfristige Rückstellungen	**5.939**	**3.602**

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Nachlaufkosten sowie Personalrückstellungen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2013	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2013
Garantierückstellungen	2.012	-1.682	0	1.768	2.098
Abfindungen	270	-270	0	451	451
Übrige Rückstellungen	1.320	-1.092	-10	3.172	3.390
›› Kurzfristige Rückstellungen	**3.602**	**-3.044**	**-10**	**5.391**	**5.939**

(27) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2013	2012
Prämien und Provisionen	1.724	3.182
Fremdleistungen	3.235	2.303
Aufsichtsratsvergütung	148	148
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	344	506
Bedingte Kaufpreisverpflichtung SMO	247	0
Earn-Out SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals Tamarack)	138	0
noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	438	406
Sonstiges	92	270
›› Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten	**6.366**	**6.815**

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte der Zinsderivate aus. Weitere Einzelheiten zu den Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 30 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

(28) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2013	2012
Erhaltene Anzahlungen	30.773	17.648
Abgegrenzte Personalkosten	4.138	4.443
Passive Rechnungsabgrenzung	266	135
Umsatzsteuer	553	418
Sonstiges	382	920
›› Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	**36.112**	**23.564**

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(29) STEUERSCHULDEN

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von 69 Tsd. € (Vorjahr: 716 Tsd. €) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von 582 Tsd. € (Vorjahr: 334 Tsd. €).

SONSTIGE ANGABEN

(30) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER FINANZINSTRUMENTE

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten. Zur Risikoberichterstattung im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten verweisen wir auf die Darstellung im Lagebericht.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in Tsd. €	2013	2012
Finanzielle Vermögenswerte		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	45.059	25.192
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	2.072	11.394
Kredite und Forderungen	11.393	22.305
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	0	0
	58.524	**58.891**
Finanzielle Verbindlichkeiten		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	344	506
Finanzielle Verbindlichkeiten	23.552	20.017
	23.896	**20.523**

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

	2013					
in Tsd. €	Buchwert	Marktwert	Bewertungskategorien gem. IAS 39	davon Fair Value-Stufe-1	davon Fair Value-Stufe-2	davon Fair Value-Stufe-3
Finanzielle Vermögenswerte						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	45.059	45.059	Kredite und Forderungen	45.059		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.073	11.073	Kredite und Forderungen			
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	320	320	Kredite und Forderungen			
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	320	320	Kredite und Forderungen			
bewertet zum Marktwert	0	0	Kredite und Forderungen			
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	2.072	2.072	Zur Veräußerung verfügbar	2.072		
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.563	5.563	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Finanzschulden	11.471	12.341				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.460	12.330	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	11	11	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	6.862	6.862				
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	6.518	6.518	Fortgeführte Anschaffungskosten			
bewertet zum Marktwert	344	344	Derivate		344	

	2012					
in Tsd. €	Buchwert	Marktwert	Bewertungskategorien gem. IAS 39	davon Fair Value-Stufe-1	davon Fair Value-Stufe-2	davon Fair Value-Stufe-3
Finanzielle Vermögenswerte						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	25.192	25.192	Kredite und Forderungen	25.192		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.758	21.758	Kredite und Forderungen			
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	547	547	Kredite und Forderungen			
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	547	547	Kredite und Forderungen			
bewertet zum Marktwert	0	0	Kredite und Forderungen			
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	11.394	11.394	Zur Veräußerung verfügbar	11.394		
Finanzielle Verbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.862	6.862	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Finanzschulden	4.269	5.061				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.142	4.933	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	127	128	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	9.392	9.392				
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	8.886	8.886	Fortgeführte Anschaffungskosten			
bewertet zum Marktwert	506	506	Derivate		506	

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige finanzielle Vermögenswerte / Verbindlichkeiten: Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Wertpapiere: Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2013	2012
Kredite und Forderungen	-1.198	-90
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	0	121
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	**-226**	**9**

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die während der Laufzeit im kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von -8 Tsd. € (Vorjahr: 23 Tsd. €) infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die direkten Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

	2013		2012	
in Tsd. €	positiver Marktwert	negativer Marktwert	positiver Marktwert	negativer Marktwert
Devisentermingeschäfte	0	0	0	0
Zinsswaps	0	344	0	506

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Zins des 2010 aufgenommenen Darlehens, das der Finanzierung des Grundstücks Sternenfels dient, mit einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Der Zinsswap gleicht die Auswirkungen zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlage aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps für das Grundstücksdarlehen im kumulierten übrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft für diesen Zinsswap Hedge Accounting angewendet. Der Zinsswap im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 auf.

(31) NAHESTEHENDE PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen" – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

(32) FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2013	2012
Bestellobligo	10.266	11.020
Mietverpflichtungen	1.334	2.646
» Gesamt	**11.600**	**13.666**

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

(33) ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS-Konzerns wird entsprechend IAS 7 (Cashflow Statements) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von 350 Tsd. € (Vorjahr: 350 Tsd. €) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Dieser Betrag kann jederzeit durch die Stellung einer Rückbürgschaft abgelöst werden.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 1.531 Tsd. € (Vorjahr: -1.469 Tsd. €) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sind hier außerdem die Effekte aus der Anpassung der Earn-Out-Verpflichtung SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von -2.136 Tsd. € sowie Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs in Höhe von 2.987 Tsd. € erfasst.

Im Cashflow aus Investitionstätigkeit sind Zahlungsausgänge in Höhe von 8.939 Tsd. € enthalten, die den Erwerb der Immobilie am Firmenhauptsitz in Garching betreffen. Neben dem Kaufpreis von 8.600 Tsd. € sind hier Erwerbsnebenkosten von 339 Tsd. € erfasst.

(34) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Informationen zu den Segmenten

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment aufgeteilt. Zusammen mit dem Segment Sonstige werden diese Aktivitäten in der Segmentberichterstattung unter den fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt. Unter den nicht fortgeführten Aktivitäten wird das Segment Test Systeme ausgewiesen.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS-Konzern die Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater sowie die durch Akquisition der Tamarack Scientific (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) neu hinzugekommenen Produktlinien UV Projection und Laser Processing. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Die Entwicklung und Produktion der Photonic-Systems-Produktlinien erfolgt in Corona (USA). Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für das Segment Lithografie tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind seit März 2011 in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. 2010 war dieser Geschäftszweig mit Produktion, Entwicklung und Vertrieb noch in Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Der Vertrieb für das Segment Substrat Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig. In diesem Segment bildet der XBC300, ein Produktions-Bonder für bis zu 300-mm-Wafern, die Ausgangsplattform für die drei wichtigsten Bondtechniken im Bereich der 3D-Integration (einer unserer Zukunftsmärkte): das temporäre und permanente Bonden sowie das Debonden. Zu den Schlüsseltechnologien, die die 3D-Integration erfordert, zählt darüber hinaus das Dünnen von Wafern sowie die weitere Handhabung dieser äußerst fragilen Substrate (Thin Wafer Handling). Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

Sonstige Erläuterungen zur Segmentberichterstattung

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. Infolge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr wie auch im Vorjahr lagen sämtliche Umsätze von SÜSS MicroTec mit einzelnen Kunden unter einem Anteil von 10 % des Gesamtumsatzes.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben den Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch die Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Verpflichtungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen. Die Segmentberichterstattung des Vorjahres weist in den Investitionen des Segments Lithografie auch die Zugänge an Sachanlagevermögen und immateriellen Vermögenswerten aus, die durch die Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific (nun: SUSS MicroTec Photonic Systems) zum Vermögen des Konzerns hinzuaddiert wurden.

Für die geographische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. SÜSS MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 21.608 Tsd. € (Vorjahr: 24.510 Tsd. €) in Deutschland erzielt.

Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt. Das langfristige Vermögen des Konzerns besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und Sachanlagen. Vom langfristigen Vermögen sind 32.297 Tsd. € (Vorjahr: 26.225 Tsd. €) Gesellschaften in Deutschland zuzurechnen; 8.444 Tsd. € (Vorjahr: 10.183 Tsd. €) entfallen auf ausländische Gesellschaften. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 10.513 Tsd. € (Vorjahr: 2.033 Tsd. €) in Deutschland vorgenommen.

(35) NACHTRAGSBERICHT

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

(36) VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Vorstand der Konzernobergesellschaft

MITGLIEDER DES VORSTANDS DER SÜSS MICROTEC AG IM GESCHÄFTSJAHR 2013 WAREN:

FRANK AVERDUNG
Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

Zuständigkeitsbereiche:
Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Investor Relations, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie

weitere Mandate:
- VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
- VDMA, Frankfurt am Main (Mitglied im Hauptvorstand)
- Semi European Advisory Board (Mitglied)
- IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

MICHAEL KNOPP
Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands

Zuständigkeitsbereiche:
Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Materialwirtschaft, Logistik, Facility Management

weitere Mandate:
keine

AUFSICHTSRAT

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS IM GESCHÄFTSJAHR 2013 WAREN:

DR. STEFAN REINECK
Kirchardt, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchardt; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:
- AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- AWS Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

JAN TEICHERT
Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar;
stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:
- seit 1. Januar 2014 Kolb Technology GmbH, Hengersberg (Mitglied des Beirats)

GERHARD PEGAM
Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting GmbH,
Au bei Bad Aibling; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG

Weitere Mandate:
- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats);
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

Vergütung Vorstand und Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von 793 Tsd.€ (Vorjahr: 1.253 Tsd.€). Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 162 Tsd.€ (Vorjahr: 161 Tsd.€).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrates sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2013		2012	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Michael Knopp	28.100	0	22.500	0
Frank Averdung	90.540	0	83.200	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	0	9.600	0

(37) MITARBEITER

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 675 Mitarbeiter (Vorjahr: 695 Mitarbeiter) in der SÜSS-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2013	2012
Verwaltung	65	74
Marketing und Vertrieb	263	285
Produktion und Technik	327	345
Gesamt	**655**	**704**

(38) HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Im aktuellen Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Honoraraufwendungen nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von 250 Tsd. € erfasst. Das im Vorjahr für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AWT Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honorar nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB betrug 265 Tsd. €. Die Aufwendungen betreffen ausschließlich die Abschlussprüfung.

Die Aufwendungen für die Abschlussprüfung enthalten das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Vorjahr: BDO AWT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Von dem Prüfungshonorar entfallen 224 Tsd. € direkt auf den bestellten Abschlussprüfer und 26 Tsd. € auf Netzwerkpartner des Abschlussprüfers.

(39) CORPORATE GOVERNANCE

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2013 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 mit vier Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, Bildung von Ausschüssen und Benennung von Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden und den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Mai 2012 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Im Januar 2014 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2013 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter *www.suss.com* dauerhaft zugänglich gemacht.

(40) ANGABE GEMÄSS § 160 NR. 8 AKTG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die DWS Invest SICAV, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 19. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. August 2013 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,92 % beträgt (557.233 Stimmrechte).

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 23. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. August 2013 die Schwelle von 5 % und gleichzeitig die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 0 % beträgt (0 Stimmrechte).

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwellen von 3 % und 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 9,98 % beträgt (1.907.818 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 25a WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwellen von 5 % und 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 10,57 % beträgt (2.021.180 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,98 % (1.907.818 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22; 0,58 % (111.574 Stimmrechte) nach § 25a WpHG und 0,01 % (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 25 WpHG am 26. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. August 2013 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 9,99 % beträgt (1.909.606 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,98 % (1.907.818 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22 und 0,01 % (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 25a WpHG am 27. August 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 22. August 2013 die Schwelle von 10 % unterschritten hat und zu diesem Tag 9,96 % beträgt (1.903.098 Stimmrechte). Davon sind ihr 9,35 % (1.787.630 Stimmrechte) nach § 21 bzw. § 22, 0,59 % (113.680 Stimmrechte) nach § 25a WpHG und 0,01 % (1.788 Stimmrechte) nach § 25 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 05. September 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. September 2013 die Schwellen von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,65 % beträgt (889.826 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die UBS AG, Zürich, Schweiz, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. September 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 10. September 2013 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,92 % beträgt (557.992 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,02 % (3.322 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Schroders PLC, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Oktober 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % beträgt (594.407 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Administration Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Oktober 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % beträgt (594.407 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Investment Management Ltd, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Oktober 2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Oktober 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,11 % beträgt (594.407 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,11 % (594.407 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Der Vanguard Whitehall Funds, Wilmington, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Oktober 2013 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Oktober 2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,196 % beträgt (611.000 Stimmrechte).

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,17 % beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) PLc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt vom Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt vom Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,003 % beträgt (574.032 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,275 % (243.632 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728 % (330.400 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via Baillie Gifford Overseas Limited) zuzurechnen.

(41) FREIGABE DES ABSCHLUSSES

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss am 10. März 2014 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 10. März 2014

Der Vorstand

Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender

Michael Knopp
Finanzvorstand

VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der Süss MicroTec AG zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 10. März 2014

SÜSS MicroTec AG

Der Vorstand

Frank Averdung Michael Knopp

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 21. März 2014

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ppa. T. Steiner
Wirtschaftsprüfer

S. Spitaler
Wirtschaftsprüfer

GLOSSAR

3D-INTEGRATION

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt werden ohne durch sogenannte Through-Silicon Vias (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-a-Chip) sowie weitere Verfahren subsummiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire Bonding (Drahtbonden) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch Through-Silicon Vias (TSV) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

300-MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben z. B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42 %) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 Millimetern. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzelnem Chip.

ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter Advanced Packaging versteht man weiterentwickelte Packaging-Verfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten Frontend der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

BACKEND

Backend bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

BONDEN

Mit dem Begriff „Bonden“ bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

BUMP

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold, o. ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkügelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire Bonding oder Flip Chip Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

COATER (BESCHICHTUNGSGERÄT)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

COMPOUND SEMICONDUCTOR
siehe Verbindungshalbleiter

COST-OF-OWNERSHIP (COO)
Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die Cost-of-Ownership der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

C4NP
IBM hat in den späten 1960er Jahren den Weg für das Flip Chip Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem IBM-System/3 eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen IBM C4 Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. C4 steht für Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip Chip Bonding verwendet. C4NP ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. NP steht dabei für New Process.

DIE
„Die", IC (Integrated Circuit), Chip sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die" heißen die IC, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies". Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der „Dies" spricht man von Chips.

DRAM
DRAM steht für Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird.

FAB
(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von IC auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis 4 Mrd. USD.

FLIP CHIP BONDING
Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h. der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

FOTORESIST
Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

FOUNDRY
Foundry ist eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre Forschung und Entwicklung für Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

FRONTEND
Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

HALBLEITER
Ein kristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch IC aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

IC

Integrated Circuit, ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

LASERPROZESSIERUNG

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie z. B. die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten in Pikosekunden, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. SÜSS MicroTec bietet zwei Lasertechnologien an:

Excimer-Laserabdampfung: In der Mikrostrukturierung bietet der Einsatz von Excimer-Laser vor allem Möglichkeiten für eine Materialabdampfung. Durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung lässt sich Material von einer Oberfläche abtragen. Dabei stößt eine photochemische Reaktion eine Elektronenanregung an, die in einem plötzlichen Druckanstieg und einer explosiven Abtragung von Material in Form von Monomeren und Gasen resultiert. Die thermische Wirkung ist hierbei minimal – die Prozesstechnologie schont temperaturempfindliche Materialien. Die Systeme verwenden eine Photomaske, die mit einem Laserstrahl beleuchtet wird. Eine Projektionsoptik zwischen Maske und Wafer bildet, ähnlich einem Projektionsstepper in der Lithografie, die Maskenstrukturen auf dem Wafer ab. Jedoch wird das Material nicht belichtet, sondern direkt abgetragen. Mit einem Step-and-Repeat-Verfahren wird der komplette Wafer strukturiert.

Prozessierung mit Festkörper-Laser: Die Festkörper-Laser-Technologie verspricht alle Vorteile der Laserprozessierung: Sie erreicht hohe Auflösungen von bis zu 2 Mikrometer und sorgt für besonders präzise Ergebnisse. Strukturierungsprozesse laufen ohne thermische Nebenwirkungen ab. Die Systeme kommen ohne Maske aus und verwenden eine direkte Schreibmethode.

LED

Light Emitting Diode; Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LED leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmal so große Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.

LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der IC werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32 Nanometer (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip Chip Bonding herzustellen.

MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines IC benötigt werden; die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

MASK ALIGNER (BELICHTUNGSGERÄT)

Mask Aligner richten eine Glasmaske submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

MEMS

MEMS steht für Micro Electro Mechanical System und ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

MIKROMETER / MIKRON
Metrisches Längenmaß; Symbol: µm. Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 µm.

MIKROSYSTEM
Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

MIKROSYSTEMTECHNIK
Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Micro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Auslösen des Airbags eingesetzt wird, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

NANOIMPRINTING / NANO IMPRINT LITHOGRAFIE (NIL)
Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln" in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird, und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

NANOTECHNOLOGIE
Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehreren hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

OPTOELEKTRONIK
Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III / V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LED wegen ihrer vielen Vorteile, wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer, zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

PACKAGING FOUNDRIES
siehe Backend

PROBER (TEST- UND PRÜFSYSTEME)
Prober führen individuelle analytische Tests von Mikrochips durch. Mit Hilfe von Mess-Spitzen werden elektrische Signale von mikroskopisch kleinen Strukturen innerhalb des Chips aufgegriffen und ausgewertet. Oder Belastungstests mittels Druck, Strom, Kraft, Hitze oder Kälte zeigen, ob die Chips den Anforderungen gerecht werden, und weisen frühzeitig auf Fehler hin. Der modulare Aufbau unserer Prober macht diese äußerst flexibel, was insbesondere in Entwicklungsprojekten sehr geschätzt wird.

PROJEKTIONSLITHOGRAFIE
Während bei der Vollfeld-Lithografie (Mask Aligner) der komplette Wafer in einem Vorgang belichtet wird, werden bei projektionslithografischen Prozessen typischerweise nur einzelne Bereiche des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die komplette Belichtung des Wafers wird dann entweder schrittweise (step and repeat) oder kontinuierlich (scan) durchgeführt. SÜSS MicroTec fertigt 1:1-Projektionsscanner für das Halbleiter-Mid- und Backend. Hierbei wird eine Vollfeldmaske verwendet und der Wafer in einem Scannvorgang belichtet. Eine Verkleinerung der Strukturgrößen von der Maske zum Wafer findet nicht statt. Die Projektionsscanner-Technologie von SÜSS MicroTec kombiniert Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie und bietet eine Alternative zu Mask Aligner und Projektions-Steppern.

SENSOR
Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung; diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

SILIZIUM
Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften; halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

SUBSTRAT BONDER (VERBINDUNGSGERÄT)
Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker, etc. funktionieren.

SYSTEM-ON-A-CHIP
Hochkomplexe IC, die viele verschiedene Funktionen enthalten; bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren IC unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von IC mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich sind und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Durch den Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-a-Chip immer größere Wichtigkeit.

THROUGH-SILICON VIA (TSV)
Bei der Through-Silicon Via-Technik werden die einzelnen Chip-Komponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen (Through-Silicon Via) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

TOOL
Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw.; Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zu einer Produktionslinie kombiniert werden.

VERBINDUNGSHALBLEITER
Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.); Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

WAFER
Runde Scheiben z. B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid, etc.), auf denen Chips produziert werden; in den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 Millimeter vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300-mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200-mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 % niedriger.

WIRE BONDING
Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden

YIELD
Die Ausbeute ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

FINANZKALENDER 2014

Geschäftsbericht 2013	28. März
Quartalsbericht 2014	8. Mai
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	17. Juni
Halbjahresfinanzbericht 2014	7. August
Neunmonatsbericht 2014	6. November

IMPRESSUM

Herausgeber	SÜSS MicroTec AG
Redaktion	Finance, Julia Natterer
	Investor Relations, Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung	Whitepark GmbH & Co., Hamburg
Druck	Eberl Print GmbH, Immenstadt
Fotos	SÜSS MicroTec AG, Michael Lange
Übersetzung	EnglishBusiness, Hamburg

KONTAKT

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Telefon: +49 (0)89-32007-161
E-Mail: ir@suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

www.suss.com